Вінницький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Факультет інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем

(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

<u>_Кафедра радіотехніки_</u>

(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))

Пояснювальна записка до магістерської кваліфікаційної роботи <u>«Магістр»</u> (освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: РОЗРОБКА АКТИВНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ФІЛЬТРІВ

Виконав: студент <u>2-го</u> курсу, групи <u>РТ-18м</u> <u>спеціальності 172 – Телекомунікації та</u> <u>радіотехніка_ Освітня програма: Радіотехніка</u> (шифр і назва напряму підготовки, спеціальності) <u>Фенченко С. В.</u> (прізвище та ініціали) Керівник: д.т.н., професор, зав. каф. РТ <u>Осадчук О.В.</u> (прізвище та ініціали) «______2019 р. Рецензент: асистент каф. ТКСТБ <u>Макогон В. І.</u> (прізвище та ініціали) «______2019 р.

Вінниця ВНТУ - 2019 рік

Вінницький національний технічний університет

Факультет <u>Інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем</u> Кафедра <u>Радіотехніки</u> Освітньо-кваліфікаційний рівень <u>Магістр</u> Спеціальність <u>172 – Телекомунікації та радіотехніка</u> (шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри РТ д.т.н., професор О.В. Осадчук "<u>03</u>" <u>10</u> 2019 року

З А В Д А Н Н Я НА МАҐІСТЕРСЬКУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

Фенченку Сергію Вікторовичу_

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи <u>«Розробка активних високочастотних фільтрів»</u>

керівник роботи <u>Осадчук Олександр Володимирович, д.т.н., професор</u> (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від "_02" _10_ 2019 року №254

2. Строк подання студентом роботи 17 ґрудня 2019 року

3. Вихідні дані до роботи: <u>ФНЧ 4-8 порядку з коефіцієнтом підсилення не</u> більше 1,78, частота $f_{sp} = 4000 I'u$, частота одиничного підсилення операційного підсилювача не менше 7000 I'u.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): аналіз існуючого стану розвитку та проектування активних фільтрів; характеристики фільтрів низьких і високих частот та вимоги до них; розробка та дослідження активного ФНЧ; методи розробки активних ВЧ НЧ фільтрів; економічна частина, безпека життєдіяльності; висновки; перелік посилань; додатки.

5. Перелік ґрафічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень): класифікація електричних фільтрів; каскадне з'єднання ланок; попередня структурна схема еліптичного ФНЧ; амплітудно-частотні характеристики еліптичного ФНЧ а) з підйомом в смузі пропускання; б) без підйому; схема включення інтегральної мікросхеми UAF774; АЧХ з виходу 1-го – 4-го каскаду ФНЧ та АЧХ каскадного з'єднання всіх ланок ФНЧ; схема резонатора з послідовною котушкою індуктивності (а), її модуль вхідного імпедансу для різних Ls (б), залежність послідовного резонансу від Ls (в) і перестраіваємость частоти (г)

6. Консультанти розділів роботи

	Прізвище, ініціали	Підпис, дата	
Розділ	та посада	завдання	завдання
	консультанта	видав	прийняв
Основна частина	д.т.н., професор		
	Осадчук О. В.		
Охорона праці та	к.т.н., доцент		
безпека в надзвичайних	Березюк О. В.		
ситуаціях			
Економічна частина	к.т.н., доцент		
	Адлер О. О.		
л п .	0.1		

7. Дата видачі завдання <u>04 жовтня 2019 року</u>

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

No	Назва етапів	Строк виконання	При-
3/П	магістерської кваліфікаційної роботи	етапів роботи	мітка
1.	Огляд літературних джерел. Вибір та узгодження теми МКР	02.09.2019-15.09.2019	
2.	Аналіз літературних джерел. Попередня розробка основних розділів	16.09.2019-22.09.2019	
3.	Затвердження теми. Розробка технічного завдання	23.09.2019-02.10.2019	
4.	Аналіз вирішення поставленої задачі. Розробка структурної схеми	03.10.2019-20.10.2019	
5.	Електричні розрахунки. Експериментальне дослідження	21.10.2019-29.10.2019	
6.	Розділ моделювання	30.10.2019-03.11.2019	
7.	Розробка графічної частини МКР	04.11.2019-10.11.2019	
8.	Аналіз економічної ефективності розробки	11.11.2019-15.11.2019	
9.	Охорона праці (ОП)	16.11.2019-22.11.2019	
10.	Оформлення пояснювальної записки та графічної частини	23.11.2019-27.11.2019	
11.	Нормоконтроль	28.11.2019-29.11.2019	
12.	Попередній захист МКР, доопрацювання, рецензування МКР	02.12.2019-06.12.2019	
13.	Захист МКР ЕК	09.12.2019-17.12.2019	

Студент

(підпис)

Фенченко С. В.

Керівник роботи

Осадчук О. В.

РЕФЕРАТ

УДК 621.397

Фенченко С.В. Розробка активних високочастотних фільтрів. Магістерська кваліфікаційна робота. – Вінниця: ВНТУ, 2019. –145 с. На українській мові. Бібліогр.: 78 назв; табл. 19., Рисунок 40.

У магістерській кваліфікаційній роботі було проведено дослідження характеристик п'єзоелектричного резонатора за допомогою МСЕ і розроблена еквівалентна схемна модель резонатора, придатна для розрахунку електричних характеристик конструкцій резонаторів різних типів в широкому діапазоні частот.

Представлено результати дослідження, що підтверджують значну перевагу моделі п'єзоелектричного резонатора перед класичним, більш заґальним підходом Мейсона. Показана можливість інтеграції моделі в більшість сучасних САПР і її застосування як для прискореного розрахунку і оптимізації конструктивних фільтрів на поверхнево акустичних хвилях високого порядку.

Проведено аналіз впливу реактивних навантажень на характеристики п'єзоелектричного резонатора. Показана можливість використання схем активних еквівалентів індуктивності і від'ємної ємності на основі ОУТ для реалізації ланок активних фільтрів з діапазоном перебудови до 200% і вище.

Наведено результати застосування такого підходу для реалізації малогабаритних активних ФНЧ і ФВЧ на п'єзоелектричних резонаторах.

Розрахунки на економічність приладу показали, що його впровадження у виробництво є економічно ефективним. Оскільки Ток < 3...5-ти років, то фінансування даної наукової розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів є доцільним.

При запроваджені у виробництво виробник отримає прибуток. Аналізуючи ринок можна розраховувати на значний попит на наш виріб. Підтвердженням цьому є технічні параметри даного пристрою, які кращі за параметри аналога.

В розділі охорони праці було розґлянуто такі питання як безпека в надзвичайних ситуаціях, як технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії, визначення безпечної відстані при оптичному випромінюванні, технічні рішення з промислової та пожежної безпеки при проведенні дослідження радіовимірювального параметричного перетворювача оптичного випромінювання, безпека у надзвичайних ситуаціях.

Ключові слова: акустичні хвилі, LC-фільтри, позакристальні фільтри, електричні фільтри, RC-фільтри, п'єзоелектричний резонатор, ВЧ- фільтри.

ABSTRACT

Fenchenko S.V. Development of active high-frequency filters. Master's qualification work. – Vinnitsa: VNTU, 2019. –145p. In Ukrainian language. Bibliogr .: 78 titles; Tab. 19; Fig. 40.

In the master's qualification work, the characteristics of the piezoelectric resonator were studied using ITU, and an equivalent circuit model of the resonator was developed, suitable for the calculation of the electrical characteristics of resonator structures of different types in a wide frequency range.

The results of the study are presented to confirm the significant advantage of the piezoelectric resonator model over the classic, more general Mason approach. The possibility of integrating the model into most modern CAD systems and its application as for accelerated calculation and optimization of design filters on surface acoustic waves of high order is shown.

The effect of reactive loads on the characteristics of a piezoelectric resonator is analyzed. The possibility of using circuits of active equivalents of inductance and negative capacitance on the basis of OUT for the implementation of links of active filters with a range of tuning up to 200% and above is shown.

The results of the application of this approach for the implementation of small–size active LFDs and HDFs on piezoelectric resonators are presented.

Calculations on the efficiency of the device showed that its introduction into production is cost effective. Since the Current is $<3 \dots 5$ years, it is advisable to fund this scientific development of synthesis methods for active high-frequency MEMS filters.

When introduced into production, the manufacturer will profit. Analyzing the market we can count on a significant demand for our product. Confirmation of this is the technical parameters of this device, which are better than the parameters of the analogue.

In the section OP covered such issues as safety in emergency situations, such as technical solutions for occupational hygiene and industrial sanitation, determination of safe distance for optical radiation, technical solutions for industrial and fire safety in the study of the radiometric parametric transducer of optical radiation, safety in emergency.

Key words: acoustic waves, LC filters, extracrystalline filters, electric filters, RC filters, piezoelectric resonators, RF filters.

3 M I C T

ВСТУП8
1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО СТАНУ РОЗВИТКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ
АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ12
1.1 Сучасний стан ВЧ і НЧ фільтрації12
1.2 Фільтри на основі п'єзоелектричних резонаторів
1.3 Активні аналогові інтегральні ВЧ і НЧ фільтри
1.4 Розрахункові методи і інструменти моделювання
1.5 Висновки до розділу
2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЛЬТРІВ НИЗЬКИХ І ВИСОКИХ
ЧАСТОТ ТА ВИМОГИ ДО НИХ
2.1 Каскадне проектування активних фільтрів
2.2 Чутливість характеристик і параметрів фільтрів до зміни
параметрів елементів
2.3 Настроювання активних фільтрів
З РОЗРОБКА ТА ЛОСЛІЛЖЕННЯ АКТИВНОГО ФНЧ
3.1 Вибір та обґрунтування структурної схеми46
3.2 Визначення порядку розташування ланок і їх параметрів
3.3 Визначення принципової схеми фільтра
3.4 Розрахунок параметрів пасивних елементів ланки ФНЧ
з еліптичною АЧХ
3.5 Вибір операційного підсилювача52
3.6 Визначення допусків на параметри елементів
3.7 Моделювання активного RC – фільтра НЧ з еліптичною
АЧХ на ОЕМ
3.8 Висновки до розділу60
4 МЕТОДИ РОЗРОБКИ АКТИВНИХ ВЧ НЧ ФІЛЬТРІВ 61
4.1 Переналаштувальні навантаження та їх вплив
4.2 Поверхнево акустичні хвилі навантажувального конденсатора65
4.3 Активна реалізація котушки індуктивності. Параметри гіраторного
аналога індуктивності
4.4 Реалізація гіратора з використанням від'ємного опору
5 АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗРОБКИ (ТЕХНОЛО-
ГІЧНИЙ АУДИТ РОЗРОБКИ) РАДІОВИМІРЮВАЛЬНОГО ПАРАМЕТ-
РИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ.92
5.1 Визначення рівня комерційного потенціалу розробки методів
синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів
5.2 Визначення рівня якості розробки методів синтезу активних
високочастотних MEMS фільтрів93
5.3 Визначення конкурентоспроможності розробки методів синтезу
активних високочастотних MEMS фільтрів
5.4 Прогнозування витрат на виконання науково-дослідної, дослідно-
конструкторської та конструкторсько-технологічної роботи

5.4.1 Розрахунок витрат, що стосуються виконавців розробки методів
синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів
5.5 Розрахунок загальних витрат на розробку методів синтезу активних
високочастотних MEMS фільтрів101
5.6 Прогнозування витрат на виконання та впровадження методів синтезу
активних високочастотних MEMS фільтрів
5.7 Прогнозування комерційних ефектів від реалізації методів синтезу
активних високочастотних MEMS фільтрів
5.8 Розрахунок ефективності вкладених інвестицій та період їх окупності103
5.8.1 Визначення абсолютної ефективності вкладених інвестицій у розробку
методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів103
5.9 Розрахунок відносної ефективності вкладених коштів в НДДКР
методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів104
5.10 Розрахунок терміну окупності коштів, вкладених в наукову розробку
методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів105
6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
6.1 Гігієна праці та виробнича санітарія106
6.1.1 Склад повітря робочої зони та мікроклімат106
6.1.2 Виробниче освітлення107
6.1.3 Виробничі віброакустичні коливання
6.1.4 Виробничі випромінювання
6.2 Технічні рішення з промислової та пожежної безпеки під час
проведення дослідження
6.2.1 Безпека щодо організації робочих місць111
6.2.2 Електробезпека112
6.2.3 Пожежна безпека112
6.3 Безпека у надзвичайних ситуаціях114
6.3.1 Дослідження стійкості роботи активного високочастотного
MEMS фільтра в умовах впливу іонізуючих випромінювань115
6.3.2 Оцінка стійкості роботи активного високочастотного
MEMS фільтра в умовах дії електромагнітного імпульсу116
6.3.3 Розробка заходів по підвищенню стійкості роботи
активного високочастотного MEMS фільтра рідини в умовах
дії заґрозливих чинників НС117
ВИСНОВКИ120
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
Додаток А (обов'язковий) Технічне завдання126
Додаток Б (обов'язковий) Класифікація електричних фільтрів131
Додаток В (обов'язковий) Каскадне з'єднання ланок133
Додаток Д (обов'язковий) Попередня структурна схема еліптичного ФНЧ135
Додаток Е (обов'язковий) Амплітудно-частотні характеристики
еліптичного ФНЧ а) з підйомом в смузі пропускання; б) без підйому137
Додаток Ж (обов'язковий) Схема включення інтегральної мікросхеми UAF774139

Додаток К (обов'язковий) АЧХ з виходу 1-го – 4-го каскаду ФНЧ та	
АЧХ каскадного з'єднання всіх ланок ФНЧ	141
Додаток Л (обов'язковий) Схема резонатора з послідовною котушкою	
індуктивності	144

Актуальність теми. Основною технологією фільтрації в бездротових телекомунікаційних систем (зв'язок за стандартами IEEE 802.11, IMT-2000, IMT-Advanced, WCDMA, WiBro, UWB, LMDS), супутникової навігації (GPS, Glonass, Galileo) є електроакустичні пристрої на поверхневих і об'ємних акустичних хвилях. Пристрої на поверхнево акустичних хвилях та активних підсилювачах фільтрах на операційних добре вивчені успіхом i 3 застосовуються на частотах до 1 Пц. Однак при підвищенні частоти складність виробництва таких фільтрів суттєво зростає через скорочення розмірів зустрічно-штирьових перетворювачів і збільшення кількості вибракуваних виробів [1].

Кола фільтрації сиґналів – важлива і невід'ємна частина баґатьох систем зв'язку і електричного контролю вимірювальних пристроїв. Вони використовуються для формування частотних каналів в системах комутації, розподілу і перетворення електричних сиґналів, дистанційного керування технологічними процесами та баґатьох інших ґалузях [1].

Техніка фільтрації безперервно розвивається й основною рушійною силою цього розвитку є мікромініатюризація. Як відомо, мікроелектроніка – це вирішення протиріч між безперервно зростаючою складністю ШЛЯХ радіоелектронних систем: неминучим при традиційних способах конструювання, погіршення їх якісних характеристик, особливо надійності.

За останній час в області мініатюризації цифрових пристроїв досягнутий значний прогрес. Однак мініатюризація може дати необхідний ефект лише при комплексному підході, що охоплює також аналогові пристрої, важливу і, невід'ємну частину яких складають пристрої частотної селекції. В даному відношенні проблема мініатюризації вирішується досить складно. Основними цього €: перше, чутливість характеристик будь-якого причинами по електричного кола до дестабілізуючих факторів у значній мірі залежить від її частотної вибірності (чим більш вибірне коло, тим менше воно стабільне); по друге, частотно-вибірні пристрої із-за великої різноманітності вимог до їх характеристик (частотного діапазону, ширини смуги пропускання, необхідному згасанню в смузі затримки і т.п.) зв'язку.

На даний момент, окрім традиційних LC-фільтрів з об'ємними елементами, відомі такі типи фільтрів, як електромеханічні, маґнітострикційні, спіральні (об'ємні і в планарному виконанні), цифрові, кварцові (з зосередженими елементами і монолітні), п'єзокерамічні, акустоелектронні, з зарядовим зв'язком, оптоелектронні, електротеплові, НВЧ фільтри із зосередженними та квазізосередженними елементами, хвильоводні, коаксиальні, полоскові (гребенчаті, зустрічно-стержневі, шпільчні) та інші.

Одним із перших були винайдені LC-фільтри, які як правило знаходять використання в діапазоні частот від декількох сотень ґерц до декількох сотень мегагерц. В діапазоні НВЧ починають проявлятись паразитні ємності і індуктивності кіл, що призводять до нестабільності розрахункових значень параметрів пристроїв в зв'язку з чим у діапазоні НВЧ LC-фільтри практично не знаходять застосування. Крім того, для роботи в діапазоні низьких частот необхідні великі значення індуктивностей, які можливо реалізувати лише у вигляді дискретних котушок індуктивності, в результаті чого зростають розміри пристрою його вартість. В деяких випадках такий недолік вдається усунути при використанні «синтезованих» індуктивностей, тобто побудови LC-фільтрів на базі гіраторних схем. Але незважаючи на безсумнівні позитивні властивості таких фільтрів (великий динамічний діапазон, прості схемні рішення, можливість отримувати різноманітні частотні характеристики, т.і.) ïм притаманна низка недоліків – велика маса і габаритні розміри (особливо на низьких частотах) котушок індуктивності, складність і несумісність технології виготовлення 3 технологією інтегральних мікросхем, низька від електромагнітних полів, неможливість отримання заводозахищенність фільтрів з комплексними полюсами на базі пасивних RC – кіл т.i. [2].

В наш час застосування пасивних LC – фільтрів обмежено частотним діапазоном від декількох сот Ґц до приблизно 300 МҐц, де вони застосовуються в апаратурі з низьким рівнем інтеграції [3].

Одним з підходів до вирішення проблеми є застосування активних елементів в схемах фільтрів: підсилювачів, еквівалентів імпедансу і гіраторів. Застосування такого підходу при використанні п'єзоелектричних резонаторів дозволить компенсувати деякі конструктивні і електромеханічні обмеження, поліпшивши електричні характеристики, а також забезпечить можливість перебудови центральної частоти, ширини смуги пропускання і добротності фільтру електронним шляхом.

Метою роботи є дослідження пристроїв частотної селекції сиґналів на основі активних елементів і п'єзоелектричних резонаторів та операційних підсилювачів для широкого діапазону частот, що поєднують поліпшені електричні та експлуатаційні характеристики, а також можливість інтеґрації за інтеґральною технологією.

Об'єктом дослідження є параметри та характеристики активних фільтрів на п'єзоелектричних резонаторах та операційних підсилювачах та їх залежність від зміни температури та шумових характеристик. Предметом дослідження є активні фільтри на основі операційних підсилювачів та п'єзоелектричних резонаторів об'ємних хвиль і активних елементів.

Для досятнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

1. Аналіз існуючих методів та засобів побудови та використання активних п'єзоелектричних фільтрів та на основі операційних підсилювачів;

2. Розгляд і аналітичний опис методів електронної перебудови активних фільтрів на основі операційних підсилювачів та поверхнево акустичних пристроїв;

3. Розробка принципів реалізації малогабаритних активних фільтрів із розширеними динамічним і частотним характеристиками;

4. Узаґальнення методів синтезу активних фільтрів на основі операційних підсилювачів та п'єзоелектричних фільтрів із застосуванням позитивного і негативного реактансу, а також перетворювачів імпедансу.

Методи дослідження включають загальні методи аналізу і синтезу електричних ланцюгів, моделювання п'єзоелектричних резонаторів із застосуванням теорії п'єзоефекту і чисельного моделювання, метод кінцевих елементів, аналіз і оптимізацію активних фільтрів, чисельні методи дослідження чутливості, стабільності та динамічного діапазону.

Наукова новизна отриманих результатів.

1. Розглянута еквівалентна схемна модель п'єзоелектричного резонатора, що відрізняється від існуючих аналогів спрощеною структурою без частотнозалежні елементів і дозволяє розраховувати в широкому діапазоні частот характеристики базових конструкцій п'єзоелектричного резонатора, а також придатна для проектування в САПР активних п'єзоелектричних фільтрів високого порядку.

2. Розглянуто аналітичні співвідношення для моделювання режимів активного управління характеристиками п'єзоелектричного резонатора, що дозволяють реалізувати фільтри, що перебудовуються з розширеним частотним діапазоном.

3. Розглянуто методи створення та розрахунку активних п'єзоелектричних фільтрів, на основі активних схем заміщення і мають переваги у вигляді розширеного частотного діапазону, скороченої кількості резонаторів.

Практична цінність отриманих результатів:

Проведено аналіз ряду методів і схемотехнічних рішень електронної перебудови резонаторів на поверхнево акустичних хвилях.

Розглянуто принципи реалізації нових типів фільтрів на основі перетворення імпедансу п'єзоелектричного резонатора при використанні активних еквівалентів індуктивності і ємності;

Розглянуто методи заміщення LC прототипів пасивних фільтрів активними аналогами на п'єзоелектричних резонаторах, які мають покращені характеристики добротності, стабільності і зменшені габарити.

Особистий внесок здобувача

Основні положення і результати магістерської кваліфікаційної роботи отримані автором самостійно.

1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧОҐО СТАНУ РОЗВИТКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ

1.1 Сучасний стан ВЧ і НЧ фільтрації

В умовах швидкого зростання телекомунікаційних і обчислювальних технологій вимоги до бездротових пристроїв постійно змінюються. Бездротові глобальні обчислювальні мережі (WWAN), що використовують останні досягнення телекомунікаційних мобільних технологій, сьогодні розвинулися в безліч різних стандартів зв'язку, серед яких виділяються UMTS, GPRS, GSM, EDGE, CDMA2000, HSDPA, 4G, Mobitex, CDPD, LTE i iншi. Бездротові локальні мережі (WLAN) також розширюються і представлені в першу черґу набором стандартів IEEE 802.11, що забезпечує комунікацію в частотних діапазонах 2.4, 3.6 і 5 ІТц. Все ще затребувані технології бездротових персональних мереж для комунікації на близькій відстані, такі як Bluetooth, UWB або ZigBee. Велику популярність набирають бездротові мережі міського масштабу (WMAN), засновані на стандарті IEEE 802.16, і забезпечують універсальну зв'язок для широкого спектру пристроїв на великих відстанях. Різноманітність бездротових пристроїв доповнюється також системами супутникового позиціонування GPS і знаходяться на стадіях розробки та запуску Galileo i GLONASS. Рисунок 1.1 представляє спільні тенденції розвитку сучасних систем зв'язку.

Швидкий розвиток бездротових телекомунікаційних систем призвело до збільшення попиту на портативні пристрої та щорічно встановлює все більш жорсткі вимоґи до пристроїв частотної селекції, включаючи поліпшені частотні характеристики, мініатюризацію, скорочення енерґоспоживання і зниження виробничих витрат.

Управління спектром сигналу і придушення шумів в бездротових пристроях здійснюється за допомогою ВЧ та НЧ фільтрів. Для запобігання інтерференції між сусідніми діапазонами частот передбачені захисні смуги. Отже, отримання широкої корисної смуги пропускання можливо при мінімальних захисних проміжках, значення яких визначаються вибірковістю фільтра.

Домінуючими технологіями ВЧ та НЧ фільтрації до кінця 90-х були керамічні фільтри і фільтри на поверхневих акустичних хвилях. Для отримання резонансу в керамічних фільтрах застосовуються Полоскова і пов'язані мікрополоскових лінії. Ґеометричні розміри керамічних резонаторів в значній мірі залежать від довжини хвилі електромаґнітних хвиль. І, незважаючи на те, що матеріали з високою діелектричної проникністю дозволяють зменшити розмір фільтрів, вони все ж виявляються надмірно масивними для застосування в сучасних мобільних пристроях.



Рисунок 1.1 – Тенденції розвитку сучасних систем зв'язку, навігації та широкосмуґовоґо доступу

Таблиця	1.1 –	Діапазони	сучасних	бездротових	систем зв	'язку
тастици		Aumasenni	•) 14•11111	perebini		nong

		Частотні діапазони, МҐц	Ширина каналу, МҐц
>	DVB–T	54-890	6–8
Ĥ	DVB–H 470–890, 1670		5–8
	GPS	1575, 1227, 1381, 1379, 1 176	24
S	IRNSS	1176, 2492	24
NS	COMPASS	1207, 1268, 1561	24
5	GLONASS	1246, 1602	15–24
	Galileo	1190, 1242, 1575	33–85
7	GSM	800, 1800	15–75
/WAN	CDMA	450–2600	12–90
	LTE	800, 900, 1800, 2600 (EU)	15-70
٨	UMTS 700–3500		10-80
ΣZ	WiMAX	2300, 2500, 3500	10–30
W A	WiBro	2350	10-100
	Bluetooth	2450	1
	IrDA	315, 434, 868	1–4
Z	Z–Wave	868, 908, 921	4
WPA	ZigBee	2400	5
	WiFi	2450, 5000	20–40
	RFID	26, 433, 858, 2400, 5700	10–150
	UWB	3100-10600	500
	LMDS	26–29 ҐҐц	75-850

Сучасне мережеве оточення надзвичайно розвинене і заповнене різними мережевими стандартами, що перевищують частотний межа 2 ҐҐц. Так, у 2009 році для безліцензійного використання технології сверхшірополосних сиґналів UWB виділений частотний діапазон 3.1–10.6 ҐҐц [6]. Одночасно з підвищенням частоти спостеріґається розширення частотних смуґ діапазонів. На

рисунок 1.2 зображений частотний план 14 діапазонів мережевого стандарту GSM. Білі і темні області відносяться до каналів вхідних та вихідних з'єднань відповідно. Якщо для діапазону T–GSM 380 (Band 1) смуга становить 9.6 МГц, то для DCS

1800 (Band 13) смуга розширена до 72.6 МГц [7].



Рисунок 1.2 – Частотний план діапазонів стандарту GSM

Подальший розвиток телекомунікаційних технологій пов'язано з проблемою розробки пристроїв, що працюють в широкому спектрі частотних діапазонів і протоколів, що підтримують високочастотну і широкосмуґовий фільтрацію. У подібному середовищі стає дуже важливим використання доступного частотного діапазону з максимальною ефективністю.

Класифікація існуючих технологій смуґовий фільтрації заснована на безлічі аспектів. Так, за принципом обробки сиґналу можна виділити фільтри безперервного і фільтри дискретного часу. За способом реалізації фільтри можуть бути позакристальними або розташованими на чіпі [8]. Технології смуґових фільтрів представлені пристроями на поверхневих акустичних хвилях, монолітними кристалічними, дискретними керамічними фільтрами, а також LC-фільтрами (



рисунок 1.3). та наведена в додатку Б.

Рисунок 1.3 – Класифікація електричних фільтрів

Позакристальні фільтри знайшли застосування в пристроях AM / FM мовлення (керамічні Murata SEE10.7MS2–Z, TOKO CFMR 455B), пейджерах (Murata SFP450F), мобільних і радіотелефонах (Siemens B4535 на поверхнево акустичних хвилях та ін.). Пристрої розраховані на роботу в проміжному частотному діапазоні з фільтрацією каналів на стандартизованих частотах від 262 кГц до 110 МГц, а також забезпечують мобільний зв'язок радіохвиль 881-914 МГц. Перевагою таких фільтрів є невисока вартість, завдяки чому вони досі широко застосовуються в споживчих пристроях зв'язку. Основними недоліками внечіпових смугових фільтрів можна назвати великі розміри і щодо високою потужність споживання [9], Що стимулює розвиток внутрикристальной Ha інтегрованих пристроїв. рисунок 1.4 представлені порівняльні характеристики популярних електричних фільтрів: займана площа кристала і вносяться втрати проходження.

Технології внутрикристальної реалізації представлені цифровими і аналоговими фільтрами. Пасивні аналогові фільтри включають LC, RC, електромеханічні, магнітострикційні і п'єзоелектричні пристрої. Активні аналогові фільтри включають технології перемикаються (SC) i трансімпедансним конденсаторів (Gm–C), LC-фільтри 3 підвищеною добротністю, а також активні варіанти п'єзоелектричних і RC фільтрів.

Цифрові фільтри являють собою окремий, інтенсивно розвивається клас фільтрів, теоретично пристосований для створення високоточних, високочастотних програмованих фільтрів з розширеним динамічним діапазоном.



Рисунок 1.4 – До порівняння характеристик електричних фільтрів

Значними переваґами цифрових фільтрів € ïχ висока точність, стабільність частотних характеристик, можливість отримання заданого відгуку шляхом перепрограмування, а також висока добротність (103–104), що дозволяє отримати перехідні смуги до 1 Ґц. Однак практичне застосування інтегрованих DSP фільтрів обмежена з багатьох причин: а) необхідність в зовнішньому тактуванні і в попередніх згладжують фільтрах і ОЗУ; б) несумісність з низькорівневими аналоговими сигналами; в) потреба в високошвидкісних АЦП і ЦАП з високою роздільною здатністю; г) велика площа кристала [10]. Сучасний частотний межа пристроїв оцифровки становить близько 1 ҐГц, при цьому з підвищенням частоти можливе виникнення шумів, помилок динамічного дискретизації, зменшення діапазону фільтра. Обмежене застосування цифрових фільтрів також пов'язано з їх високою вартістю і споживаної потужністю.

Технологія фільтрів на комутованих конденсаторах (SC) відноситься до класу фільтрів дискретного часу. Завдяки тому, що в фільтрі відсутні індуктивності і опору, SC фільтр займає значно меншу площу на кристалі, ніж цифрові фільтри, і при цьому має кращі поверхнево акустичних хвиляхаметри. Оскільки сучасна технологія дозволяє створювати конденсатори, похибка номіналу яких становить 0,1–0,5%, частотний відгук SC фільтрів характеризується високою точністю і повторюваністю. Недоліки таких фільтрів

включають необхідність в високочастотних підсилювачах, вхідних зґладжують фільтрах, а також у відновному зґладжування на виході. На сьоґоднішній день SC фільтри застосовуються на частотах до 20 МҐц, з добротністю 10–55, динамічним діапазоном в 42–68 дБ і споживаної потужністю 20–400 мВт [11, 12]. Недоліком SC–фільтрів є обмежений динамічний діапазон, що пов'язано з шумами, пролізання керуючих сигналів і неідеальної ключів. Зазвичай динамічний діапазон таких фільтрів не перевищує 70 дБ.

Внутрішньокристальної реалізація пасивних LC фільтрів можлива з використанням інтеґрованих конденсаторів i планарних спіральних індуктивності [13]. Подібні індуктивності часто застосовуються при розробці GaAs монолітних НВЧ схем, що працюють на частоті в кілька гігагерц. Відносно недавно спіральні індуктивності знайшли застосування в кремнієвої технології на низьких частотах в інтегральних схемах узгодження імпедансу. На частотах до 2 Пц індуктивності можуть бути використані в фільтрах нижніх частот або смугових фільтрах з розширеним динамічним діапазоном[14]. У роботах [15-17] описуються смугові інтегровані LC-фільтри, що працюють на частотах до 2,7 ГГц, однак характеризуються відносно низькими значеннями добротності від 1,3 до 14,2. Поряд з незаперечними переваґами LC-фільтрів великим динамічним діапазоном і простотою схемних рішень, виділяються і суттєві недоліки – невисока стабільність (до 10-5 1 / К), вибірковість (добротність до 400), необхідність використання додаткових активних схем, що компенсують втрати в котушках індуктивності, а також суттєві модифікації технологічного процесу виготовлення подібних фільтрів.

Як було показано раніше, добротності пасивних LC фільтрів дуже низькі, в межах 1,3–14,4, що пов'язано з втратами в індуктивностях. Рішенням даної проблеми стали фільтри з підвищеним добротності, також відомі як QE–LC фільтри [14], В яких втрати в індуктивностях компенсуються активними елементами. Можливими методами компенсації є послідовна (за допомогою послідовно підключеного неґативного опору) і поверхнево акустичних хвилях (за допомогою поверхнево акустичних хвилях негативного конденсатора) компенсації. Компенсація дозволяє підвищити добротність до значень 80–170 [8, 9]. Головним недоліком QE–LC фільтрів є втрати в послідовних опорах КМОП–технології на частотах нижче 1 ГГц.

З появою операційних підсилювачів стала можливою реалізація активних схем з RC-фільтрами. Переваґи такого підходу: зменшені ґабарити, можливість електронної перебудови поверхнево акустичних хвиляхаметрів, простота проектування. Частотний діапазон таких фільтрів обмежений максимальною робочою частотою активних елементів і становить сотні МҐц для звичайних

операційних підсилювачів, і кілька ҐҐц для транзисторних схем. Висока чутливість активних схем до значень пасивних елементів сильно обмежує вибірковість (добротність 300 для ланки 3 порядку) і стабільність (10–4 1 / К) фільтра [10]. Шуми і нелінійність активних елементів призводять до зменшення динамічного діапазону до 70–90 дБ [11].

Конструкція електромеханічних фільтрів включає вхідний, вихідний п'єзоелектричні перетворювачі та механічні резонатори, з'єднані зв'язками. Працюють на частотах до 10 МҐц, мають добротність до 10000 і нестабільність 10–5 1 / К [22]. Найважливіші недоліки таких фільтрів – нетехнологічність виробництва і висока вартість. В даний час активно впроваджується технологія мікроелектромеханічних фільтрів, експериментальні зразки яких мають робочу частоту 30 ҐҐц і добротність до 80000 [13].

Фільтри на трансімпедансним конденсаторах (Gm–C) є перспективним напрямом, який за рахунок використання операційних підсилювачів дозволяє досяґти високих робочих частот при малій площі кристала. Добротності таких фільтрів лежать в межах 20–220 при динамічному діапазоні 50–101 дБ [14, 15]. Значним недоліком Gm–C фільтрів є залежність добротності Q від центральної частоти фільтра. У більшості випадків, на частотах вище 100 МҐц, Q не перевищує 20.

Клас пасивних електроакустичних фільтрів включає пристрої на поверхнево акустичних хвилях, резонатори на об'ємних акустичних хвилях і п'єзоелектричні пристрої. Дискретні вузькосмуґові п'єзоелектричні фільтри на кристалах LiNbO3, LiTaO3 і плівках ZnO застосовуються в діапазоні частот 100 кҐц–300 МҐц, мають високі показники добротності (30..200 · 103) і стабільності (0.5..50 · 10–6 1 / К) [16]. У вищому частотному діапазоні використовують монолітні (інтеґральні) фільтри.

Принцип дії пристроїв на поверхнево акустичних хвилях, другий і найбільш популярної технології, заснований на поширенні поверхневих акустичних хвиль. Геометричні розміри таких фільтрів значно скорочені завдяки тому, що швидкість поширення акустичної хвилі в п'єзоелектричному матеріалі в 10000 разів нижче, в порівнянні зі швидкістю електромаґнітних хвиль. Хоча поверхнево акустичні хвилі і задовольняють вимоґам поточних комунікаційних стандартів, їх застосування ускладнюється на частотах понад 2 ҐҐц через високу вартість технологічних процесів i невисокою енергоефективності [17]. Варто зауважити також, що ні керамічні, ні поверхнево акустичних хвилях фільтри не можуть бути повністю інтегровані на кристалі, так як вони несумісні з КМОП технологією. Інтегральними поверхнево акустичних хвилях пристроями вважаються радіочастотні активні

схеми, засновані на BIFET технології [18, 19]. Такі пристрої виробляються на кремнієвих і GaAs підкладках з тонким п'єзоелектричним шаром Zni, CdS або AlN. На відміну від дискретних поверхнево акустичних хвилях аналогів, в таких фільтрах складно реалізувати оптимальні умови поширення хвилі через обмежений коефіцієнта електромеханічного зв'язку, а також проблем, пов'язаних з ТКР п'єзоелектричної плівки. Пристрої займають досить велику площу кристала на частотах до 1 ІТц і вимаґають деяких модифікацій технологічного процесу виготовлення [8].

Інтегральні пристрої на об'ємних акустичних хвилях є тонкоплівкові резонатори (ТР) або плівкові резонатори об'ємних хвиль (п'єзоелектричного резонатора). Через низький коефіцієнта електромеханічного зв'язку ОАВ фільтри в основному є вузькосмуґовими режекторного фільтрами. Високі показники надійності і добротності, які досяґаються при використанні п'єзоелектричного резонатора, дозволяють створювати передові високочастотні фільтри з конкурентоспроможними характеристиками. Так, створені зразки з Q, перевищує 2000 [20, 21]. Наслідком цього є висока крутизна зрізу частотної характеристики фільтра.

Пристрої на ОАВ забезпечують малі втрати проходження на частотах вище 2 ҐҐц, а в порівнянні з поверхнево акустичних хвилях, вигідно відрізняються зменшеними геометричними розмірами, витратами на виробництво і можливістю інтеграції з КМОП технологією.

У порівнянні з існуючими керамічними пристроями, п'єзоелектричного резонатора пропонують значні поліпшення в області мініатюризації: можливе створення пристроїв, що займають на 10% менший обсяг. На відміну від традиційно вузькосмуґових керамічних фільтрів, п'єзоелектричного резонатора реалізацію уможливлюють широкосмуґових пристроїв. Електричні прототипів фільтрів на п'єзоелектричного характеристики резонатора наближаються до характеристик поточного покоління керамічних CDMA PCS Дуплексер, і в найближчому майбутньому повинні замінити їх. Технологія виробництва п'єзоелектричного резонатора сумісна як з кремнієвим, так і з GaAs техпроцесом, що відкриває перспективи для інтегрованих НВЧ пристроїв, що включають одночасно активні елементи і фільтри на одному чіпі. На поверхнево акустичних хвилях пристрої в основному виробляються на дорогих LiTaO3 і LiNBO3 підкладках, що обмежують їх інтеграцію до МСМ рівня. Таблиця 1.2 містить узагальнені характеристики фільтрів, виконаних з застосуванням різних технологій.

У порівнянні з поверхнево акустичних хвилях пристроями, п'єзоелектричного резонатора забезпечують поліпшення електричних

характеристик, включаючи менші вносяться втрати, більш високу крутизну фронту смути пропускання і поліпшені характеристики енергоспоживання.

	LC–фільтри	Д/Е	ПАХ	ПР
Внесені втрати	3-5 дБ	2-3 дБ	2–4 дБ	0,8–2,5 дБ
Займана площа, кв. мм.	200–400	20–50	5–14	1,2–30
споживана потужність	кілька Вт	кілька Вт	0,1–1 Вт	до 1 Вт
Центральна частота	до 3 ҐҐц	0,7–5 ҐҐц	0,01-2,5 ГГц	0,5–12 ГГц
Від. смуґа пропуску	1-100%	до 2%	0,02–100%	0,7–8%
ТКЧ, ppm / C	-10 20	0 –5	-3594	-20-35
можливість інтеграції	+	_	МСМ	МСМ
ESD надійність	Xop.	добрі	Задов.	добрі

Таблиця 1.2 – Порівняльні характеристики технологій фільтрації

Багато з цих переваг виходять від зменшення поверхнево акустичних хвильових ефектів, пов'язаних з об'ємним пристроєм, що призводить до розширення смуги пропускання і усуває необхідність в розщепленні частотного діапазону. До того ж, складності в отриманні зустрічно–штиревих поверхнево акустичних хвилях структур з високими показниками енергоефективності обмежують їх застосування в частотних діапазонах мобільного зв'язку. У той же час, технологія п'єзоелектричного резонатора може легко застосовуватися на частотах PCS і дозволяє створювати резонатори, експлуатовані на частотах до 10 ГГц. Як показано на рисунок 1.5, На відміну від конкуруючих технологій, фільтри на п'єзоелектричних резонаторах дозволяють перекрити частотний діапазон від 102 до 1010 Гц, а при використанні активних елементів можливе отримання відносної ширини смуги до 100% і більше.

У той же час тривають активні розробки в області аналоґової схемотехніки. Уже сьогодні налаґоджено виробництво транзисторів по КМОП 0.18-мкм технології з ґраничною частотою 40 ҐҐц [11, 12], На базі яких створюються нові НВЧ прототипи операційних підсилювачів струму (ОУТ), котрі долають існуючий частотний бар'єр в кілька сотень МҐц [13]. Ведуться дослідження, спрямовані на підвищення їх лінійності, ґраничної частоти і споживаної потужності.



Рисунок 1.5 – Області застосування електричних фільтрів

Загальним недоліком існуючих на сьогоднішній день фільтрів, заснованих на поверхнево акустичних хвилях і ОАВ пристроях, є відсутність електричної перебудови їх частоти пропускання [9]. Актуальність даної проблеми також підтверджується патентами ряду великих компаній, зокрема, LG, Samsung, Nokia, Intel та ін.

Використання перспективного п'єзоелектричного резонатора спільно з активними схемами дозволить створити клас активних фільтрів на тонкоплівкових п'єзоелектричних резонаторах, які об'єднують гідності пасивних ОАВ фільтрів з ґнучкістю активних елементів. Переваґи реалізації активних п'єзоелектричного резонатора фільтрів: розширена відносна смуга пропускання, діапазон ультрависоких частот при використанні сучасних активних елементів, великий динамічний діапазон, висока стабільність, відсутність загасання в смузі пропускання, можливість електричної перебудови поверхнево акустичних хвилях.

1.2 Фільтри на основі п'єзоелектричних резонаторів

Проґрес в області технології п'єзоелектричного резонатора привів до можливості створення фільтруючих пристроїв з характеристиками, що дозволяють ефективно використовувати частотний діапазон до 10 ҐҐц. Висока добротність і коефіцієнт електромеханічного зв'язку резонатора призводять до відмінних показників крутизни зрізу (більш ніж 40 дБ в смузі 10 МҐц [10]) І рівня режекции поза смуґи пропускання. Такі фільтри мають низькі втрати пропускання (до 0,5 дБ нижче в порівнянні з поверхнево акустичних хвилях фільтрами), невисоке енерґоспоживання (десятки мкВт) [14], А також можуть бути інтеґровані з активними елементами на одній мікросхемі, що робить їх дуже перспективним варіантом стосовно до мобільних пристроїв.

Сходові фільтри є найбільш популярними і комерційно вигідними застосуваннями п'єзоелектричного резонатора резонаторів. Баґато компаній, включаючи Avago і Infineon, переходять на технологію тонкоплівкових фільтрів, поступово замінюючи ними радіочастотні поверхнево акустичних хвилях і керамічні елементи [15].

Фільтри на п'єзоелектричних резонаторах реалізуються на основі двох топологій: сходовій і бруківці, в яких відгалуженнями є поодинокі резонатори (рисунок 1.6, А, б). У разі якщо зв'язок між резонаторами здійснюється за допомогою шунтирующего конденсатора (рисунок 1.6, В), можливе отримання симетричною смуґи пропускання. При цьому відносна ширина смуґи пропускання фільтра підпорядковується висловом [15]

$$\frac{\Delta f}{f_0} < \frac{1}{5} \left(\frac{C_m}{C_0} \right) \tag{1.1}$$

де Cm і C0 – динамічна і статична ємності конденсатора.

Оскільки відношення ємностей обмежує смугу пропускання, запропонований підхід [16], Що розширює смугу за допомогою індуктивності L0, яка підключається поверхнево акустичних хвиляхалельно послідовним резонаторам (рисунок 1.6, Г). Таким чином, вводиться помилкова смуга пропускання фільтра в діапазоні. Якщо резонатори з розширювальними індуктивностями коммутируются за допомогою шунтуючих индуктивностей ($0..f_0/\sqrt{2}$ рисунок 1.6, Д), помилкова смуга пропускання зміщується на половину ширини, що призводить до відсутності спотворень в області смуги

пропускання фільтра. Сходові топології фільтрів характеризуються різким зрізом смуги

Сходові топології фільтрів характеризуються різким зрізом смуги пропускання, низькими втратами проходження в цій смузі, але мають невисокі рівні режекції поза смуги. Рівень режекції поза смуги може бути поліпшений оптимізацією геометрії резонаторів, а також каскадних реалізацією кількох T– ланок. Каскадна структура, однак, збільшує втрати в смузі пропускання.



Рисунок 1.6 – Топології п'єзоелектричних резонаторних фільтрів: (а) сходова; (Б) бруківка; (В) сходова з ємнісний розв'язкою; (Ґ) сходова з ємнісний розв'язкою і розширювальними індуктивностями; (Д) сходова з індуктивної розв'язкою і розширенням

Мостові схеми мають високі показники рівня режекції, але в той же час недостатню крутизну зрізу. Крутизна зрізу збільшується шляхом каскадного включення резонаторів і за допомогою оптимізації статичної ємності двох плечей мостового фільтра [17]. Можливо також застосування комбінованих ступінчато-мостових схем, що поєднують переваґи обох типів фільтрів: високу крутизну зрізу і режекції поза смуґи пропускної [18].

Розробляється метод реалізації фільтрів на акустично зв'язаних резонаторах [19]. Такі фільтри мають поліпшені характеристики, однак їх виробництво ускладнено конструкцією, що включає велику кількість шарів.

Розглянемо топологію фільтра, розробленого для застосування в інтегральних одночипових бездротових системах [20]. Фільтр розрахований на роботу в смузі PCS на частоті 1,9 ҐҐц і включає в себе сходову структуру з п'єзоелектричного резонатора (рисунок 1.7). В такому Т–образному ланці характеристики фільтра реалізуються як комбінація імпедансних властивостей послідовних і резонаторів на поверхнево акустичних хвилях. У більшості випадків використовуються резонатори з незначним зміщенням по частоті: послідовні, з резонансом на частоті, що відповідає центральній частоті фільтра f0; поверхнево акустичних хвилях (шунтуючі) з резонансом на частоті нижньої межі смуґи пропускання. Низькочастотний хвіст фільтра визначається послідовним резонансом шунтуючого резонатора, високочастотний хвіст – поверхнево акустичних хвилях резонансом послідовних резонаторів. Смуґа

пропускання з малим рівнем режекции досяґається одночасно завдяки високому імпедансу шунтуючого і низькому імпедансу послідовних резонаторів в даному частотному діапазоні. Незважаючи на те, що така топологія реалізує частотну характеристику смуґового фільтра, ширина смуґи пропускання виявляється занадто обмеженою. Тому, для задоволення поставлених вимоґ, в фільтрі використовуються розширювальні індуктивності, номіналом 1 нҐн, підключені поверхнево акустичних хвилях послідовним резонаторам.



Рисунок 1.7 – Частотно–імпедансні характеристики сходовій топології на п'єзоелектричного резонатора

У той час як одним з найважливіших переваґ п'єзоелектричного резонатора фільтрів є можливість реалізації малоґабаритних пристроїв, необхідність використання розширюють смуґу пропускання індуктивностей, в сукупності з їх низькою якістю в інтеґральному виконанні, практично нівелює переваґу в розмірах фільтрів в порівнянні з іншими технолоґіями. Рішенням проблеми великоґабаритних розширювальних індуктивностей є активні фільтри, в тому числі Gm–C елементи, що імітують індуктивність.

1.3 Активні аналогові інтегральні ВЧ і НЧ фільтри

Активні фільтри широко поширені і виконують функції частотної обробки в пристроях зв'язку на проміжній частоті, в DSP [24]. Успішність застосування активних фільтрів пов'язана, перш за все, з можливістю їх інтеґрації і величезною теоретичною базою. Хоча DSP можуть перевершити активні фільтри по динамічному діапазону, активні фільтри дозволяють домоґтися ґарних характеристик при значно більш низькому енерґоспоживанні.

Такі пристрої можуть містити резистори і конденсатори, але в більшості випадків позбавлені індуктивностей. Спектр активних елементів фільтрів включає як поодинокі транзистори, так і складні інтегральні схеми: традиційні операційні підсилювачі, операційні підсилювачі струму, універсальні перетворювачі повного опору, частотно–залежні негативні опору та ін. Клас активних фільтрів містить МОП–С, ARC і ОУТ–С фільтри.

Активні RC-фільтри на основі операційних підсилювачів (рисунок 1.8) Часто застосовуються в низькочастотних телекомунікаційних мережах та системах обробки сигналу. Однак, більш високі частоти недосяжні через частотних обмежень операційних підсилювачів і необхідність компенсації полюсів вищого порядку, що часто ускладнює повну інтеграцію пристрою. Операційні підсилювачі мають відносно складну структуру і не передбачають вбудованих можливостей електронної перебудови поверхнево акустичних хвиляхаметрів. МОП-С фільтри проектуються за методикою, аналогічною ARC-фільтрів з тією різницею, ЩО замість традиційних резисторів використовуються МОП-пристрої в тріодному режимі.



Рисунок 1.8 – Реалізація НЧ фільтра першого порядку на операційному підсилювачі (а) і альтернативна схема (б)

Найбільш успішним підходом, що виключає недоліки операційних підсилювачів, є їх заміна ОУТ-підсилювачами, що призвело до виникнення класу ОУТ-С фільтрів. В останні роки ведуться активні дослідження в області таких пристроїв, спрямовані на поліпшення характеристик лінійності, ґраничної частоти і енергоспоживання. Основними перевагами ОУТ є проста структура, електронної перебудови поверхнево акустичних хвилях можливість i працездатність на частотах вище 1 Пц. ОУТ реалізуються по КМОП, БіКМОП, біполярної і GaAs технологій. Типові значення коефіцієнта транспроводімості складають 10-100 мкСм для КМОП і кілька мСм для біполярної технології. Різні методики підвищення лінійності дозволяють створювати пристрої з рівнями вхідних напруґ до декількох вольт при відносній нелінійності менше 1% [25]. Розробляються топології каскадів в попереджувальних регулюванням,

що розширюють частотний межа до 10 ГГц зі збереженням високих значень транспроводімості [26].

На відміну від операційних підсилювачів, які є джерелами напруги, керованими напругою, ОУТ – джерело струму (рисунок 1.9, А). Топологія підсилювача зазвичай передбачає додатковий вхід для токового управління коефіцієнтом транспроводімості підсилювача gm:

$$I_{out} = (V_{in+} - V_{in-}) \cdot g_m$$
(1.2)

В лінійних застосуваннях конструкції ОУТ-фільтрів часто виявляються простіше, оскільки негативний зворотний зв'язок не є обов'язковою. Це стало можливим з тієї причини, що величина опору, підключеного до терміналу, контролює вихідну напруґу:

$$V_{out} = I_{out} \cdot R_{load} \tag{1.3}$$



Рисунок 1.9 – Операційний підсилювач струму (а) і фільтр нижніх частот першого порядку, реалізований на ОУТ (б)

Отже, опір може бути вибрано таким, яке виключає перехід в режим насичення навіть при високому вхідному диференціальному напрузі. На рисунок 1.9, Б зображений фільтр НЧ першого порядку на ОУТ. Функція передачі такого фільтра реалізується значно меншою кількістю елементів, в порівнянні з ARC фільтрами:

$$H(s) = \frac{g_m}{sC_1 + g_m} \tag{1.4}$$

При цьому коефіцієнт посилення дорівнює 1, а частота зрізу фільтра задається, як. Оскільки gm управляється зовнішнім струмом Ibias, така схема

дозволяє в досить широкому діапазоні перебудовувати частоту зрізу НЧ фільтра. відомі роботи g_m/C_1 [27], В яких ОУТ застосовуються для створення

активних регульованих індуктивностей, що в фільтрах на п'єзоелектричних резонаторах відкриває нові можливості для перебудови поверхнево акустичних хвиляхаметрів фільтра або розширення смуґи пропускання.

Таким чином, з точки зору проектування фільтрів, ОУТ мають незаперечні переваґи: простота реалізації схемотехнічних рішень, висока ґранична частота, а також можливість перебудови поверхнево акустичних хвиляхаметрів фільтрів шляхом електронного управління коефіцієнтом транспроводімості gm.

1.4 Розрахункові методи і інструменти моделювання

Еволюція телекомунікаційних стандартів і вимог, що відносяться до нізкопотерьним радіочастотним фільтрам для мобільних пристроїв, привела до розвитку високоякісних поверхнево акустичних хвилях і ОАВ пристроїв, які вимаґають наявності ґнучких, точних і ефективних моделей і інструментів моделювання [28].

Запропоновано різні підходи до симуляції ОАВ пристроїв, що включають моделі BVD, KLM, Мейсона, Редвуд. Самоузґоджені одномірні моделі, засновані на теоремі взаємності [29] або матриці розсіювання [70], А також безліч інших моделей специфічного застосування. Одномірні моделі розрізняються кількістю врахованих ефектів другого роду і, відповідно, складністю структури, однак не можуть описувати латеральні ефекти, наприклад, ґеометрію електродів.

З іншого боку, існують тривимірні моделі ОАВ резонаторів, що розраховуються методом кінцевих елементів в проґрамних середовищах COMSOL [20], Coventor [22], ANSYS HFSS і Maxwell 3D [23]. Такі моделі забезпечують тривимірне уявлення і симуляцію складних пристроїв. Однак, зі зростанням кількості шарів ОАВ резонатора і ускладненням його геометрії значно підвищуються вимоги до обчислювальним машинам і збільшується час симуляції. Проектувальники комплексних пристроїв на основі таких резонаторів стикаються з проблемою пошуку компромісу, що дозволяє зменшити обчислювальну складність МСЕ симуляції.

Альтернативою є реалізація еквівалентної схематичною моделі в комп'ютерних інструментах, таких як Ansoft, SPICE, AWR Microwave office або Agilent ADS. Однак та ж проблема виникає при ускладненні топології пристрої. Незважаючи на це, моделі, описувані еквівалентними схемами, дуже зручні і

особливо ефективні при моделюванні взаємодій між електричними та компонентами неелектричними OAB пристроїв. Так, аналогія між електричними і механічними складовими докладно описана Мейсоном в [24]. Одиничний шар пристрою вперше був представлений як Т-подібна секція [25], Відповідно баґатошарова структура тонкопленочного резонатора може бути змодельована кількома послідовно підключеними секціями. На основі рекурсивних співвідношень Мейсоновской моделі для кожної секції може бути виведена передавальна функція. Узаґальнена функція передачі всього пристрою формується з окремих функцій шляхом матричних операцій, що проводяться в розрахунковій середовищі MatLAB. Такий підхід дозволяє знизити розрахунковий час, при цьому модель може застосовуватися для вивчення резонансних властивостей або для оптимізації конструктивних поверхнево акустичних хвилях резонатора окремо. Недоліком такого методу є складність інтеграції текстової моделі в сучасні засоби автоматизованого проектування електричних схем, що призводить до необхідності розробки спеціальної моделі ОАВ резонатора,

Agilent ADS є середовищем проектування електричних схем, що надає широкий спектр моделей і режимів розрахунку (AC, DC, S–поверхнево акустичних хвиляхаметри, перехідні процеси, аналіз нелинейностей і шумів). На відміну від SPICE–інструментів, ADS орієнтований на високочастотні застосування і містить значно більші бібліотеки ліній передач і моделей пасивних компонентів, що описують різні неідеальної. У складі даної САПР також є бібліотеки активних елементів, що дозволяють обробляти сторонні моделі транзисторів: SPICE, BSIM, Philips, HiSim, MosVar і інші. За умови доопрацювання необхідних компонентів, представлені характеристики САПР ADS роблять її найбільш оптимальним інструментом для проектування активних фільтрів на тонкоплівкових п'єзоелектричних резонаторах.

Існує баґато інших напрямків реалізації фільтрів, але всі вони не охоплюють низькі (декілька сот Ґц) і інфранизькі (десятки Ґц) діапазони частот [7].

Таким чином існує ніша, яка охоплює низькі діапазони частот, де властивості вищезґаданих фільтрів за різних причин не задовольняють сучасним вимоґам фільтрації електричних сиґналів. Це ніша заповнюється RC – фільтрами, в які для отримання комплексних полюсів включаються підсилювачі і які отримали назву активних RC – фільтрів (скорочено ARC – фільтрів) [8].

Одним із найбільш поширених типів фільтрів, що використовуються в діапазоні низьких та інфранизьких частот є активні фільтри. Головною

перевагою активних фільтрів є можливість їх виготовлення методом інтеґральної технології, що дозволяє автоматизувати виробництво, значно знизити трудомісткість і матеріаломісткість виготовлення елементів РЕА, підвищити її надійність, зменшити ваґу та габаритні розміри. Використання активних фільтрів дозволяє виключити використання моточних компонентів, при виготовленні яких низька автоматизація виробництва. Активні фільтри дозволяють сумістити функції фільтрації, підсилення, крім тоґо сьогодні вони являються єдиним класом елементарних фільтрів, що мають високу вибірність у діапазоні інфранизьких частот, завдяки підсиленню дозволяють компенсувати втрати в пасивних елементах.

Перші відомості про ARC – фільтри, відносяться до 30–х років минулосторіччя, що пов'язано з засвоєнням діапазонів низьких і інфранизьких частот і побудовою вимірювальних систем, які функціонують в сильних маґнітних полях. Але систематичного розвитку фільтрації на основі ARC – кіл набула в 60-ті роки в зв'язку з успіхами мікроелектроніки, особливо з появою якісних інтеґральних операційних підсилювачів (ОП).

В наш час ARC – фільтри використовуються на частотах від 0 до приблизно 500 кГц і верхня границя має тенденцію до зростання, що обумовлено появою швидкодіючих ОП.

Застосування ARC – фільтрів в радіоапаратурі поки що обмежене трактами звукової частоти, а саме: в стереодекодерах, в фільтрах надтональних частот декодерів, в коректорах передпідсильвачів маґнітного звукознімача, в фільтрах обмежувачах діапазону відтворюваних частот, блоках регулювання тембру, тощо.

Зараз активні RC-фільтри успішно заповнили велику нішу в радіоапаратурі в часті мікромініатюризації першого порядку, де немає необхідності або можливості використання інтегральної технології. Особливість цього полягає в тому, що окрім традиційного застосування фільтри широко впроваджуються в побутову, медичному, геофізичну та іншу апаратуру [9].

1.5 Висновки до розділу

1. Фільтри на п'єзоелектричних резонаторах є високоселективними, але вузькосмуговими, що призводить до необхідності застосування схемотехнічного розширення їх смуги пропускання за допомогою індуктивності.

2. Проектування активних фільтрів на п'єзоелектричних ОАВ резонаторах, оцінка їх вихідних характеристик і оптимізація конструктивних

поверхнево акустичних хвилях пов'язані з необхідністю застосування відповідних моделей. Існуючі системи автоматизованого проектування високочастотних фільтрів і обчислювальні потужності сучасних ЕОМ обмежують структурну комплексність таких моделей.

3. Зараз активні RC-фільтри успішно заповнили велику нішу в радіоапаратурі в часті мікромініатюризації першого порядку, де немає необхідності або можливості використання інтегральної технології.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІЛЬТРІВ НИЗЬКИХ І ВИСОКИХ ЧАСТОТ ТА ВИМОҐИ ДО НИХ

Електричним фільтром називається електричне коло, яке служить для пропускання, або заґородження електричної енергії у визначеному діапазоні частот. Таким чином, із визначення слідує, що головна функція електричного фільтру поляґає в зміні частотного спектра вхідного сигналу. По виду АЧХ електричні фільтри поділяють на фільтри низьких частот, фільтри високих частот, смуґові фільтри тощо [11].

Фільтр низьких частот представляє собою пристрій, який пропускає сиґнали низьких частот і подавляє сиґнали високих частот. На рисунку 2.1 зображена ідеальна і реальна амплітудно–частотна характеристика, де для практичного випадку позначені смуґа пропускання $0 < \omega < \omega_{co}$, смуґа затримки

 $\omega > \omega_{c\delta}$, перехідна область $\omega_1 > \omega > \omega_{c\delta}$ і частота зрізу ω_{sp} (*pad/c*), чи $f_{sp} = \frac{\omega_{sp}}{2\pi}$ (*Г* μ).



Рисунок 2.1 – Ідеальна і реальна амплітудно-частотна характеристики фільтра низьких частот

На практиці неможливо реалізувати таку ідеальну характеристику, оскільки потрібно сформувати дуже вузьку перехідну область. Тому основна проблема при конструюванні фільтра заключається в приближені реалізованої реальної характеристики з заданим степенем точності до ідеального. Варіант такої реальної характеристики зображений суцільною лінією на рисунку 2.1.

Передатну функцію будь якого фільтра у заґальному випадку можна представити у вигляді відношення поліному A(s) в чисельнику до полінома B(s) в знаменнику (2.3) [9]

$$K(p) = \frac{A(p)}{B(p)} = \frac{\alpha_0 + \alpha_1 p + \alpha_2 p^2 + \dots + \alpha_m p^m}{b_0 + b_1 p + b_2 p^2 + \dots + b_n p^n},$$
(2.1)

де *n≥m*, а коефіцієнти α_0 , α_1 , $\alpha_2...\alpha_m$; b_0 , b_1 , $b_2...b_n$ – можуть в залежності від типу та складності фільтру набувати різні дійсні значення; $p=j\omega$ – комплексна частота.

Нулі полінома чисельника A(p) називаються при цьому нулями функції кола K(p), що значить, що вони мають такі значення (місцеположення в площині комплексної частоти), при яких функція K(p) дорівнює нулю. Нулі полінома знаменника B(p) називають в даному випадку полюсами кола. Вони мають такі значення (місцеположення в площині комплексної частоти), при яких функція K(p) нескінченно велика.

Передатну функцію фільтра низьких частот з частотою зрізу ω_{sp} можна отримати із виразу [11]

$$H = \frac{U_2}{U_1} = \frac{P(p)}{p^2 + (\omega_{\delta} / Q_P)p + \omega_{\delta}^2} , \qquad (2.2)$$

де ω_{δ} – власна частота фільтра; Q_{P} – добротність фільтра.

$$H = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Kp}{P + \omega_{c\delta} / C}, \qquad (2.3)$$

де С – нормований коефіцієнт нижніх частот першого порядку.

Аналітично зв'язок між постійною ослаблення і амплітудно – частотною характеристикою фільтра (АЧХ) визначається виразом [12]

$$A = 20 \lg \frac{1}{H(\omega)} , [\Box B]$$
 (2.4)

де *H*(ω) – модуль коефіцієнта передачі по напрузі.

На підставі виразу (2.4) вимоги до постійної ослаблення перераховуються в вимоги до АЧХ, де

$$\varepsilon = \sqrt{10^{0.1 \,\mathrm{max}} - 1} \tag{2.5}$$

нерівномірність АЧХ а смузі пропускання

$$\delta = \sqrt{10^{0.1\,\text{min}} - 1} \tag{2.6}$$

Існує велика кількість різних типів фільтрів НЧ, які задовольняють усі технічні вимоги, такі як A, A_1 , A_2 , $\omega_{c^{\delta}}$ і ω_1 – фільтри Баттерворта, Чебишева, інвертувальні Чебишева і еліптичні фільтри Золотарьова–Кауера, які є найбільш поширеними. Існують і інші типи фільтрів, проектування яких здійснюється на підставі вимог до частотної залежності постійних ослаблення або фази.



Рисунок 2.2 – АЧХ фільтра Чебишева 6-го порядку

Фільтр НЧ Баттерворта має монотону характеристику, подібну до характеристики рисунка 2.1. Характеристика фільтра НЧ Чебишева характеризується пульсацією в смузі пропускання і монотонністю в смузі затримки. На рисунку 2.2 зображена АЧХ фільтра Чебишева 6–го порядку та АЧХ інвертувального фільтра Чебишева 6–го порядку на рисунку 2.3. Фільтри Золотарьова–Кауера мають пульсації в смузі пропускання і затримування (рисунок 2.4). Існують і інші типи фільтрів, проектування яких здійснюється на підставі вимоґ до частотної залежності постійних ослаблення або фази [12].

Коефіцієнт підсилення фільтра НЧ представляє собою значення його передатної функції при безкінечному значені зміної *s*. Тому для ланцюгів другого і першого порядку коефіцієнт підсилення дорівнює *K*.



Рисунок 2.3 – АЧХ інвертувального фільтра Чебишева 6-го порядку



Рисунок 2.4 – АЧХ еліптичного фільтра 6-го порядку

Як видно з рисунка 2.4 еліптичний фільтр має АЧХ, яка має пульсації в смузі пропускання, так і смузі затримки, і є найкращим серед усіх фільтрів НЧ. Оскільки, для заданого порядку і допустимих відхилень характеристики в смуґах пропускання і затримки володіють самою вузькою шириною перехідної смуґи.

Пульсації в смузі пропускання однакові по амплітуді і можуть характеризуватись максимальним допустимим затуханням в смузі затримки. Ця величина називається нерівномірністю передачі в смузі пропускання (PRW).

$$PRW = -20\log_{10}A_{\rm i} \tag{2.7}$$

Пульсації в смузі затримки також рівні по амплітуді і характеризуються мінімальним затуханням в смузі затримки (MSL).

$$MSL = -20\log_{10} A_2 \tag{2.8}$$

Ширина перехідної смути (TW), як і для інших типів фільтрів, визначається

$$TW = \omega_1 - \omega_{c\delta} \tag{2.9}$$



Рисунок 2.5 – Залежність порядка фільтрів Чебишева (2) і еліптичних (1) від ширини перехідної смуґи

Для заданих значень PRW і MSL збільшення порядку приводить до збільшення кількості пульсацій в смугах пропускання і затримки і зменшенню TW.

Переваги еліптичного фільтра зображено на рисунку 2.5. Дві криві показують залежність порядка фільтрів Чебишева і еліптичних від ширини перехідної смуги для PRW=0,1дб і MSL=60дб. Інші випадки дають аналогічний результат.
Як видно з рисунка 2.5 для однакової перехідної смуги еліптичний фільтр потребує менший порядок ніж фільтр Чебишева, але його реалізація більш складна ніж поліноміальних фільтрів Баттерворта і Чебишева.

Перехідна функція еліптичного фільтра ідентична інвертувальному фільтру Чебишева. Для парного порядку *n* із виразу (2.1) знайдемо перехідну функцію

$$H(p) = \prod_{i=1}^{n/2} \frac{A_i(p^2 + a_i)}{p^2 + b_i p + c_i},$$
(2.10)

а для непарного порядку *n*

$$H(p) = \frac{A_0}{p+c_0} \prod_{i=1}^{(n-1)/2} \frac{A_i(p^2+a_i)}{p^2+b_i p+c_i},$$
(2.11)

де *A*₀, *c*₀, *A*_i, *a*_i, *b*_i, *c*_i – відомі постійні числа, які знаходяться із еліптичної функції Якоби.

Оскільки проектування фільтрів здійснюється ідеалізації за VMOB бази, існуючої елементної властивостей то виникають відхилення характеристик фільтра від запланованих. Тому при проектуванні фільтра використовують метод "перед спотворень", тобто до фільтра висувають більш жорсткі вимоги порівняно з заданими в технічному завдані. Наприклад якщо треба спроектувати фільтр з $A \leq A_{max} - \Delta A$, де ΔA – запас на неідеальність елементів методом "перед спотворень" неможливо забезпечити "запас" на смугу пропускання, якщо незадані межі зміни смуги пропускання. При їх відсутності обов'язкова настройка фільтра з метою отримання заданої смуги пропускання, про що вже йшла мова вище.

2.1 Каскадне проектування активних фільтрів

Існують два заґальних метода використання активних RC-фільтрів при реалізації функцій кола [13]. Перший з них – метод каскадної реалізації. Цей метод називається так тому, що функція, яка реалізується спочатку факторизується (розділяється на добуток співмножників другого порядку). Якщо реалізується функція непарного порядку, то необхідно використовувати в каскадному з'єднанні або пасивну ланку першого порядку, або активну ланку третього порядку. Кожний співмножник реалізується потім активною RC– схемою, після чого каскадується, або безпосередньо з'єднується з іншими, щоб реалізувати функцію кола в цілому. Окремі активні RC-схеми, звичайно, повинні бути синтезовані так щоб вони не взаємодіяли один з іншим.

Друтий загальний метод використання RC–схем для реалізації функцій кола –метод безпосередньої реалізації, в якому для реалізації функції у цілому використовується одна єдина схема.

Каскадний метод використання активних RC–схем для реалізації функцій кола дає баґато переваґ інженеру–проектувальнику. Насамперед, будь яка RC– схема, яка потребується для реалізації ланки другого порядку звичайно, відносно проста, а кількість необхідних елементів невелика. В результаті цього процедура синтезу, яка необхідна для визначення значень елементів, звичайно нескладна і дозволяє враховувати додаткові обмеження, такі як використання стандартних номіналів елементів або обмеження які накладаються при мінімізації чутливості. Друґа переваґа поляґає в тому, що кожну ланку друґого порядку можна індивідуально настроювати для реалізації відповідної характеристики. Це, звичайно, значно леґше, ніж намаґатись настроїти схему, в якій усі елементи взаємодіють один з іншим; саме це і відбувається , коли використовується безпосередній метод реалізації.

Ще одною переваґою каскадного з'єднання ланок другого порядку є те, що в сучасних системах зв'язку та обробки даних значна частина обробки сигналу виконується за допомогою цифрових ВІС. Тому вимоги на периферійні аналогові фільтри часто помірні, що відповідає, відносно низький добротності полюсів. З іншого боку, ще більш знижується мінімум споживаної потужності. В цих умовах каскадне з'єднання ланок другого порядку на одному підсилювачі являє майже ідеальне рішення проблеми фільтрації. Для високоякісних фільтрів, тобто при високих добротностях полюсів та потреб у низький чутливості, можна застосовувати багатопідсилювальні ланки, тобто каскадне з'єднання ланок другого порядку на декількох підсилювачах кожна, та при необхідності додаткові узгодження між ланками.

Каскадне проектування фільтрів є найбільш поширеним "при помірних вимогах до фільтра" [9]. Причина цього обумовлена тим, що в сучасних системах зв'язку значна частина обробки сиґналів здійснюється за допомогою цифрових ВІС. Тому вимоги та периферійні аналогові фільтри часто помірні і можуть задовольнятися при відносно низькій добротності полюсів і мінімальній споживаній потужності. В таких умовах проектування фільтра каскадним з'єднанням ланок на одному ОП є близьким до оптимального. Для високоякісних фільтрів, потребуючих високих добротностей і низьких чутливостей застосовуються каскади на декількох ОП. Перший етап каскадного методу полягає в тому, щоб передатну функцію проектованого фільтра *n*-го порядку подати у вигляді добутку передатних функцій більш низького:

$$H(p) = H_1(p) \cdot H_2(p) \dots H_m(p), \qquad (2.12)$$

де m=n/2, якщо n – парне і всі $H_{\kappa}(p)$ (k=1;2-m) другого порядку і m=(n+1)/2, якщо n – непарне, але одна з $H_{\kappa}(p)$ (k=1;2-m) – першого порядку.

Реалізація передатної функції *H(p)* відповідно з виразом (2.7) здійснюється за схемою рисунка 2.6, та наведена в додатку В.



Рисунок 2.6 – Каскадне з'єднання ланок

За умов відсутності взаємного впливу між каскадами, який забезпечується низьким вихідним опором ОП попередніх каскадів.

Для ланок першого порядку передатна функція має вигляд [11]

$$H(p) = \frac{M(p)}{P + \omega_p} \tag{2.13}$$

де ω_p – полюс передатної характеристики; M(P) – поліном нульового або першого порядку.

Для ланок другого порядку

$$H(p) = \frac{N(p)}{p^{2} + \frac{\omega_{p}}{q_{p}}p + \omega_{p}^{2}} , \qquad (2.14)$$

де ω_p – частота полюсу; q_p – добротність полюсу.

Для еліптичного фільтра другого і більше порядка передатна функція має вигляд:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{KC}{A} \left[\frac{p^2 + A\omega_{c\delta}^2}{p^2 + B\omega_{c\delta}p + C\omega_{c\delta}^2} \right]$$
(2.15)

Коефіцієнти *А*, *В*, *С* беруться у довідниках [11, додаток Б, В, Ґ] Загальна форма виразу (2.15) має вигляд [11]:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{\rho \left(p^2 + \alpha \omega_{c\delta}^2 \right)}{p^2 + \beta \omega_{c\delta} p + \gamma \omega_{c\delta}^2}, \qquad (2.16)$$

$$\exists e \ \rho = KC/A, \ \alpha = A, \ \beta = B, \ \gamma = C.$$
(2.17)

На рисунку 2.7 представлена типова лапка еліптичного ФНЧ на повторювачі напруги, яка найбільш широко використовуються при проектуванні фільтрів каскадним методо.. Схема названа так тому, що один із її ОП працює як повторювач напруги. Під схемою наведені співвідношення, які визначають основні параметри ФНЧ (частоту зрізу ω_{cp} , добротність полюсу q_p і коефіцієнт передачі на нульовій частоті H_0).





Для виразу (2.16) маємо

$$\begin{cases} \rho = -\frac{R_4}{R_5}; \\ \alpha \omega_{c^{\delta}}^2 = \frac{R_5}{R_1 R_2 R_4 C_1 C_2}; \\ \beta \omega_{c^{\delta}} = \frac{1}{R_2 C_2}; \\ \gamma \omega_{c^{\delta}}^2 = \frac{1}{R_2 R_3 C_1 C_2}. \end{cases}$$
(2.18)

Підставляючи у вираз (2.18) вираз (2.17) отримаємо

$$\begin{cases} R_{1} = -\frac{\beta}{\alpha \rho \omega_{\varsigma \delta} C_{1}} = \frac{\beta}{KC \omega_{\varsigma \delta} C_{1}} \\ R_{2} = \frac{1}{\beta \omega_{\varsigma \delta} C_{2}} = \frac{1}{B \omega_{\varsigma \delta} C_{2}}; \\ R_{3} = \frac{\beta}{\gamma \omega_{\varsigma \delta} C_{1}} = KR_{1}; \\ R_{4} = -\rho R_{5} = \frac{KCR_{5}}{A}. \end{cases}$$
(2.19)

Якщо добротність контуру і коефіцієнт передачі невеликі (менше 10), то ємності вибирають рівними $C_1 = C_2 = 10/f_{3p}$, мкФ, тобто

$$R_{5} = \frac{1}{\omega_{\varphi \delta} C_{1}}$$
(2.20)
$$\begin{cases} R_{1} = \frac{BR_{5}}{KC} \\ R_{2} = \frac{R_{5}}{B}; \\ R_{3} = \frac{BR_{5}}{C} = KR_{1}; \\ R_{4} = \frac{KCR_{5}}{A}. \end{cases}$$

Добротність контуру виражається коефіцієнтами В і С

$$q_p = \frac{\sqrt{C}}{B} \quad . \tag{2.22}$$

Співвідношення (2.16–2.21), отримані в припущенні ідеального ОП, який має нескінченний вхідний опір ($R_{ex} \rightarrow \infty$), нульовий вихідний опір ($R_{eax} = 0$) і нескінченний диференціальний коефіцієнт підсилення $K_0 \rightarrow \infty$. Оскільки існуючі ОП мають обмежені R_{eax} , K_0 і не нульовий вхідний опір, то наведені співвідношення наближено достовірні лише при виконанні умов реалізації. Крім того коефіцієнт підсилення ОП з розімкнутим зворотнім зв'язком повинен бути не менше ніж в 50 разів перевищувати значення АЧХ на частоті зрізу, а його швидкість наростання (вольт на мікросекунду) має в $0.5\omega_{c0}10^{-6}$ разів перевищувати максимальний розмах вихідної напрути.

Знайдемо передатну функцію для схеми еліптичного ФНЧ другого порядку на повторювачі напруги рисунка 2.7. Скористаємося виразом (2.16) і (2.16), отримаємо вираз для окремого каскаду ФНЧ:

$$H(p) = -\frac{R_3(p^2 R_1 R_2 R_4 C_1 C_2 + R_5)}{R_1 R_5(p^2 R_2 R_3 C_1 C_2 + p R_3 C_1 + 1)}$$
(2.23)

2.2 Чутливість характеристик і параметрів фільтрів до зміни параметрів елементів

Активні та пасивні параметри кола змінюються з температурою, із–за старіння й інших внутрішніх та зовнішніх причин. Ці варіації параметрів можуть викликати значні відхилення характеристики від початкової.

При проектуванні будь–якої технічної системи важливо знатн як відхилення параметрів елементів від розрахункових змінює характеристики і параметри системи порівняно з проектними.

Відхилення параметрів елементів відбувається за різних причин: через існуючі допуски на параметри елементів, внаслідок зміни температури, вологості, а інколи, тиску оточуючого середовища і старіння. Відхилення робочих характеристик фільтра від проектних викликані зміною параметрів, прийнято оцінювати чутливістю [14].

Чутливість характеристики або параметру фільтра до зміни параметра елемента визначається виразом

$$S_x^y = \frac{x}{y} \frac{\partial y}{\partial x} = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln x}, \qquad (2.24)$$

де під x слід розуміти параметри опорів, ємностей, коефіцієнт підсилення ОП тощо, а під y – передатну характеристику фільтра, його АЧХ, добротність, частоту полюсу і т.д.

Якщо характеристика або параметр фільтра комплексні, то чутливість також комплексна:

$$S_x^{y} = S_x^{|y|} + j \arg y \cdot S_x^{\arg y}, \qquad (2.25)$$

де $S_x^{|y|}$ – чутливість модуля, а $S_x^{\arg y}$ – чутливість арґументу. Тому зручніше оцінювати чутливість дійсних величин, маючи справу з модулями або арґументами, дійсними або уявними частинами величин комплексних.

Оскільки характеристики і параметри фільтрів залежать від баґатьох елементів, то для оцінки їх зміни при одночасній зміні параметрів баґатьох елементів користуються поняттям баґато параметричної чутливості, на найгірший випадок, яка визначається виразом [15].

$$S_{\Sigma}^{y} = \sum_{i} \left| S_{x_{i}}^{y} \right|, \qquad (2.26)$$

де сумування здійснюється по всім елементам. Відносні характеристики або параметри фільтра, викликані зміною баґатьох елементів визначаються

$$\frac{\Delta y}{y} \approx \sum_{i} S_{x_{i}}^{y} \frac{\Delta x_{i}}{x_{i}} \le \sum_{i} \left| S_{x_{i}}^{y} \right| \frac{\Delta x_{i}}{x_{i}} \right|, \qquad (2.27)$$

Якщо відносні зміни параметрів елементів не перевищують певну величину, тобто $|\Delta x_i||x_i| \le h$, то відносні зміни характеристик фільтра в найгіршому випадку задовольняють умові

$$\frac{\Delta y}{y} \le h \sum_{i} \left| S_{x_{i}}^{y} \right| = h * S_{\Sigma}^{y}.$$

$$(2.28)$$

Оцінка відносних змін характеристик фільтра для найґіршого випадку здебільше виявляється зависокою і потребує надмірних вимоґ на допуски елементів і їх стабільність. Тому в баґатьох випадках користуються статистичною параметричною чутливістю, яка враховує ймовірність певного відхилення параметрів елементу від оптимального значення [15]. Статистична баґатопараметрична чутливістю визначається виразом: (критерій Скоефлера)

$$S_{\sqrt{}}^{y} = \sqrt{\sum_{i} \left(S_{x_{i}}^{y}\right)^{2}} .$$
 (2.29)

При достатньо великій кількості елементів фільтра і статистично незалежних відхиленнях їх параметрів, розподіл відносних відхилень характеристик фільтра $\Delta y/y$ наближається до нормального закону з нульовим середнім і дисперсією

$$\sigma_{\Delta y/y}^2 = \sum_i \left(S_{x_i}^y \right)^2 \sigma^2_{\Delta x_i/x_i} , \qquad (2.30)$$

де $\sigma^2 \Delta x_i / x_i$ – дисперсія і-го елемента яка для нормального закону становить $h_i^2 / 9$ (h_i – допуск на елемент).

Якщо допуски на всі елементи і закон розподілу однакові, то

$$\sigma_{\Delta y/y} = \sigma_{\Delta x/x} \sqrt{\sum \left(S_{x_i}\right)^2} = \sqrt{\sigma_{\Delta x/x} * S_{\Sigma^2}^y} .$$
(2.31)

З властивостей нормального закону випливає, що в 68% випадків відхилення характеристики фільтра буде лежати в межах $\pm \sigma_{\Delta y/y}$, в 95% випадків в межах $\pm 2\sigma_{\Delta y/y}$, і в 99,7% випадків – в межах $\pm 3\sigma_{\Delta y/y}$.

Статистична багато параметрична чутливість хоч і знижує вимоги на допуски елементів, але не дає стовідсоткової гарантії, що характеристики фільтра не вийдуть за допустимі межі.

2.3 Настроювання активних фільтрів

за різних попередньому розділі наґолошувалось, В ЩО причин фільтра відхилятися характеристики можуть від проектних. Але i безпосередньо після виґотовлення характеристики фільтра можуть не відповідати проектним. В такому випадку фільтр або окремо його ланки потребують настроювання [9].

Настроювання фільтра спрощується якщо відомий заґальний вигляд АЧХ кожної ланки і їх характерні точки. На рисунку 2.8 зображені два можливих варіанти АЧХ ланки ФНЧ другого порядку, та наведені в додатку Е [11].



Рисунок 2.8 – Амплітудно–частотні характеристики еліптичного ФНЧ а) з підйомом в смузі пропускання; б) без підйому

Оскільки проектування фільтра здійснюється на підставі більш жорстких вимог до АЧХ, то при настроюванні треба орієнтуватись на отримання потрібного значення АЧХ на частоті зрізу. Максимум в смузі пропускання K_m і частотою f_m , на якій він знаходиться, розраховується за формулою

$$K_{m} = \frac{2KC}{AB} \sqrt{\frac{(A-C)^{2} + AB^{2}}{4C - B^{2}}},$$
 (2.32)

$$f_m = f_{c^{\delta}} \sqrt{\frac{2C(A-C) - AB^2}{2(A-C) + B^2}} \quad .$$
 (2.33)

Якщо значення *K_m* незначне, то підйом відсутній. Частота затримки *f_Z* для обох випадків рисунка 2.8 розраховується

$$f_z = f_{c\bar{o}}\sqrt{A} , \qquad (2.34)$$

а значення АЧХ на частоті зрізу

$$K_{c} = \frac{KC}{A} \frac{|A-1|}{\sqrt{(C-1)^{2} + B^{2}}}$$
(2.35)

Значення параметрів ω_z , ω_m і K_m/K для кожного каскаду фільтра WZ, WM, KM приведені в довіднику [11, додаток В].

Для настройки схеми фільтра (рисунок 2.7) необхідно підстроїти:

1) відношення $\frac{R_4}{R_5}$ для встановлення максимального подавлення на частоті f_z ;

2) опір R_2 для отримання потрібного значення K_m .

При необхідності цей етап повторюють, аж до досяґнення потрібних параметрів АЧХ.

З РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОГО ФНЧ

3.1 Вибір та обґрунтування структурної схеми

При реалізації ФНЧ із заданими характеристиками, як це відмічалось у попередньому розділі, необхідно визначити порядок ФНЧ. На рисунку 3.1 показана залежність еліптичного ФНЧ від його порядку. Звісно, чим більший порядок фільтра, тим кращі параметри перехідної області, максимального і мінімального ослаблення в смугах пропускання і затримки (рисунок 3.5).



Рисунок 3.1 – Залежність АЧХ еліптичного ФНЧ від його порядку

Оцінимо порядок еліптичного ФНЧ :

1) знайдемо нормоване значення перехідної смуги ТW за формулою

$$\overline{TW} = \frac{TW}{f_{c\delta}}$$
(3.1)

$$\overline{TW} = \frac{2\pi \cdot 0.1 \cdot 10^3}{2\pi \cdot 4 \cdot 10^3} = 0.025$$
(3.2)

2) звертаємося до довідника [11, додаток Ґ], де для *PRW*=1 дб, *MSL*=40дб і *TW* =0,0217<0,025 порядок фільтра *n*=8.

Отже приймаємо порядок фільтра *n*=8.

Таким чином ФНЧ можна реалізовувати чотирма ланками другого порядку. На рисунку 3.2 представлена структурна схема ФНЧ, де кожна ланка має другий порядок, та наведена в додатку Д.



Рисунок 3.2 – Попередня структурна схема еліптичного ФНЧ

3.2 Визначення порядку розташування ланок і їх параметрів

Критерії, якими керуються при розташуванні ланок, суперечливі, але найважливішими з них є [9].

1. При спряжені двох ланок спектр сиґналу в смузі пропускання має лишатись найбільш плоским.

2. Добротність полюсів каскадноз'єднаних ланок зростає від входу до виходу.

Для задовільнення сформульованих критеріїв при розташуванні ланок необхідно знати властивості ланок а саме їх АЧХ і добротність полюсів. Для цього знайдемо у довіднику [11] нормовані коефіцієнти для кожної ланки ФНЧ 8-го порядку.

		-	-			
Каскад	Α	В	С	WZ	WM	KM
1	1,129122	0,609001	0,249212	1,062601	0,096392	1,000662
2	8,150176	0,231332	0,727916	2,854851	0,834282	3,403410
3	1,580334	0,059160	0,944858	1,257113	0,968465	6,655206
4	1,050274	0,010823	0,999867	1,024829	0,998743	4,540179

Таблиця 3.1 – Нормовані коефіцієнти для кожної ланки ФНЧ 8-го порядку

Коефіцієнт підсилення ланок мають задовольняти вимозі

$$H_0 = H_{01} H_{02} H_{03} H_{04}, \tag{3.3}$$

де H_{01} , H_{02} , H_{03} - коефіцієнт підсилення 1-4-ї ланки на нульовій частоті. Знайдемо коефіцієнт передачі кожної ланки фільтра

$$K_{\hat{O}f\times} = K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot K_4, \qquad (3.4)$$

де $K_{\partial f \times}$ - коефіцієнт передачі на нульовій частоті всього фільтра, $K_{\partial f \times}$ =10. Якщо коефіцієнти передачі каскадів однакові, то $K_1 = K_2 = K_3 = K_4$, тому

$$K_{\hat{O}f_{\times}} = K^4, \ K = K_{\hat{O}f_{\times}}^{1/4}$$
 (3.5)
 $K = 10^{1/4} = 1.778279.$

Тоді коефіцієнт передачі окремої ланки складає К = 1,778279.

Знайдемо добротність кожної ланки, використовуючи формулу (2.22) і нормовані коефіцієнти ланок за таблицею 3.1, тоді

$$q_1 = \frac{\sqrt{0.249212}}{0.609001} = 0.82 \tag{3.6}$$

$$q_2 = \frac{\sqrt{0,727916}}{0,231332} = 3,69 \tag{3.7}$$

$$q_3 = \frac{\sqrt{0.944858}}{0.053160} = 16,43 \tag{3.8}$$

$$q_4 = \frac{\sqrt{0,999867}}{0,010823} = 92,38 \tag{3.9}$$

Таким чином, остаточна структурна схема ФНЧ з еліптичною АЧХ на повторювачі напруги набуває вигляду (рисунок 3.3)



Рисунок 3.3 – Структурна схема ФНЧ з еліптичною АЧХ на повторювачі напруги

3.3 Визначення принципової схеми фільтра

Для реалізації ФНЧ на повторювачі напруги використаємо схему рисунка 2.7. Дана схема використовується для реалізації ланок з добротностями і коефіцієнтами підсилення як вище, так і нижче 10 [16]. За цими критеріями схема еліптичного ФНЧ на повторювачі напруги може використовуватись для реалізації ланок проектуємого фільтра. Оскільки за технічним завданням фільтра в цілому має бути неінвертуючим, то при використанні інвертуючи ланок їх кількість має бути парною. З'єднання ланок здійснюється послідовно.

Таким чином принципова схема проектуємого еліптичного ФНЧ набуває вигляду рисунок 3.4.



Рисунок 3.4 – Принципова схема ФНЧ 8-го порядку

3.4 Розрахунок параметрів пасивних елементів ланки ФНЧ з еліптичною АЧХ

Розрахуємо параметри елементів 1-го каскаду ФНЧ [11]

$$C_1 = \frac{10}{f_{_{3p}}} \cdot 10^{-6} = \frac{10}{4 \cdot 10^3} \cdot 10^{-6} = 2,5 \cdot 10^{-9} \ (\Phi).$$
(3.10)

Оскільки, добротність 1-го каскаду q = 0.82 < 10, то $C_1 = C_2 = 2.5 \cdot 10^{-9} \Phi$.

Підставивши знайдені ємності у вирази (2.20) і (2.21), отримаємо

$$\omega_{c\delta} = 2\pi f_{c\delta} = 2 \cdot 3,14 \cdot 4000 = 25133 \text{ (рад/с)}$$

 $R_5 = \frac{1}{\omega_{c\delta}C_1} = \frac{1}{25133 \cdot 2,5 \cdot 10^{-9}} = 15915 \text{ (Ом)}$
(3.11)

Нормовані коефіцієнти А, В, С беремо з таблиці 3.1 для відповідного каскаду

$$R_1 = \frac{BR_5}{KC} = \frac{0,609001 \cdot 15915}{1,7782 \cdot 0,249212} = 21871 \text{ (Om)},$$

$$R_2 = \frac{R_5}{B} = \frac{15915}{0,609001} = 26133 \text{ (Om)},$$

$$R_3 = KR_1 = 1,7782 \cdot 21871 = 38892$$
 (OM),

$$R_4 = \frac{KCR_5}{A} = \frac{1,7782 \cdot 0,249212 \cdot 15915}{1,129122} = 6246$$
(OM).

Результати розрахунків, а також найближчі номінальні значення параметрів елементів наведені у таблиці 3.2

Таблиця 3.2- Результати розрахунків параметрів елементів 1-го каскаду

Параметри елементів	<i>С</i> ₁ , нФ	<i>C</i> ₂ , нФ	<i>R</i> ₁ , Ом	<i>R</i> ₂ , Ом	<i>R</i> ₃ , Ом	<i>R</i> ₄ , Ом	<i>R</i> ₅ , Ом
Розрахунко ві значення	2,5	2,5	21871	26133	38892	6246	15915
Номінальні	1,2+1,3	1,2+1,3	20000+180	24000+220 0	36000+30	6200+47	15000+91
значення			0	24000+2700	00	6200+68	U

В таблиці 3.2, в рядку номінальні значення, вказані два варіанти реалізації опорів: верхній — постійними опорами і нижній, в якому менший опір підстроєчний. Підстроєчні резистори вибираються згідно пункту 2.4, щоб досягти максимальної і зручної настройки фільтра.

Аналогічно розраховуємо параметри елементів для 2-го каскаду

Параметри елементів	<i>С</i> ₁ , нФ	C_2 , нФ	<i>R</i> ₁ , Ом	<i>R</i> ₂ , Ом	<i>R</i> ₃ , Ом	<i>R</i> ₄ , Ом	<i>R</i> ₅ , Ом
Розрахунко ві значення	2,5	2,5	2844	68799	5058	2527	15915
Номінальні	1.2+1.2	1.2+1.2	2700+15	68000+820	4700+260	2400+120	15000+9
значення	1,2+1,5	1,2+1,5	0	68000+1000	4700+300	2400+150	10

Таблиця 3.3 - Результати розрахунків параметрів елементів 2-го каскаду

Добротність 3-го і 4-го каскаду більше 10, тобто параметри елементів розраховуємо за формулою (2.19), а C_2 і R_5 , вибираємо так, щоб розкид параметрів опорів був незначний. Причому, $C_2 >> C_1$.

Розрахуємо параметри елементів 3-го каскаду ФНЧ. Вибираємо R_5 =1000 *Ом*, а C_2 =1 *мкФ*, тоді

$$\begin{split} R_1 &= \frac{B}{KC\omega_{_{3p}}C_1} = \frac{0,059160}{1,7782 \cdot 0,944858 \cdot 25132 \cdot 2,5 \cdot 10^{-9}} = 560 \ (Om), \\ R_2 &= \frac{1}{B\omega_{_{3p}}C_2} = \frac{1}{0,059160 \cdot 25132 \cdot 1 \cdot 10^{-6}} = 672 \ (Om), \\ R_3 &= KR_1 = 1,7782 \cdot 560 = 996 \ (Om), \\ R_4 &= \frac{KCR_5}{A} = \frac{1,7782 \cdot 0,944858 \cdot 1000}{1,580334} = 1063 \ (Om). \end{split}$$

Таблиця 3.4- Результати розрахунків параметрів елементів 3-го каскаду

Параметри елементів	C_1 , нФ	С ₂ ,мкФ	<i>R</i> ₁ , Ом	<i>R</i> ₂ , Ом	<i>R</i> ₃ , Ом	<i>R</i> ₄ , Ом	<i>R</i> ₅ , Ом	
Розрахунко ві значення	2,5	1,0	560	672,5	996,5	1063	1000	
Номінальні	12113	1212 10	560	620+51	750+240	1000+62	1000	
значення	1,2+1,3	1,0	500	620+68	730+240	1000+68	1000	

Аналогічно розраховується параметри елементів 4-го каскаду принципової схеми рисунка 3.2.

Параметри	C_1 ,	C_2	R_{1} ,	R Om	R Om	R Om	R Om	
елементів	нΦ	,мкФ	Ом	n_2, om	n_3, om	κ_4, ∞	n_5, om	
Розрахунко ві значення	2,5	24	96,8	153	172	169	100	
Номінальні	1,2+1,	2212	91+6,	150+3	160+12	160+9,1	100	
значення	3		2	100+68		120+68	100	

Таблиця 3.5 - Результати розрахунків параметрів елементів 4-го каскаду

3.5 Вибір операційного підсилювача

Визначення параметрів елементів фільтра проведено для ідеального операційного підсилювача, який має необмежений коефіцієнт підсилення в необмеженому проміжку частот, нескінченний вхідний і нульовий вихідний необмежену швидкість зростання a також вихідної напруги. опори, ОΠ Характеристики реальних значно поступаються характеристикам ідеального. Тому при виборі ОП повинні виконуватись ряд вимог, які називають умовами реалізації. При остаточному виборі параметрів елементів ланок умови реалізації враховується в припущенні, що вхідний і вихідний опір ОП становлять відповідно 1 МОм і 100 Ом.

Крім умов реалізації, що накладають певні обмеження на вхідний і вихідний опори ОП, його частота одиничного підсилення повинна задовольняти умові [12].

$$f_1 \ge f_{3p} H_0,$$

де H_0 - коефіцієнт підсилення каскаду f_1 - частота одиничного підсилення ОП, а f_{sp} - частота зрізу фільтра. Оскільки у всіх каскадів ФНЧ коефіцієнт підсилення не перевищує 1,78, а частота $f_{sp} = 4000 I'u$, то частота одиничного підсилення ОП повинна бути не меншою 7120 I'u.

Коефіцієнт підсилення операційного підсилювача з розімкнутим зворотнім зв'язком повинен в крайньому разі в 50 разів перевищувати коефіцієнт підсилення в робочому режимі. Оскільки коефіцієнт підсилення ланок фільтра не перевищує 1,78 при досить низькій верхній частоті зрізу f_{sp} =4000 *Гų*, то цій вимозі задовольняє більшість сучасних ОП, в тому числі ОП UAF774. На рис. 3.5 представлена схема включення інтегральної мікросхеми UAF774, та наведена в додатку Ж.



Рисунок 3.5 – Схема включення интегральної мікросхеми UAF774

Позначення		Позначення	
виводу	призначення виводу	виводу	призначення виводу
1	Вихід-1	8	Вихід-З
2	Вхід інвертувальний-1	9	Вхід інвертувальний-3
3	Вхід неінвертувальний-1	10	Вхід неінвертувальний-3
4	$+U_{_{\mathscr{H}}}$	11	- $U_{_{\mathcal{H}}}$
5	Вхід неінвертувальний-2	12	Вхід неінвертувальний-4
6	Вхід інвертувальний-2	13	Вхід інвертувальний-4
7	Вихід-2	14	Вихід-4

Таблиця 3.6 – Таблиця призначення виводів

Перевіримо також виконання вимоґи до швидкості зростання вихідної напруґи і її максимальної амплітуди. Швидкість зростання вихідної напруґи (В/мкс) при якій не виникають нелінійні спотворення, повинна перевищувати $0,5\omega_{3p}\cdot 2\cdot 10^{-6}U_{gux.max}$, тобто $Uu > 0,5\omega_{3p}\cdot 2\cdot 10^{-6}U_{gux.max}$. Для ОП UAF774 $Uu = 10B / M\kappa c$, $U_{gux.max} = 10B$, а частота зрізу фільтра $f_{3p} = 4000\Gamma u$. Тому права частина нерівності складає $0,04B / M\kappa c$, що значно менше лівої частини. Таким чином ОП UAF774 задовольняє вимоґам до підсилювального елементу фільтра.

Чутливість характеристик ланок еліптичного ФНЧ до зміни параметрів елементів

Оскільки проектування фільтра здійснюється за вимоґами до АЧХ, то найбільший інтерес являє чутливість саме АЧХ до зміни параметрів елементів. Аналіз чутливості АЧХ дозволяє визначити допуски на параметри пасивних елементів.

Існують декілька методів визначення чутливості АЧХ, але для кіл з обмеженою кількістю елементів найбільш ефективним є метод символьних функцій [18]. Для його використання необхідно мати аналітичний вираз для передатної функції. Аналітичні вирази для передатних функцій ланок еліптичного ФНЧ визначаються з виразу (2.23) і мають вигляд:

$$H(p) = -\frac{R_3(p^2 R_1 R_2 R_4 C_1 C_2 + R_5)}{R_1 R_5(p^2 R_2 R_3 C_1 C_2 + p R_3 C_1 + 1)},$$

де $p = j\omega$.

Чутливості АЧХ каскадів ФНЧ знайдені на підставі виразів (2.23), (2.24), з використанням параметрів елементів наведених у таблиці 3.2-3.6, визначаються співвідношеннями:

$$H(p) = -\frac{R_3 \left(p^2 R_1 R_2 R_4 C_1 C_2 + R_5 \right)}{R_1 R_5 \left(p^2 R_2 R_3 C_1 C_2 + p R_3 C_1 + 1 \right)} = \frac{N}{D}, \qquad (3.11)$$

$$S = D - \frac{1}{H}N = R_1 R_5 \left(p^2 R_2 R_3 C_1 C_2 + p R_3 C_1 + 1 \right) + \frac{1}{H} R_3 \left(p^2 R_1 R_2 R_4 C_1 C_2 + R_5 \right), \quad (3.12)$$

$$\text{Je } D = R_1 R_5 \left(p^2 R_2 R_3 C_1 C_2 + p R_3 C_1 + 1 \right).$$

Знайдемо вирази чутливості для кожного елемента каскаду:

$$S_{C1}^{H} = \frac{R_1 \cdot R_5 + R_3 \cdot R_5 \cdot H^{-1}}{D}, \qquad (3.13)$$

$$S_{C2}^{H} = \frac{R_1 \cdot R_5 (p \cdot R_3 \cdot C_1 + 1) + R_3 \cdot R_5 \cdot H^{-1}}{D}, \qquad (3.14)$$

$$S_{R1}^{H} = \frac{R_3 \cdot R_5 \cdot H^{-1}}{D}, \qquad (3.15)$$

$$S_{R2}^{H} = \frac{R_1 \cdot R_5 (p \cdot R_3 \cdot C_1 + 1) + R_3 \cdot R_5 \cdot H^{-1}}{D}, \qquad (3.16)$$

$$S_{R_3}^{H} = \frac{R_1 \cdot R_5}{D}, \qquad (3.17)$$

$$S_{R4}^{H} = \frac{R_1 \cdot R_5 \left(p^2 \cdot R_2 \cdot R_3 \cdot C_1 \cdot C_2 + p \cdot R_3 \cdot C_1 + 1 \right) + R_3 \cdot R_5 \cdot H^{-1}}{D}, \qquad (3.18)$$

$$S_{R5}^{H} = \frac{p^{2} \cdot R_{1} \cdot R_{2} \cdot R_{3} \cdot R_{4} \cdot C_{1} \cdot C_{2} \cdot H^{-1}}{D}.$$
 (3.19)

Аналогічні співвідношення мають місце і для інших ланок ФНЧ. Переходячи від операторної функції до комплексних чисел, знаходимо відповідні значення чутливості з виразів (3.11) - (3.19). В таблиці 3.7 наведені значення чутливостей ланок ФНЧ, розраховані на частоті зрізу.

Таблиця 3.7 – Розраховані показники чутливості елементів для кожного каскаду еліптичного ФНЧ

Ланка	N	D	H^{-1}	S	Чутливість
				S_{C1}^{H}	-8,479
				S_{C2}^{H}	8,503
				S_{R1}^{H}	-8,737
1	$-70,843 \cdot 10^{6}$	$1,35 \cdot 10^9$	-19.059	S_{R2}^H	8,503
				S_{R3}^{H}	0,258
				S_{R4}^H	9,535
				S_{R5}^{H}	7,737
				S_{C1}^{H}	0,898
				S_{C2}^{H}	1,108
				S_{R1}^{H}	-1,14
2	$-70,62 \cdot 10^6$	-16,9·10 ⁶	-0,314	S_{R2}^{H}	1,108
				S_{R3}^{H}	2,038
				S_{R4}^H	2,009
				S_{R5}^{H}	0,14
	$-16,52 \cdot 10^3$	9,278·10 ³	-0,562	S_{C1}^{H}	0,002
				S_{C2}^{H}	0,011
				S_{R1}^{H}	-1,041
3				S_{R2}^{H}	0,011
				S_{R3}^{H}	1,043
				S_{R4}^H	0,043
				S_{R5}^{H}	0,041
Ланка	N	D	H^{-1}	S	Чутливість
				S_{C1}^{H}	7,042
				S_{C2}^{H}	7,042
				S_{R1}^{H}	-1,945
4	-884,08	107,7	-0,122	S_{R2}^H	7,042
				S_{R3}^{H}	8,987
				S_{R4}^H	1,924
				S_{R5}^{H}	1,845

3.6 Визначення допусків на параметри елементів

Оскільки передатна характеристика еліптичного ФНЧ визначається виразом (2.23), то передатна АЧХ також визначається добутком передатних АЧХ окремих ланок. Тому, при визначенні чутливості ФНЧ до зміни параметрів елементів ланок виразом (2.24), чутливість всього фільтра збігається з відповідною чутливістю ланки [9].

Розрахуємо чутливість АЧХ фільтра для найґіршого випадку за співвідношенням (2.26) і даними таблиці 5.4 на частоті зрізу

$$S_{\Sigma}^{|H(\omega)|} = 56.8 . \tag{3.20}$$

Визначення параметрів елементів ФНЧ проведено на підставі A_{max}=0,7дБ, в той час, як за технічним завданням A_{max}=1дБ, різниця A_{max}=0,3дБ є допуском на відхилення постійної ослаблення, обумовленим розкидом параметрів елементів. Відносне відхилення АЧХ з відхиленням постійної ослаблення, пов'язані співвідношенням

$$\frac{\Delta H(\omega)}{H(\omega)} = 10^{0.05 \Delta A_{\text{max}}} - 1 \approx 3,5142 \cdot 10^{-2}.$$
(3.21)

Оскільки відносні відхилення АЧХ пов'язані за чутливістю для найгіршого випадку співвідношеннями (2.27), то з врахованим (3.20) отримаємо

$$\frac{\Delta H(\omega)}{H(\omega)} \le h S_{\Sigma}^{|H(\omega)|} \le 3,5142 \cdot 10^{-2} . \tag{3.22}$$

Для частоти зрізу f=4000 Ґц, на якій чутливість на найгірший випадок максимальна, допуск на елемент складає

$$h = \frac{\Delta X}{X} \le 6,187 \cdot 10^{-4} . \tag{3.23}$$

Отриману величину допуску технічно реалізувати складно. Тому необхідно відмовитись від визначення допуску на параметри елементів на підставі критерію, орієнтованого на найгірший варіант, який забезпечує стовідсоткову гарантію реалізації АЧХ в заданих межах.

Скористаємось статистичною багато параметричною чутливістю (критерієм Скоефлера) (2.35). Результати розрахунку статистичної багато параметричної чутливості

$$S_{\sqrt{}}^{|H(\omega)|} = 26,7.$$
 (3.24)

За умов, що допуски на всі елементи і функція розподілу ймовірностей відхилень параметрів елементів від номінального значення однакове, середньостатистичне відхилення АЧХ від проектного значення виражається виразом (2.30), який для частоти *f*=4000Гц записується

$$\sigma_{\Delta H_{H}} = 26.7 \sigma_{\Delta X_{X}} \tag{3.25}$$

Для нормального закону розподілу ймовірностей відхилень

$$\sigma_{\Delta X/_{v}} = h/3$$
,

Оскільки відносні відхилення АЧХ від розрахункового значення не повинні виходити за межі, визначені виразом (5.4), то в 68% випадків АЧХ не буде відхилятись за межі $\sigma_{\Delta H_{/H}}$ якщо допуски на параметри елементів задовольняють умові [19].

$$3,5142 \cdot 10^{-2} \ge 26,7 \cdot \frac{h}{3}$$

звідки знаходимо $h \le 3,949 \cdot 10^{-3}$.

Таким чином за статистичною баґато параметричною чутливістю вимоґи на допуски досить жорсткі (менше 0,4%). Звідси випливає, що для реалізації ФНЧ на елементах з допуском більше 0,4% обов'язкова настройка фільтра. Вибираємо резистори і конденсатори з допуском 5%, але послідовно з постійними (основними) опорами вмикаємо підстроєчні опори. Номінальні значення постійних і послідовного з ними включених підстроєних опорів наведені у таблиці 3.2 таблиці 3.6. 3.7 Моделювання активного RC – фільтра НЧ з еліптичною АЧХ на ОЕМ

Для досліджень параметрів і характеристик реалізації схемних рішень було розроблено велика кількість програм. За допомогою них можна провести повний схематичний аналіз складних пристроїв. Це програмне забезпечення відрізняється рівнем та кількістю запропонованих тестів для схем, зручностями для користувачів те елементною базою.

Розглянемо переваги та недоліки деяких програм.

МісгоСар V – має великі можливості щодо різних варіантів тестування схем як по змінному так і постійному струму, є можливість кореґування параметрів. Досить незручна у користуванні і призначена більше для одержання параметрів і характеристик уже ґотової статичної схеми, ніж для динамічного моделювання та зміни варіантів схеми. Є можливість визначати карти напруг, розсіюванної потужності. Для користувача є недолік – це незручний інтерфейс.

Electronic Work Bench – має ті ж можливості, як і Місго Сар V, але має зручніший інтерфейс. ЩО схожий до лабораторних умов. Програма максимізована для динамічних досліджень; дозволяє працювати ЯК аналоговими так із цифровою схемотехнікою; має невеликий, але достатній набір можливих тестів; елементна база програми досить широка; ґнучке збереження результатів; для активних і пасивних елементів є можливість зміни їх параметрів.

Враховуючи ці недоліки та переваґи для моделювання ФНЧ буде використана проґрама Electronic Work Bench. Даний пакет проґрам дозволяє отримати амплітудні та фазочастотні характеристики електричних кіл або їх частин, дозволяє проводити практично всі дослідження схеми з використанням як аналоґових елементів, так і цифрових, а також різноманітноґо їх поєднання.

Побудова схеми відбувається за допомогою маніпулятора "миші" та меню, що постійно відображене на екрані. Параметри елементів легко вводяться та при необхідності корегуються. Типи елементів вводяться з довідника або при їх відсутності задаються користувачем. Також програма дозволяє варіювати, як параметрами елементів, так і параметрами джерел сигналу (гармонійні, імпульсні).

Оскільки "Electronics Work Bench" не має повних аналогів серед зарубіжної елементної бази, то в пакет для аналізу були введені ідеальні мікросхеми, резистори і конденсатори.

Моделювання фільтра на ОЕМ має на меті визначення амплітудночастотних характеристик окремих ланок і всього фільтра, а також побудова графіків АЧХ для розрахункових і номінальних значень параметрів елементів при ідеальному операційному підсилювачі. Складаючи схему ФНЧ (рисунок 3.6), ми використовували ідеальні елемети без розкиду вихідних параметрів. Відповідні графіки АЧХ кожної ланки зображені на рисунку 3.7, а на рисунку 3.8 зображена АЧХ з виходу ФНЧ, та наведені в додатку К.1 і К.2.



Рисунок 3.6 – Модель схеми ФНЧ у програмі "Electronics Workbench"



Рисунок 3.7 – АЧХ з виходу 1-го – 4-го каскаду ФНЧ



Рисунок 3.8 – АЧХ каскадного з'єднання всіх ланок ФНЧ

Графіки каскадного з'єднання ланок ФНЧ для розрахункових значень елементів повністю відповідають проектним, вони майже не виходять за межі планованих допусків (рисунок 3.8). Амплітудно – частотна характеристика виявилась рівно хвилевою. Для номінальних значень параметрів елементів має місце незначне відхилення АЧХ окремих ланок, однак цей недолік незначний, оскільки йоґо можна виплавити за допомоґою підстроювальних резисторів.

3.8 Висновки до розділу

1. Розрахований та досліджений активний RC – фільтр низьких частот з еліптичною AЧХ. Розрахунки відповідають вимогам технічного завдання. Був вибраний і обґрунтований метод побудови фільтра, розроблена заґальна структурна схема фільтра і розраховані значення номіналів елементів фільтра. За результатами розрахунку номіналів елементів фільтру, були вибрані конкретні типи елементів із стандартного ряду номіналів. Передбачене реґулювання AЧХ фільтра за допомогою підстроєчних опорів.

2. Ємності окремих каскадів фільтра реалізуються послідовним з'єднанням конденсаторів з номінальними значеннями так, щоб отримати результуючі ємності близькими до розрахункових. При чому за рахунок розкиду ємностей конденсаторів пропонується підбирати конденсатори з потрібним значенням ємностей. Крім того був проведений розрахунок чутливості АЧХ фільтра до зміни номіналів елементів.

4 МЕТОДИ РОЗРОБКИ АКТИВНИХ ВЧ НЧ ФІЛЬТРІВ

Сьогодні завдяки збільшеному верхньої межі робочої частоти транзисторів і операційних підсилювачів струму, схеми на їх основі можуть бути застосовані в різних високочастотних пристроях. Такими є LCосцилятори, ВЧ смугові фільтри і фазообертачі, що обмежують підсилювачі для оптичних комунікацій, малошумні підсилювачі для бездротового зв'язку, ВЧ подільники потужності, надширокосмугові малошумні підсилювачі 1 трансивери для високошвидкісного обміну даними в дротяних лініях передач. Такі компоненти цікаві своїми особливостями: займає невелику площу на високі значення імітованих індуктивностей кристалі, 3 можливою підстроювання, високі показники перебудовується добротності, можливість зсуву власної резонансної частоти, а також сумісність зі стандартною кремнієвої технологією.

Застосування активних елементів в схемах високочастотних фільтрів на п'єзоелектричних резонаторах має на увазі два можливі підходи. Перший підхід полягає в модифікації існуючих схем фільтрів з метою поліпшення їх характеристик або розширення функціональних можливостей. Іншим шляхом є розробка принципово інших схемних рішень, специфічних з точки зору застосування активних елементів або унікальних в плані передавальних характеристик. Представлені далі, є прикладом першого підходу і описують можливості імітації індуктивності і від'ємної ємності для послідовного / поверхнево акустичних хвилях підключення до резонаторам в традиційних сходових і мостових п'езофільтр на п'єзоелектричного резонатора.

4.1 Переналаштувальні навантаження та їх вплив

Частотні характеристики резонаторів, зокрема, резонансна частота, перебудовуються за допомогою відповідних навантажень, що підключаються поверхнево акустичних хвилях або послідовно з резонатором (рисунок 4.1).

Подстроечного навантаження може бути реалізована у формі варактора або перебудовується котушки індуктивності. В даному розділі проводиться аналіз впливу різних варіантів підключення навантаження на частотні властивості резонатора.

Адміттанс ненаґруженного резонатора без втрат (рисунок 4.1), а) описується виразом



Рисунок 4.1 – Ненавантажена і навантажена еквівалентні схеми резонатора яке може бути переписано в наступному виґляді:

$$Y = \frac{iwC_0(1 - w^2 L_m C_m) + iwC_m}{1 - w^2 L_m C_m}$$
(4.2)

На частоті послідовного резонансу,, величина адміттанса Y резонатора прямує до нескінченності, відповідно, знаменник $w = w_s$

$$1 - w_s^2 L_m C_m = 0 (4.3)$$

Отже, частота послідовного резонансу знаходиться з виразу

$$w_{s0} = \frac{1}{\sqrt{L_m C_m}} \tag{4.4}$$

а на частоті поверхнево акустичних хвилях резонансу, при якому адмітанс стає рівним нулю:

$$w_{p0}C_0(1 - w_{p0}L_mC_m) + w_{p0}C_m = 0 ag{0.5}$$

Звідси отримуємо вираз для частоти поверхнево акустичних хвилях резонансу:

$$w_{p0} = w_{s0} \sqrt{1 + \frac{C_m}{C_0}}$$
(4.6)

При цьому ws i wp ϵ частотами ненаґруженого резонатора (рисунок 4.2).



Рисунок 4.2 – Залежність вхідного імпедансу ненаґруженного резонатора від частоти

Для реалізації варактора застосовуються різні технології: напівпровідникова, МЕМС і на основі ферроелектриків. На рисунок 4.3 представлені вольт-фарадні характеристики таких варакторів.



Рисунок 4.3 – Вольт–фарадні характеристики МЕМС (а), напівпровідникових (b) і ферроелектріческіх (c) варакторов

Низький рівень споживання енергії, висока швидкістю перебудови, широкий діапазон перебудови в міліметровому і субміліметровому діапазонах частот, а також невеликі габарити і інтеґрованість є найбільш важливими вимоґами до варакторів при їх застосуванні в високочастотних фільтрах на основі резонаторів.

Залежно від необхідного діапазону перебудови, навантажувальний конденсатор може бути як варакторів, так і перебудовується конденсаторної

батареєю. Варактори мають обмежений діапазон перебудови, в той час як конденсаторні батареї можуть включати елементи широкого діапазону значень. Відносна перестраіваемость варактора може бути визначена як

$$T(C) = \frac{C_{max} - C_{min}}{C_{max}}$$
(4.7)

За аналогією, відносна перестраіваємість котушки індуктивності визначається як

$$T(L) = \frac{L_{max} - L_{min}}{L_{max}} \tag{4.8}$$

Зміни в значеннях ємності і індуктивності можуть бути викликані електричним полем, температурою, маґнітним полем і іншими факторами.

МЕМС і НЕМС варактори мають малі втрати, не вимаґають значних енерговитрат на перемикання і потенційно мають можливість монолітної інтеграції. Незважаючи на те, що ідея, що лежить в основі МЕМС пристроїв, дуже проста, великомасштабне комерційне застосування перебудовуються МЕМС приладів пов'язано з безліччю труднощів. Вони вимагають вакуумної упаковки, страждають від проблем залипання, надійності і температурної стабільності. Проектування і виґотовлення МЕМС варакторов з аналоґової перебудовою дуже складні, а вихідні пристрої мають низьку добротність і перебудови порівнянні напівпровідниковими діапазон (в 3 i ферроелектричними). HEMC пристрої значний потенціал i мають В майбутньому можуть стати основною технологією реалізації інтегрованих перебудовуються пристроїв, здатних працювати частотах, порівнянних з напівпровідниковими пристроями. Ферроелектричні i гетероперехідні варактори мають симетричну вольт-фарадні характеристику, а значить не чутливі до полярності прикладається напруґи, що може бути переваґою в деяких схемах.

Напівпровідникові варактори (перехідні, гетероперехідні, Шотткі, МОП та ін.) І транзистори найбільш часто застосовуються в перебудовуються високочастотних пристроях. Одне з найбільш значущих переваґ таких пристроїв – висока щільність інтеґрації. Перебудовуванні напівпровідникові НВЧ пристрої економічно найбільш ефективні і застосовуються як в комерційних, так і в оборонних системах. Транзистори на основі Si, SiGe, GaAs і ІпР задовольняють більшості вимоґ сучасних високочастотних систем, однак показники добротності і швидкості перемикання досить низькі, особливо в діапазоні НВЧ. Існують конструкції напівпровідникових варакторів з оптичною перебудовою, що дозволяє обійтися без схем розв'язки і позбутися від

поверхнево акустичних хвилях ефектів. Недоліком оптично перебудовуються варакторів є відносно велика витрата енергії.

У разі перебудовуються котушок індуктивності найбільш ефективним рішенням сьогодні є активні імітатори індуктивності на основі гіраторів і узаґальнених конверторів імпедансу, хоча можуть застосовуватися також MEMC і котушки індуктивності, керовані маґнітним полем. У більшості випадків застосування активних еквівалентів індуктивності пов'язано з пошуком компромісного рішення, що враховує вимоги енергоспоживання і добротності.

4.2 Поверхнево акустичні хвилі навантажувального конденсатора

Адміттанс резонатора з підключеним поверхнево акустичних хвилях конденсатором (рисунок 4.4, А) представляється виразом

$$Y(C) = iw(C_0 + C) + \frac{iwC_m}{1 - w^2 L_m C_m}$$
(4.9)

або тотожним:

$$Y(C) = \frac{iw(C_0 + C)(1 - w^2 L_m C_m) + iwC_m}{1 - w^2 L_m C_m}$$
(4.10)

На частоті поверхнево акустичних хвилях резонансу, w = wp, адміттанс резонатора Y (C) = 0, відповідно,

$$w_p(C + C_0) \left(1 - w_p^2 L_m C_m \right) + w_p C_m = 0$$
(4.11)

Рішенням рівняння є частота wp

$$w_p(C) = w_{s0} \sqrt{1 + \frac{C_m}{C + C_0}}$$
 (4.12)

де ws0 – частота послідовного резонансу ненаґруженного резонатора (4.4).

На частоті послідовного резонансу, w = ws, адміттанс Y (C) = ∞ , знаменник(4.10) дорівнює нулю, що призводить до наступного виразу:

$$1 - w_s^2 L_m C_m = 0 (4.13)$$

і значенням частоти послідовного резонансу

$$w_s = \frac{1}{\sqrt{L_m C_m}} \tag{4.14}$$

Як випливає з (4.12), В разі поверхнево акустичних хвилях підключеного конденсатора, частота поверхнево акустичних хвилях резонансу може бути перебудована зміною величини підлаштування варактора, при цьому частота послідовного резонансу залишається незмінною. У разі застосування напівпровідникових і ферроелектричних варакторов ємність зменшується з підвищенням зміщення по постійному струму і частота поверхнево акустичних хвилях резонансу збільшується.



Рисунок 4.4 – Схема резонатора з поверхнево акустичних хвиляхалельним конденсатором (a), її модуль вхідного імпедансу для різних Cp (б), залежність поверхнево акустичних хвиляхалельного резонансу від Cp (в) і перестраіваемость частоти (г)

Приклад залежності частоти поверхнево акустичних хвилях резонансу від величини навантажувального поверхнево акустичних хвилях конденсатора показаний на рисунок 4.4, В. Переналаштування частоти поверхнево акустичних хвилях резонансу знаходиться з виразу:

68

$$Tf_{p}(C) = \frac{w_{p}(C_{min}) - w(C)}{w_{p}(C_{max})}$$
(4.15)

або

$$Tf_p(C) = \frac{max(f_p) - f_p}{min(f_p)}$$
(4.16)

Частота послідовного резонансу перебудовується в межах від (4.4) до (4.14), А значить максимальна перестроюваність

$$max(Tf_p) = \frac{\sqrt{L_m C_m (C_0 + C_m)} - \sqrt{C_0}}{\sqrt{L_m C_m (C_0 + C_m)}}$$
(4.17)

При використанні ідеального варактора з Cmin = 0 і Cmax = ∞ , максимальна перестроюваність спрощується до. Як показано на рисунок 4.4, Ґ, перестроюваність незначно перевищує 2,3%. При використанні реальних варакторов перестроюваність стає значно менше і зазвичай не перевищує 1%. Залежність вхідного імпедансу резонатора від різних значень Ср наведена на рисунок 4.4, Б.

Варто окремого розгляду випадок підключення поверхнево акустичних хвилях конденсатора негативної величини (рисунок 4.5).

Характер перебудови поверхнево акустичних хвилях резонансу узґоджується з розґлянутим раніше (рисунок 4.4, В) і залишається незмінним аж до визначеного від'ємного значення. У точці Ср = –С0 відбувається компенсація статичної ємності резонатора і розрив частотної залежності (рисунок 4.5, Б), при якому частота поверхнево акустичних хвилях резонансу йде в нескінченність. Частотна залежність вхідного імпедансу резонатора в такому випадку стає ідентичною RLC контуру з одним резонансом на частоті.

$$f_0 = 1/2\pi \sqrt{L_m C_m}$$

При подальшому зменшенні величини неґативною поверхнево акустичних хвилях ємності з'являється другий, низькочастотний поверхнево акустичних хвилях резонанс, асимптотично наближається до частоти послідовного резонансу (4.4) для великих значень | –Ср |. На рисунок 4.5, В представлена залежність перестроюваність частоти поверхнево акустичних хвилях резонансу від величини Ср. Характерною точкою є величина –С0, де

перестроюваність прямує до нескінченності. Залежність вхідного імпедансу резонатора від різних негативних значень Ср наведена на рисунок 4.5, А.



Рисунок 4.5 – Частотні залежності модуля вхідного імпедансу для негативних Ср (а), залежність поверхнево акустичних хвиляхалельного резонансу від Ср (б) і перестраіваемость частоти (в)

Послідовний навантажувальний конденсатор. Імпеданс резонатора з послідовно підключеним конденсатором (рисунок 4.6, A) представляється у вигляді

$$Z(C) = \frac{1 - w^2 L_m C_m}{iw C_0 (1 - w^2 L_m C_m) + iw C_m} + \frac{1}{iw C}$$
(4.18)

Шляхом тотожних перетворень імпеданс набирає вигляду:

$$Z(C) = \frac{iwC_m + iwC_0(1 - w^2L_mC_m) + iwC(1 - w^2L_mC_m)}{wC(wC_m + wC_0(1 - w^2L_mC_m))}$$
(4.19)

На резонансній частоті, w = w0, імпеданс Z (C) = 0, що призводить до вираження

$$iw_{s}C_{m} + iw_{s}C_{0}(1 - w_{s}^{2}L_{m}C_{m}) + iw_{s}C(1 - w_{s}^{2}L_{m}C_{m}) = 0$$
(4.20)

I, отже,

$$w_s(C) = w_{s0} \sqrt{1 + \frac{C_m}{C + C_0}}$$
 (4.21)

де, частота послідовна частота ненавантажений резонатора має вигляд (4.4). На частоті поверхнево акустичних хвилях резонансу, w = wp, Z (C) = ∞ , відповідно:

$$w_p C(w_p C_m + w_p C_0 (1 - w_p^2 L_m C_m)) = 0$$
(4.22)



Рисунок 4.6 – Схема резонатора з послідовним конденсатором (а), її модуль вхідного імпедансу для різних Cs (б), залежність послідовного резонансу від Cs (в) і перестраіваемость частоти (г)

Що призводить до формули для частоти поверхнево акустичних хвилях резонансу, ідентичною (4.6):

$$w_p = w_s \sqrt{1 + \frac{C_m}{C_0}} \tag{4.23}$$

У разі послідовно підключеного конденсатора частота поверхнево акустичних хвилях резонансу залишається незмінною, але частота послідовного резонансу (4.21)залежить від величини навантажувального конденсатора. На рисунок 4.6, В представлена залежність частоти послідовного резонансу від величини послідовно підключеного конденсатора. Перебудова резонансної частоти можлива в межах від wp(4.23) до ws0 (4.4). Відповідно, перестроюваність частоти послідовного резонансу в цьому випадку:

$$Tf_{s}(C) = \frac{w_{s}(C_{min}) - w(C)}{w_{s}(C_{max})}$$
(4.24)

або

$$Tf_{s}(C) = \frac{max(f_{s}) - f_{s}}{min(f_{s})}$$
(4.25)

Як і у випадку з поверхнево акустичних хвиляхалельним конденсатором, при подальшому зменшенні величини ємності з'являється другий, високочастотний послідовний резонанс, асимптотично наближається до частоти поверхнево акустичних хвиляхалельного резонансу (4.6) для значень Cs = 0 (рисунок 4.7).

в негативну область ємностей знову При переході з'являється низькочастотний резонанс, який праґне до частоти (4.4) для великих величин | – Cs |. На рисунок 4.7, В представлена залежність перестроюваність частоти послідовного резонансу від величини Cs. Характерною точкою є величина - C0, де перестроюваність прямує до нескінченності. Залежність вхідного імпедансу резонатора від різних негативних значень Cs представлена на рисунок 4.7, А. На частоті 1,5 ГГц перестроюваність частоти склала 1,47% при добротності 160-300. Де застосовувалися 0,25-мкм БіКМОП варактори. При замиканні верхній механічним перемикача електрод стає навантаженням п'єзоелектричного резонатора, що призводить до зміщення резонансної частоти



Рисунок 4.7 – Частотні залежності модуля вхідного імпедансу для негативних Cs (a), залежність послідовного резонансу від Cs (б) і перестраіваемость частоти

(B)



Рисунок 4.8 – Перебудова частоти резонатора із застосуванням МЕМС перемикачів

На поверхнево акустичних хвилях котушка індуктивності. Адміттанс резонатора, навантаженого на поверхнево акустичних хвилях котушкою індуктивності Lp (рисунок 4.9, A), має вигляд:

$$Y(L) = \frac{(1 - w^2 L C_0)(1 - w^2 L_m C_m) - w^2 L C_m}{iwL(1 - w^2 L_m C_m)}$$
(4.26)

У точці поверхнево акустичних хвилях резонансу, w = wp, адміттанс Y = 0. Отже, з (4.26)
$$(1 - w_p^2 L C_0) (1 - w_p^2 L_m C_m) - w_p^2 L C_m = 0$$
(4.27)

що призводить до значень частоти поверхнево акустичних хвилях резонансу $w_{p\pm}(L) =$

$$w_{s0} \sqrt{0.5 \left[1 + \frac{C_m}{C_0} \left(1 + \frac{L_m}{L}\right)\right] \pm 0.5 \sqrt{\left[1 + \frac{C_m}{C_0} \left(1 + \frac{L_m}{L}\right)\right]^2 - \frac{4L_m C_m}{L_0}} (4.28)}$$

$$u_{s0} \sqrt{0.5 \left[1 + \frac{C_m}{C_0} \left(1 + \frac{L_m}{L}\right)\right] \pm 0.5 \sqrt{\left[1 + \frac{C_m}{C_0} \left(1 + \frac{L_m}{L}\right)\right]^2 - \frac{4L_m C_m}{L_0}} (4.28)}$$

$$u_{s0} \sqrt{0.5 \left[1 + \frac{C_m}{C_0} \left(1 + \frac{L_m}{L}\right)\right] \pm 0.5 \sqrt{\left[1 + \frac{C_m}{C_0} \left(1 + \frac{L_m}{L}\right)\right]^2 - \frac{4L_m C_m}{L_0}} (4.28)}$$

$$u_{s0} \sqrt{0.5 \left[1 + \frac{C_m}{C_0} \left(1 + \frac{L_m}{L}\right)\right] \pm 0.5 \sqrt{\left[1 + \frac{C_m}{C_0} \left(1 + \frac{L_m}{L}\right)\right]^2 - \frac{4L_m C_m}{L_0}} (4.28)}$$

Рисунок 4.9 – Схема резонатора з поверхнево акустичних хвиляхалельної котушкою індуктивності (а), її модуль вхідного імпедансу для різних Lp (б), залежність поверхнево акустичних хвиляхалельного резонансу від Lp (в) і перестраіваемость частоти (ґ)

Очевидно, що випадок L = 0 (шунтування резонатора) не має сенсу. Порівнюючи отриманий вираз (4.28) з (4.6) приходимо до тоґо, що навантаження поверхнево акустичних хвилях котушкою індуктивності еквівалентна збільшенню Cm в (1 + Lm / L) раз. На резонансній частоті, w = ws, $Y = \infty$:

$$w_s L(1 - w_s^2 L_m C_m) = 0 (4.29)$$

звідси,

$$w_s = w_{s0} = \frac{1}{\sqrt{L_m C_m}}$$
 (4.30)

що відповідає (4.4).

Таким чином, поверхнево акустичних хвилях котушка індуктивності не впливає на частоту послідовного резонансу, але частота поверхнево акустичних перебудована хвилях резонансу може бути величиною навантаження індуктивності. Ha відміну від поверхнево акустичних хвилях навантажувального конденсатора, навантажувальна котушка вводить два поверхнево акустичних хвилях резонансу, що відповідають різним знакам в (4.28). Приклад перебудови поверхнево акустичних хвилях резонансів під індуктивності впливом навантаження наведено на рисунок 4.6, B. Високочастотна гілка перебудови обмежена знизу частотою поверхнево акустичних хвилях резонансу (4.6). Частота послідовного резонансу не залежить від величини навантаження індуктивності і обмежує низкочастотну гілку поверхнево акустичних хвилях резонансу зверху. Варто зауважити, що верхня і нижня гілки поверхнево акустичних хвилях резонансів асимптотично наближаються до, як показано на рисунок 4.6, В. Діапазон перебудови поверхнево акустичних хвилях частоти виявляється дуже широким для обох *г*ілок (рисунок 4.6, Г):

$$Tf_{p\pm}(L) = \frac{w_{p\pm}(L_{min}) - w_{\pm}(L)}{w_{p\pm}(L_{max})}$$
(4.31)

Однак, щоб уникнути інтерференції з частотою послідовного резонансу, величина індуктивності повинна лежати в межах 7–10 нГн. Інші значення наближають одну з гілок близько до частоти резонансу, що може бути небажано в деяких схемах. З іншого боку, в фільтрах це застосовується для перебудови вибірковості в низькочастотної області смуги пропускання. Залежність вхідного імпедансу резонатора від різних значень Lp представлена на рисунок 4.9, Б.

Послідовна котушка індуктивності. Імпеданс резонатора з перебудовується котушкою індуктивності, підключеної послідовно (рисунок 4.10), та наведена в додатку М. Представляється наступним виразом:



Рисунок 4.10 – Схема резонатора з послідовною котушкою індуктивності (a), її модуль вхідного імпедансу для різних Ls (б), залежність послідовного резонансу від Ls (в) і перестраіваемость частоти (г)

або тотожним

$$Z(L) = \frac{wL(wC_m + wC_0(1 - w^2L_mC_m)) + w^2L_mC_m - 1}{iwC_0(1 - w^2L_mC_m) + iwC_m}$$
(4.33)

На частоті послідовного резонансу, w = ws, імпеданс Z рівний нулю, відповідно

$$w_{s}L(w_{s}C_{m} + w_{s}C_{0}(1 - w_{s}^{2}L_{m}C_{m})) + w_{s}^{2}L_{m}C_{m} - 1 = 0$$
(4.34)

після спрощення (4.34) отримуємо

$$w_s^4 L_m C_m L C_0 - w_s^2 (L C_m + L_m C_m + L C_0) + 1 = 0$$
(4.35)

Для L = 0 цей вислів спрощується до (4.4), Але для L \neq 0

$$w_{s\pm}(L) = w_{s0} \sqrt{0.5 \left[1 + \frac{C_m}{C_0} \left(1 + \frac{L_m}{L}\right)\right] \pm 0.5 \sqrt{\left[1 + \frac{C_m}{C_0} \left(1 + \frac{L_m}{L}\right)\right]^2 - \frac{4L_m C_m}{L C_0}}$$
(4.36)

На частоті поверхнево акустичних хвилях резонансу, w = wp, імпеданс Z = ∞ і

$$iw_p C_m + iw_p C_0 \left(1 - w_p^2 L_m C_m\right) = 0$$
(4.37)

Що призводить до частоті поверхнево акустичних хвилях резонансу, що не залежить від величини навантаження індуктивності:

$$w_p(C) = w_{s0} \sqrt{1 + \frac{C_m}{C_0}}$$
(4.38)

Як і у випадку з поверхнево акустичних хвилях котушкою індуктивності, Послідовна котушка індуктивності вводить дві послідовні резонансні частоти (4.36) – одну вище і одну нижче частоти поверхнево акустичних хвиляхалельного резонансу, як показано на рисунок 4.10, В. Частота поверхнево акустичних хвилях резонансу (4.38) є нижньою межею високочастотної ґілки, відповідної знаку «+» в. послідовний резонанс на частоті ws обмежує низкочастотну гілку зверху і відповідає знаку «–». Як і в випадку на поверхнево акустичних хвилях котушки індуктивності, забезпечується широкий діапазон перебудови частоти (рисунок 4.10, Г):

$$Tf_{s\pm}(L) = \frac{w_{s\pm}(L_{min}) - w_{\pm}(L)}{w_{s\pm}(L_{max})}$$
(4.39)

що не завжди можна досягти на практиці через інтерференції частот або низької добротності котушок індуктивності. Для високих значень перестраіваємість високочастотного послідовного резонансу, величина індуктивності повинна бути досить низькою, однак це призводить до того, що низькочастотний резонанс наближається до ws0. Аналогічно, при високій перестраіваемость низькочастотної гілки, високочастотний резонанс наближається до wp0, що є недоліком в деяких схемах. Верхня і нижня гілки послідовних резонансів асимптотично наближаються до, як показано на рисунок 4.10, В. Фактично, частота часто застосовується для розширення смуги пропускання фільтрів на основі п'єзоелектричного резонатора.

4.3 Активна реалізація котушки індуктивності. Параметри гіраторного аналога індуктивності

З міркувань, описаних слідує той факт, що ширина смуги пропускання фільтра, а також діапазон його частотної перебудови значно обмежені шунтуюча поверхнево акустичних хвилях ємністю резонатора, що істотно звужує спектр застосування таких схем. Зазвичай підходи до поліпшення зазначених характеристик фільтра сфокусовані на методах зменшення (і по можливості усунення) впливу поверхнево акустичних хвилях ємності резонатора. В сучасних умовах застосування методів придушення поверхнево акустичних хвилях ємності стає необхідністю.

Відомим підходом, що усуває ефект від елемента електричної схеми є використання дуального схемного елемента. Вплив шунтуючої поверхнево акустичних хвилях ємності може бути придушене поблизу резонансної частоти за допомогою котушок індуктивності відповідного значення. Однак, на низьких частотах (одиниці П'ц) значення індуктивності стають відносно високими (> 20 нГн). Монолітні інтегральні котушки індуктивності при цьому займають значну площу на кристалі і мають низькі показники добротності Q. До того ж, значення індуктивності не можуть бути перебудовані для узгодження з можливими варіаціями ефективної шунтуючої поверхнево акустичних хвилях ємності, що часто зустрічається на практиці. Тому, в більшості випадків, інтегральні котушки індуктивності – не найкращий вибір для придушення шунтуючої поверхнево акустичних хвилях ємності. З іншого боку, активні котушки індуктивності відносно невеликі, перебудовуються і потенційно мають більш високі показники Q.

У випадку, коли $R_1 = R_2$, вираз для заґальної потужності (5.9) праґне до нуля незалежно від величин I_1 і I_2 . У результаті схема не віддає і не поґлинає потужності і перетворюється в пасивний невзаємний чотирьохполюсник без втрат. Ця схема вперше була запропонована в роботі [17] і названа автором гіратором за аналогією з механічною ґіростатичною системою напруґи на затискачах, яка ґіратує із струмами. Її умовне позначення дається на рисунку 4.11. Заґальну величину R_1 і R_2 називають ґіраторним опором.



Рисунок 4.11 – Умовне позначення гіратора.

Таким чином, ідеальний гіратор являє собою чотирьохполюсник, що описується системою рівнянь

$$\begin{array}{c} I_1 = gU_2 \\ I_2 = -gU_1 \end{array} \right\} \quad , \tag{4.40}$$

де g - провідність гірації. Його властивості як елемента електричного ланцюга, визначаються матрицею короткого замикання, отриманої на підставі рівнянь (4.40)

$$\begin{bmatrix} Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & g \\ -g & 0 \end{bmatrix} . \tag{4.41}$$

Еквівалентна схема ідеального гіратора подана на рисунок5.4а, векторна діаграма струмів і напруг - на рисунку 4.12б. Проте практичні схеми гіраторів відмінні від ідеальних з таких причин: а) вхідна і вихідна провідності матриці короткого замикання не рівні нулю; б) залежні джерела вносять визначений фазовий зсув ε_1 і ε_2 при проходженні сиґналу через гіратор. Таким чином, матриця провідності короткого замикання реального гіратора має вид:

$$[Y] = \begin{bmatrix} y_{11} & g \\ -g & y_{22} \end{bmatrix},$$
(4.42)

де y_{11} , y_{22} - вхідна і вихідна провідності гіратора. Проведемо аналіз вхідної провідності гіратора при підключенні до його виходу ємнісного навантаження $Z_{_{H}} = -j \frac{1}{\omega C_{_{H}}}$. Вхідна провідність схеми в цьому випадку визначається виразом

$$Y_{ex} = y_{11} + \frac{g^2}{y_{22} + j\omega C_{_H}} \quad . \tag{4.43}$$



Рисунок 4.12 – Еквівалентна схема ідеального гіратора (а) і його векторна діаграма струмів і напруг (б).

Після нескладних перетворень виразу (4.43) отримаємо

$$Y_{ex} = y_{11} + \frac{g^2 y_{22}}{y_{22}^2 + (\omega C_{\mu})^2} - j \frac{g^2 \omega C_{\mu}}{y_{22}^2 + (\omega C_{\mu})^2} .$$
(4.44)

За умови $y_{22}^2 << (\omega C_{\mu})^2$ рівняння (4.44) перетвориться до виду

$$Y_{ex} = y_{11} + \frac{g^2 y_{22}}{(\omega C_{_H})^2} - j \frac{g^2}{\omega C_{_H}} .$$
(4.45)

Таким чином, вхідна провідність гіратора з ємнісним навантаженням має індуктивний характер. Уявна частина (4.45) визначає величину індуктивності

$$L = \frac{C_{_{H}}}{g^2} \quad . \tag{4.46}$$

Добротність аналога індуктивності, побудованого на реальному гіраторі, визначається відношенням уявної частини до дійсної виразу (4.45)

$$Q = \frac{\omega C_{\mu} g^2}{y_{11} (\omega C_{\mu})^2 + y_{22} g^2} \quad . \tag{4.47}$$

Оптимальну величину навантажувальної ємності *Cн* визначаємо з умови $\frac{dQ}{dC_{_H}} = 0$. Провівши необхідні перетворення (4.47), отримаємо

$$C_{Honm} = \frac{g}{\omega} \sqrt{\frac{y_{22}}{y_{11}}}$$
 (4.48)

Підставляючи (4.48) у (4.47) визначимо максимальне значення добротності

$$Q_{\rm max} = \frac{g}{2\sqrt{y_{11}y_{22}}} \quad . \tag{4.49}$$

Аналіз виразу (4.49) показує, що максимальне значення добротності зменшується із зростанням значень y₁₁, y₂₂ в реальному гіраторі.

Урахування фазових зсувів у керованих джерелах струму видозмінює матрицю провідності короткого замикання

$$[Y] = \begin{bmatrix} y_{11} & \frac{g}{1+j\omega\tau_1} \\ \frac{g}{1+j\omega\tau_2} & y_{22} \end{bmatrix} .$$
(4.50)

Вихідна провідність ґіратора з ємнісним навантаженням у цьому випадку буде мати виґляд:

$$Y_{\rm ex} = Y_{11} + \frac{g^2 / y_{22}}{(1 + j\omega\tau_1)(1 + j\omega\tau_2)(1 + j\omega C_{\rm H} / y_{22})} .$$
(4.51)

Значення індуктивності і добротності визначається з формули (4.51) після поділу її на дійсну і уявну частини:

$$L = \frac{y_{22}(\lambda_1^2 + \lambda_2^2)}{\omega \lambda_2 g^2} , \qquad (4.52)$$

$$Q = \frac{\lambda_2 g^2}{\lambda_1 g^2 + y_{11} y_{22} (\lambda_1^2 + \lambda_2^2)},$$
(4.53)

де

$$\lambda_1 = 1 - \omega^2 \left(\tau_1 \tau_2 + (\tau_1 + \tau_2) \frac{C_{_{H}}}{y_{22}} \right), \qquad (4.54)$$

$$\lambda_2 = \omega \left((\tau_1 + \tau_2) + (1 - \omega^2 \tau_1 \tau_2) \frac{C_{\mu}}{y_{22}} \right).$$
(4.55)

Рівняння (4.52) і (4.53) показують яким чином неідеальність ґіратора впливає на значення індуктивності і добротності.

Визначимо оптимальну навантажувальну ємність C_H , що відповідає максимальному значенню добротності. Для цього необхідно взяти похідну по C_H функції (4.53) і отриманий вираз дорівняти нулю. Таким чином, одержимо таке рівняння для визначення C_{Honm} :

$$C_{\mu}^{2} \left(y_{11} y_{22} k_{5} d_{5}^{2} - 2 y_{11} y_{22} g^{2} d_{7} (k_{6} d_{7} - m_{6} d_{5}) \right) - C_{\mu} \left(k_{5} d_{5} (g^{2} + 2 y_{11} y_{22} k_{7}) + g^{2} (m_{5} d_{7} + 2 y_{11} y_{22} (2 d_{6} k_{6} d_{7} + m_{6} k_{7} d_{7} - m_{6} d_{5} d_{6})) \right) + \left(k_{5} k_{7} (g^{2} + y_{11} y_{22} k_{7}) - g^{2} d_{6} (m_{5} + 2 y_{11} y_{22} (m_{6} k_{7} + k_{6} d_{6})) \right) = 0$$

$$(4.56)$$

Рішення рівняння (4.56) дозволяє визначити Снопт :

$$C_{Honm} = \frac{-b_6 + \sqrt{b_6^2 - 4a_6c_6}}{2a_6}, \qquad (4.57)$$

де

$$\begin{split} a_6 &= y_{11} y_{22} k_5 d_5^2 - 2 y_{11} y_{22} g^2 d_7 (k_6 d_7 - m_6 d_6), \\ b_6 &= - \Bigl(k_5 d_5 (g^2 + 2 y_{11} y_{22} k_7) + g^2 (m_5 d_7 + 2 y_{11} y_{22} (2 d_6 k_6 d_7 + m_6 k_7 d_7 - m_6 d_5 d_6)) \Bigr), \\ c_6 &= \Bigl(k_5 k_7 (g^2 + y_{11} y_{22} k_7) - g^2 d_6 (m_5 + 2 y_{11} y_{22} (m_6 k_7 + k_6 d_6)) \Bigr), \\ k_5 &= \omega g^2 \frac{1}{y_{22}} \Bigl(1 - \omega^2 \tau_1 \tau_2 \Bigr), \\ k_6 &= \frac{\omega}{y_{22}} \Bigl(1 - \omega^2 \tau_1 \tau_2 \Bigr), \end{split}$$

$$k_{7} = \left(1 - \omega^{2} \tau_{1} \tau_{2}\right),$$

$$m_{5} = \omega^{2} g^{2} \frac{1}{y_{22}} (\tau_{1} + \tau_{2}),$$

$$m_{6} = -\omega^{2} \frac{1}{y_{22}} (\tau_{1} + \tau_{2}),$$

$$d_{5} = \frac{\omega_{2}}{y_{22}} (\tau_{1} + \tau_{2}),$$

$$d_{6} = \omega (\tau_{1} + \tau_{2}),$$

$$d_{7} = \frac{\omega}{y_{22}} \left(1 - \omega^{2} \tau_{1} \tau_{2}\right),$$

 τ_1 і τ_2 - час затримки сиґналу в керованих джерелах струму.

Максимальне значення добротності індуктивного елемента на основі реального гіратора одержуємо підстановкою виразу (4.57) у рівняння (4.53).



Рисунок 4.13 – Еквівалентна схема реального гіратора (а) і його векторна діаграма струмів і напруг (б)

У практичних схемах гіраторів їхній вхід і вихід шунтують паразитними провідностями y' і y'', крім того, залежні джерела вносять певний зсув фаз ε_1 і ε_2 при проходженні сигналу через гіратор. Тому схема реального гіратора має вид, показаний на рисунку 4.13 а. Векторна діаграма струмів і напруг подана на рисунку 4.13 б.

4.4 Реалізація гіратора з використанням від'ємного опору

Для побудови гіратора необхідний щонайменше один незалежний елемент. Найбільш придатними для цього є транзистори. Ці прилади при вмиканні за схемою з заґальним емітером можна розґлядати як заземлені чотирьохполюсники, наближена матриця провідностей яких має виґляд:

$$\begin{bmatrix} Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ g & 0 \end{bmatrix}. \tag{4.58}$$

Проте транзистор має достатньо великі значення y₁₁ і y₂₂, щоб ними можна було знехтувати. Таким чином, якщо чотирьохполюсник описується матрицею провідностей

$$[Y] = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix},$$
 (4.59)

то її можна розкласти в такий спосіб:

$$[Y] = \begin{bmatrix} 0 & 1/2(y_{12} - y_{21}) \\ -1/2(y_{12} - y_{21}) & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_{11} & 1/2(y_{12} + y_{21}) \\ 1/2(y_{12} + y_{21}) & y_{22} \end{bmatrix} .$$
(4.60)

Перший доданок описує гіратор, а другий - ланцюг, що складається з трикутника провідностей:

$$A_{o} = y_{11} + 1/2(y_{12} + y_{21}) ,$$

$$B_{o} = -1/2(y_{12} + y_{21}) ,$$

$$C_{o} = y_{22} + 1/2(y_{12} + y_{21}) .$$

(4.61)

Повна схема представляється у вигляді рівнобіжного з'єднання цих двох ланцюгів, як показано на рисунок5.6. Неважко визначити засіб реалізації ідеального гіратора. Для цього достатньо компенсувати провідності A_o , B_o , C_o . У якості елементів, що компенсують, можуть бути використані конвертори від'ємного опору [36, 49], напівпровідникові прилади з від'ємним опором: лавинні транзистори, чотирьохшарові напівпровідникові структури, а також ланцюґ, запропонований в роботі [49]. Його електрична схема приведена на

рисунку 4.14. Дана схема являє собою керований струмом від'ємний опір, величина якого регулюється шляхом зміни



Рисунок 4.14 – Гіратор з паралельним навантаженням.



Рисунок 4.15 – Транзисторна схема з від'ємним опором

Розглянемо транзисторну схему з загальною базою, що описується такою системою *h* - параметрів:

$$[Y] = \begin{bmatrix} \frac{1}{h_{11}} & -\frac{h_{12}}{h_{11}} \\ \frac{h_{21}}{h_{11}} & \frac{\Delta h}{h_{11}} \end{bmatrix}.$$
 (4.63)

Розкладемо матрицю (4.64) за аналогією з (4.50)

$$[Y] = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{h_{12} + h_{21}}{2h_{11}} \\ \frac{h_{12} + h_{21}}{2h_{11}} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{h_{11}} & \frac{h_{21} - h_{12}}{2h_{11}} \\ \frac{h_{21} - h_{12}}{2h_{11}} & \frac{\Delta h}{h_{11}} \end{bmatrix}.$$
 (4.64)

Перша матриця розкладання описує ідеальний гіратор із гіраторною провідністю

$$g = \frac{h_{12} + h_{21}}{2h_{11}} \quad . \tag{4.65}$$

Друга матриця відповідає трикутнику провідностей

$$A_{o} = \frac{1}{h_{11}} + \frac{h_{21} - h_{12}}{2h_{11}} ,$$

$$B_{o} = -\frac{h_{21} - h_{12}}{2h_{11}} ,$$

$$C_{o} = \frac{\Delta h}{h_{11}} + \frac{h_{21} - h_{12}}{2h_{11}} .$$
(4.66)

Отже, транзисторна схема з загальною базою буде являти собою ідеальний гіратор, якщо паралельно провідностям A_o , B_o , C_o розмістити провідності - A_o , - B_o , - C_o . Схема такого гіратора дана на рисунку 4.16. Проведемо розрахунок гіратора на транзисторі типу КТЗ15. Довідкові значення параметрів цього транзистора такі: $\alpha_o = 0.92$; $r_{\delta} = 150$ Ом; $r_{\kappa} = 200$ кОм. Визначимо h - параметри транзисторної схеми при струмі емітера $I_e = 0.5$ мА і величині зовнішнього базового опору $R_{\delta} = 200$ См.

У такий спосіб:

*h*₁₁=78 OM; *h*₁₂=175·10-5; $\Delta h = -12 \cdot 10^{-4}$. *h*₂₁=0,92; *h*₂₂=5·10-6 1/OM.



Рисунок 4.16 – Гіраторна схема з від'ємним опором Отже, параметри гіраторної схеми мають значення:

 $A_o = 18,7 \cdot 10-3$ сим, $B_o = -5,9 \cdot 10-3$ сим, $C_o = 5,9 \cdot 103$ сим, $g = 5,9 \cdot 10-3$ сим.

Величини компенсуючих опорів визначаються співвідношеннями:

$$R_A = -\frac{1}{A_o} = -53,5 \text{ Om};$$
 $R_B = -\frac{1}{B_o} = 170 \text{ Om};$ $R_C = -\frac{1}{C_o} = 170 \text{ Om}.$

Для створення від'ємних опорів скористаємося схемою, зображеною на рисунку 4.16. Для одержання струму зсуву біля 3,3 мА схема, що моделює опір R_A , підключається до джерела емітерної напрути в 1 вольт через опір 300 Ом. Величині від'ємного опору R_A =-53,5 Ом відповідають значення r=100 Ом, n=2 і R_I =107 Ом. Аналогічний ланцюґ для моделювання опору R_C =-170 Ом підключається до джерела колекторного зсуву з напруґою U_K =10В через опір у 3 кОм. Для цієї схеми r=100 Ом, n=2 і R_I =34 Ом. Принципова схема гіратора приведена на рисунку 4.17.



Рисунок 4.17 – Схема гіратора

Розглянемо ще засіб реалізації гіратора на основі транзисторної схеми з заґальним колектором (рисунок 4.18 а), у котрої R_1 - опір зсуву, а R_2 - опір навантаження. Еквівалентна схема каскаду наведена на рисунку 4.19 б. Матриця провідностей цьоґо чотирьохполюсника має виґляд:

$$[Y] = \begin{bmatrix} \frac{r_e + r_\kappa (1 - \alpha)}{r_e r_{\delta} + r_\kappa (r_e + r_{\delta} (1 - \alpha))} + \frac{1}{R_1} & -\frac{r_\kappa (1 - \alpha)}{r_e r_{\delta} + r_\kappa (r_e + r_{\delta} (1 - \alpha))} \\ -\frac{r_\kappa}{r_e r_{\delta} + r_\kappa (r_e + r_{\delta} (1 - \alpha))} & -\frac{r_\kappa + r_{\delta}}{r_e r_{\delta} + r_\kappa (r_e + r_{\delta} (1 - \alpha))} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g_{11} & -g_{12} \\ -g_{21} & g_{22} \end{bmatrix}.$$

$$(4.68)$$



Рисунок 4.18 – Схема гіратора на основі транзистора з заґальним колектором (а), еквівалентна схема транзистора (б), еквівалентна схема гіратора (в).

Матриця опорів у цьому випадку визначається виразом:

$$\begin{bmatrix} Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix} .$$
(4.69)

Матрицю (4.69) можна розкласти на дві складові:

$$\begin{bmatrix} Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{R_{21} - R_{12}}{2} \\ \frac{R_{21} - R_{12}}{2} & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} R_{11} & \frac{R_{21} + R_{12}}{2} \\ \frac{R_{21} + R_{12}}{2} & R_{22} \end{bmatrix} .$$
(4.70)

Якщо схему з загальним колектором з'єднати послідовно з ланцюґом, що має матрицю опорів

$$[Z]_{\kappa} = \begin{bmatrix} -R_{11} & -\frac{R_{21} + R_{12}}{2} \\ -\frac{R_{21} + R_{12}}{2} & -R_{22} \end{bmatrix},$$
(4.71)

то отримана комбінація буде являти собою гіратор. Обертання матриці (5.41) у матрицю провідностей $[Y]_{\kappa}$ дозволяє реалізувати її у вигляді П-подібної схеми, параметри якої визначаються за формулою (4.67). Повна еквівалентна схема гіратора приведена на рисунок5.10 в. Нижче поданий розрахунок гіратора при α =0,95 і таких величинах опорів еквівалентної схеми, зображеної на рисунку 5.10 б; r_e =25 Ом, r_o =150 Ом, r_{κ} =200 кОм, і R_1 =2 кОм, R_2 =1 кОм. Матриця провідностей каскаду з заґальним колектором має виґляд

$$[Y]_{\kappa} = \begin{bmatrix} 2,04 \cdot 10^{-3} & -1,54 \cdot 10^{-3} \\ -30,8 \cdot 10^{-3} & 31,8 \cdot 10^{-3} \end{bmatrix} .$$
(4.72)

Відповідна їй матриця опорів визначається виразом

$$\begin{bmatrix} Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1815 & 88 \\ 1760 & 116,5 \end{bmatrix} \quad . \tag{4.73}$$

Матриця (4.73) розкладається в такий спосіб:

$$\begin{bmatrix} Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -836 \\ 836 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1815 & 924 \\ 924 & 116,5 \end{bmatrix} .$$
(4.74)

Матриця провідностей компенсуючого ланцюга утворюється перетворенням другого доданку розкладу (4.74)

$$[Y]_{\kappa} = \begin{bmatrix} 0,183 \cdot 10^{-3} & -1,445 \cdot 10^{-3} \\ -1,445 \cdot 10^{-3} & 2,842 \cdot 10^{-3} \end{bmatrix}.$$
 (4.75)

Відповідно до формул (4.67) провідності й опори П-подібної компенсуючої схеми визначаються величинами:

 $g=1,445\cdot10^{-3}$ сим; $g=-1,262\cdot10^{-3}$ сим; $g=1,397\cdot10^{-3}$ сим; $R_A=-792$ Ом; $R_B=693$ Ом; $R_C=717$ Ом. Від'ємний опір, як і в попередньому випадку, реалізується схемою, зображеною на рисунку 4.19. У даному випадку r=1000 Ом, n=5 і $R_I=3960$ Ом. Принципова схема ґіратора подана на рисунок5.11.



Рисунок 4.19 – Принципова схема гіратора

Розґлянемо метод компенсації паразитних провідностей гіратора за допомогою конвертора від'ємного опору [36, 49]. Схема вмикання конверторів від'ємного опору по струму (КВОСТ) до вхідних затискачів гіратора подана на рисунку 4.20. Матриця провідностей даної схеми буде мати виґляд

$$\begin{bmatrix} Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} + Y_{ex2} & g \\ -g & Y_{22} + Y_{ex1} \end{bmatrix}, \qquad (4.76)$$

де Y_{ex1} , Y_{ex2} - вхідні провідності першого і другого КВОСТ, навантажених на Y_{H1} , Y_{H2} відповідно.



Рисунок 4.20 – Схема компенсації паразитних провідностей гіратора за допомогою конвертора від'ємного опору по струму

Як очевидно з матриці (4.76) паразитні параметри гіратора *Y*₁₁, *Y*₂₂ будуть компенсовані при виконанні умов:

$$\begin{array}{c} Y_{11} = -Y_{ex2} \\ Y_{22} = -Y_{ex1} \end{array}$$
 (4.77)

Матриця КВОСТ, навантаженого на провідність Ун, має вигляд

$$\begin{bmatrix} 1 + B_{12}Y_H & B_{12} \\ B_{21} - \frac{Y_H}{K} & -1/K \end{bmatrix},$$
(4.78)

де B₁₂ і B₂₁ - параметри матриці і K - коефіцієнт перетворення КВОСТ.

Параметри стосовні до першого КВСТ позначаються індексом 1 (наприклад $B_{12(1)}$, $B_{21(1)} K_{(1)}$); параметри, що відносяться до другого КВОСТ - 2 (наприклад $B_{12(2)}$, $B_{21(2)} K_{(2)}$).

З виразу (4.78) випливає, що вхідні провідності першого і другого КВОСТ відповідають:

$$Y_{ex1} = \frac{B_{21(1)} - \frac{Y_{H1}}{K_1}}{1 + B_{12(1)}Y_{H1}} \quad , \qquad \qquad Y_{ex2} = \frac{B_{21(2)} - \frac{Y_{H2}}{K_2}}{1 + B_{12(2)}Y_{H2}} \quad . \tag{4.79}$$

Таким чином, із виразу (4.77) і (4.79) можна записати

$$Y_{11} = -\frac{B_{21(2)} - \frac{Y_{H2}}{K_2}}{1 + B_{12(2)}Y_{H2}}, \qquad Y_{22} = -\frac{B_{21(1)} - \frac{Y_{H1}}{K_1}}{1 + B_{12(1)}Y_{H1}}.$$
(4.80)

Виконання цих рівностей забезпечує повну компенсацію паразитних параметрів Y_{11} , Y_{22} . Проте чутливість схеми при цьому є дуже високою. Отже, замість (4.80) необхідно використовувати рівність

$$Y_{11} = -\frac{B_{21(2)} - \frac{Y_{H2}}{K_2}}{1 + B_{12(2)}Y_{H2}} + \gamma , \qquad \qquad Y_{22} = -\frac{B_{21(1)} - \frac{Y_{H1}}{K_1}}{1 + B_{12(1)}Y_{H1}} + \gamma . \qquad (4.81)$$

Величина γ характеризує ступінь наближення гіратора до ідеального і може бути обрана по приведеним на рисунку 4.21 і 4.22 графікам, виходячи з початкової добротності гіратора і припустимій чутливості.



Рисунок 4.21 – Залежність чутливості від коефіцієнта компенсації паразитних провідностей гіратора



Рисунок 4.22 – Залежність добротності від коефіцієнта компенсації паразитних провідностей гіратора

З (4.81) знайдемо, які провідності *Y*_{*H1*}, *Y*_{*H2*} повинні бути залучені до першого і другого КВОСТ, щоб одержати повну компенсацію неідеальностей гіратора:

$$Y_{H1} = \frac{(\gamma - Y_{22} - B_{21(1)})K_1}{Y_{22}B_{21(1)}K_1 - 1 - \gamma B_{12(1)}K_1} ,$$

$$Y_{H2} = \frac{(\gamma - Y_{11} - B_{21(2)})K_2}{Y_{11}B_{21(2)}K_2 - 1 - \gamma B_{12(2)}K_2} .$$
(4.82)

Визначимо чутливість схеми компенсованого гіратора при різноманітному наближенні гіратора до ідеального. Вважаючи КВОСТ ідеальним пристроєм із $B_{12}=B_{21}=0$ і $K_1=K_2=1$, знайдемо вхідну провідність компенсованого гіратора, навантаженого на ємність

$$Y_{ex} = (Y_{11} - Y_{H2}) + \frac{g_1 g_2 (Y_{22} - Y_{H1})}{(Y_{22} - Y_{H1})^2 + (\omega C_H)^2} - j \frac{\omega C_H g_1 g_2}{(Y_{22} - Y_{H1})^2 + (\omega C_H)^2} .$$
(4.83)

Добротність схеми, обумовлена з (4.83), може бути записана у виґляді

$$Q = \frac{\omega C_H g_1 g_2}{(Y_{11} - Y_{H2}) \cdot ((Y_{22} - Y_{H1})^2 + (\omega C_H)^2) + g_1 g_2 (Y_{22} - Y_{H1})} .$$
(4.84)

При $Y_{11}=Y_{22}=Y$ одержуємо $Y_{H1}=Y_{H2}=Y_H$, вважаючи рівними провідності гірації $g_1=g_2=g$, вираз (4.84) перепишемо у виґляді

$$Q = \frac{\omega C_H g^2}{(Y - Y_H) \cdot ((Y - Y_H)^2 + (\omega C_H)^2 + g^2)} .$$
(4.85)

На підставі (4.85) визначимо чутливість добротності схеми при зміні навантажувальної провідності КВОСТ

$$S_{Y_H}^{Q} = \frac{Y_H (3(Y - Y_H)^2 + (\omega C_H)^2 + g^2)}{(Y - Y_H)^3 + (Y - Y_H)((\omega C_H)^2 + g^2)} .$$
(4.86)

Таким чином, розглянувши властивості гіраторів, у яких вхідна і вихідна провідність компенсована за допомогою від'ємних опорів, можна сказати, що їхньою позитивною якістю є простота схем. До недоліків варто віднести труднощі підґонки параметрів схеми при високих значеннях добротності (>100)

5 АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РОЗРОБКИ (ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ РОЗРОБКИ) МЕТОДІВ СИНТЕЗУ АКТИВНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ МЕМЅ ФІЛЬТРІВ.

5.1 Визначення рівня комерційного потенціалу розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Метою проведення технологічного аудиту є оцінювання комерційного потенціалу розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів, створеної в результаті науково-технічної діяльності. В результаті оцінювання можна буде зробити висновок щодо напрямів (особливостей) орґанізації подальшого її впровадження з врахуванням встановленого рейтингу.

Для проведення технологічного аудиту залучимо 3-х незалежних експертів. У нашому випадку такими експертами будуть керівник магістерської роботи та провідні викладачі випускової та споріднених кафедр.

Оцінювання комерційного потенціалу розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів будемо здійснювати за 12-ю критеріями згідно рекомендацій.

Результати оцінювання комерційного потенціалу розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів заносимо до таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 - Результати оцінювання комерційного успіху розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Критерії	Експерти			
	д.т.н., д.т.н.,		к.т.н., доцент	
	професор	професор	Гаврілов Д.В.	
	Семенов А.О.	Осадчук О.В.		
	Бали, виставлені експертами			
1	1	2	2	
2	2	3	2	
3	3	4	3	
4	2	3	3	
5	1	2	1	
6	2	3	3	
7	3	4	3	
8	2	3	2	
9	1	2	2	
10	2	2	2	

Продовження таблиці 5.1.

11	3	2	3
12	1	2	1
Сума балів	23	32	27
Середньоарифметична		27	
сума балів, СБ			

За даними таблиці 5.1 робимо висновок щодо рівня комерційного потенціалу розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів. При цьому користуємося рекомендаціями, наведеними в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Рівні комерційного потенціалу розробки

· 1 ·	
Середньоарифметична сума	Рівень комерційного
балів, розрахована на основі	потенціалу розробки
висновків експертів	
0 - 10	Низький
11 - 20	Нижче середнього
21 - 30	Середній
31 - 40	Вище середнього
41 - 50	Високий

Таким чином, робимо висновок, щодо рівня комерційного потенціалу нашої розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів – середній.

5.2 Визначення рівня якості розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Оцінювання рівня якості розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів проводиться з метою порівняльного аналізу і визначення найбільш ефективного, з технічної точки зору, варіанта інженерного рішення.

Рівень якості – це кількісна характеристика міри придатності певного виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї при порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання.

Абсолютний рівень якості розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів знаходимо обчисленням вибраних для її

вимірювання показників, не порівнюючи їх із відповідними показниками аналогічних виробів. Для цього необхідно визначити зміст основних функцій, які повинні реалізовувати розробка, вимоги замовника до неї, а також умови, які характеризують експлуатацію, визначають основні параметри, які будуть використані для розрахунку коефіцієнта технічного рівня виробу. Система параметрів, прийнята до розрахунків, повинна достатньо повно характеризувати споживчі властивості інноваційного товару (його призначення, надійність, економічне використання ресурсів, стандартизація тощо).

Далі визначаємо величину параметрів якості в балах та встановлюємо граничні його значення (кращі, гірші, середні). Всі ці дані для кожного параметра заносимо в табл. 5.3.

Таблиця 5.3 – Основні параметри методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Параметри	Абсолю па	Коефіцієнт вагомості		
1 1	Краще	Середнє	Гірше	параметра
	+5+4	+3	+1+2	napamerpa
Точність перетворення	4			0,05
Кількість вимірювальних				
каналів		3		0,05
Діапазон частот	5			0,4
Відносна похибка		3		0,05
АЧХ фільтра	5			0,4

Із врахуванням коефіцієнтів вагомості відповідних параметрів можна визначити абсолютний рівень якості інноваційного рішення за формулою [62]:

$$\mathsf{K}_{\mathsf{я.a.}} = \sum_{i=1}^{n} \mathsf{Pнi} \cdot \mathsf{ai},$$
(5.1)

де Рні – числове значення і-го параметра інноваційного рішення, n – кількість параметрів інноваційного рішення, що прийняті для оцінювання, аі – коефіцієнт вагомості відповідного параметра (сума коефіцієнтів вагомості всіх параметрів повинна дорівнювати 1).

Отже, абсолютний рівень якості методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів становитиме – 4,5 бали.

Одночасно визначаємо відносний рівень якості методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів, що виробляється (проектується), порівнюючи

її показники з абсолютними показниками якості найліпших вітчизняних та зарубіжних аналогів (товарів-конкурентів) (табл. 5.4).

Таблиця 5.4 – Основні параметри методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів та товару-конкурента

	Варіан	ГИ		
Параметри	Базовий (конкурент)	Новий	Відносний показник якості	Коефіцієнт ваґомості параметра
Точність перетворення	2	4	2	0,05
Кількість вимірювальних каналів	2	3	1,5	0,05
Діапазон частот	6	10	1,7	0,4
Відносна похибка	3	3	1	0,05
АЧХ фільтра	3	5	1,7	0,4

Відносний рівень якості методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів визначаємо за формулою:

$$\mathbf{K}_{\mathbf{g},\mathbf{B}} = \sum_{i=1}^{n} q_i \cdot a_i, \tag{5.2}$$

За розрахунками відносний рівень якості методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів становитиме — 1,59. Це означає, що наша розробка краща за якістю на 59% від товару-аналога.

5.3 Визначення конкурентоспроможності розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

У найширшому розумінні конкурентоспроможність товару – це можливість його успішного продажу на певному ринку і в певний проміжок часу. Водночас конкурентоспроможною можна вважати лише однорідну продукцію з технічними параметрами і техніко-економічними показниками, що ідентичні аналогічним показникам уже проданого товару. Для того, щоб високоякісний товар був одночасно і конкурентоспроможним, він має відповідати критеріям оцінювання споживачів конкретного ринку в конкретний час.

Дані для розрахунку заґального показника конкурентоспроможності розробки необхідно занести до таблиці 5.5.

	Варіан	ГИ		
Параметри	Базовий (конкурент)	Новий	Відносний показник якості	Коефіцієнт ваґомості параметра
Точність перетворення	2	4	2	0,05
Кількість вимірювальних			1.5	
каналів	2	3	1,J	0,05
Діапазон частот	6	10	1,7	0,4
Відносна похибка	3	3	1	0,05
АЧХ фільтра	3	5	1,7	0,4
Ціна за продукт, тис. грн.	10000	9500	0,95	-

Таблиця 5.5 – Нормативні, технічні та економічні параметри методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів і товару-конкурента

Загальний показник конкурентоспроможності розробки (К) з урахуванням вищезазначених ґруп показників визначаємо за формулою:

$$K = \frac{I_{\text{T.II.}}}{I_{\text{e.II.}}} = \frac{1,59}{0,95} = 1,67,$$
(5.3)

де Іт.п. – індекс технічних параметрів (відносний рівень якості інноваційного рішення); Іе.п. – індекс економічних параметрів.

Ie.
$$\pi = \frac{PHei}{PEei} = \frac{9500}{10000} = 0,95,$$
 (5.4)

де PHei, PБеі – економічні параметри (ціна придбання та споживання товару) відповідно нового та базового товарів.

Згідно розрахунків заґальний показник конкурентоспроможності – 1,67. Це означає, що наша розробка методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів більш конкурентна на 67% від товару-аналога. 5.4 Прогнозування витрат на виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської та конструкторсько-технологічної роботи

5.4.1 Розрахунок витрат, що стосуються виконавців розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Основна заробітна плата кожного із розробників (дослідників) Зо, якщо вони працюють в наукових установах бюджетної сфери:

$$30 = \frac{M}{Tp} \cdot t, \qquad (5.5)$$

де М – місячний посадовий оклад конкретного розробника (інженера, дослідника, науковця тощо), грн.

У 2019 році величини окладів (разом з встановленими доплатами і надбавками) рекомендується брати в межах (5000...10000) грн. за місяць; Тр – число робочих днів в місяці; приблизно Тр = (21...23) дні; t – число робочих днів роботи розробника (дослідника).

• • • •					
	Місячний	Оплата за	Число	Витрати на	
Посада	посадовий	робочий	днів	заробітну	
	оклад, ґрн.	день, ґрн.	роботи	плату, ґрн.	
Керівник	10000	455	5	2275	
Інженер-	7000	210	5	1500	
програміст	7000	510	5	1390	
Vouovu Touru	5000	227	5	1125	
Консультанти	5000	221	5	1155	
Всього:				5000	

Таблиця 5.6 – Заробітна плата розробників

Зроблені розрахунки зводимо до таблиці 5.6.

Основна заробітна плата робітників Зр, якщо вони беруть участь у виконанні даного етапу роботи і виконують роботи за робочими професіями у випадку, коли вони працюють в наукових установах бюджетної сфери, розраховується за формулою:

$$3p = \sum_{i=1}^{n} ti \cdot Ci, \tag{5.6}$$

де ti – норма часу (трудомісткість) на виконання конкретної роботи, годин; n – число робіт по видах та розрядах; Сі – погодинна тарифна ставка робітника відповідного розряду, який виконує дану роботу. Сі визначається за формулою:

$$Ci = \frac{M_{M} \cdot Ki}{Tp \cdot T_{3M}},$$
(5.7)

де Мм – розмір мінімальної заробітної плати за місяць, грн.; в 2019 році мінімальна заробітна плата становить – 4173 грн., Кі – тарифний коефіцієнт робітника відповідного розряду, Тр – число робочих днів в місяці; приблизно Тр = 21...23 дні; Тзм – тривалість зміни, зазвичай Тзм = 8 годин.

Величина чинних тарифних коефіцієнтів робітників відповідних розрядів для бюджетної сфери наведена в таблиці 5.6.1

таолиц	n 21011	Bein mine repreprint koopidientis poortinikis						
Розряд	1	2	3	4	5	6	7	8
Ki	1,00	1,09	1,18	1,27	1,36	1,45	1,54	1,64

Таблиця 5.6.1 – Величина тарифних коефіцієнтів робітників

			Поґодинна		
Найменування	Трудомісткість,	Розряд	тарифна	Тариф.	Величи-
робіт	н-ґод.	роботи	ставка	коеф.	на, ґрн.
Налагоджувальні	3	4	30,1	1,27	90
Складальні	2	4	30,1	1,27	60
Механічні	1	3	27,9	1,18	28
Заготівельні	4	2	25,8	1,09	103
Всього					281

Таблиця 5.7 – Заробітна плата робітників

Додаткова заробітна плата Зд всіх розробників та робітників, які брали участь у виконанні даного етапу роботи, розраховується як (10...12)% від суми основної заробітної плати всіх розробників та робітників, тобто:

$$3g = 0,1 \cdot (3p + 3o) = 0,1 \cdot (5000 + 281) = 528,1$$
 ґрн. (5.8)

Нарахування на заробітну плату Нзп розробників та робітників, які брали участь у виконанні даного етапу роботи, розраховуються за формулою: де Зо – основна заробітна плата розробників, ґрн.; Зр – основна заробітна плата робітників, ґрн.; Зд – додаткова заробітна плата всіх розробників та робітників,

грн.; β – ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, % (приймаємо для 1-го класу професійності ризику 22%).

$$H_{3\Pi} = 0,22 \cdot (3p + 3o + 3d) = 0,22 \cdot (5000 + 281 + 528,1) = 1278$$
 ґрн. (5.9)

Амортизація обладнання, комп'ютерів та приміщень А, які використовувались під час (чи для) виконання даного етапу роботи.

Дані відрахування розраховують по кожному виду обладнання, приміщенням тощо.

У спрощеному вигляді амортизаційні відрахування А в цілому бути розраховані за формулою:

$$A = \frac{II \cdot Ha}{100} \cdot \frac{T}{12},$$

де Ц – заґальна балансова вартість всього обладнання, комп'ютерів, приміщень тощо, що використовувались для виконання даного етапу роботи, ґрн.; На – річна норма амортизаційних відрахувань. Для нашого випадку можна прийняти, що На = (10...25)%; Т – термін, використання обладнання, приміщень тощо, місяці.

Найменування	Ціна, ґрн.	Норма амортизації, %	Термін використання, м.	Сума амортизації
ПК + панель оператора	7000	20	2	233
ПЛК	10000	20	2	333
Інше обладнання	9000	10	1	75
Всього			641	

Таблиця 5.8 - Амортизаційні відрахування

Витрати на матеріали М, що були використані під час виконання даного етапу роботи, розраховуються за формулою:

$$M = \sum_{1}^{n} Hi \cdot Цi \cdot Ki, ґрн$$

де Hi – кількість матеріалу і-го виду, шт.; Ці – ціна матеріалу і-го виду, ґрн.; Кі – коефіцієнт транспортних витрат, Кі = (1,1...1,15); п – кількість видів матеріалів.

Найменування матеріалу	Ціна за одиницю, ґрн.	Витрачено	Вартість, ґрн.		
Флюс ФКСН	4	0,05	0,2		
Каніфоль	14	0,3	4,2		
Припій ПОС-40	450	0,3	135		
Всього, з урахуван-					
ням коефіцієнта	24,8153				
транспортних		,			
витрат					

Таблиця 5.9 - Матеріали, що використані на розробку

Витрати на комплектуючі К, що були використані під час виконання даного етапу роботи, розраховуються за формулою:

$\mathbf{K} = \sum_{1}^{n} \mathbf{Hi} \cdot \mathbf{Li} \cdot \mathbf{Ki}$, ґрн

де Hi – кількість комплектуючих i-ro виду, шт.; Цi – ціна комплектуючих i-ro виду, грн.; Кi – коефіцієнт транспортних витрат, Ki = (1,1...1,15); n – кількість видів комплектуючих.

		1 1	1 2
Найменування матеріалу	Ціна за одиницю, ґрн.	Витрачено	Вартість, ґрн.
MEMS фільтр	400	1	400
Світодіод	30	3	90
Корпус	200	1	200
Тумблер	15	1	15
Діоди стану	2	2	4
Панель оператора	2000	1	2000
Операційний підсилювач	50	1	50
Інтерфейси	70	2	140
Джерело напруги	20	1	20
Трансформатор	45	1	45
Всього, з урахуванням коефіцієнта транспортних витрат		3260	

Таблиця 5.10 - Комплектуючі, що використані на розробку

Витрати на силову електроенергію Ве, якщо ця стаття має суттєве значення для виконання даного етапу роботи, розраховуються за формулою [63]:

$$Be = B \cdot \Pi \cdot \Phi \cdot K\pi, rph$$

В – вартість 1 кВт-ґод. електроенергії, в 2019 р. В $\approx 8,45$ грн./кВт; П – установлена потужність обладнання, кВт; Ф – фактична кількість годин роботи обладнання, ґодин, Кп – коефіцієнт використання потужності; Кп < 1.

Потужність обладнання складає – 0,5 кВт.

Кількість годин роботи складає – 700 годин.

Коефіцієнт викор. потужності -0,9.

Ве=2662 грн.

Інші витрати Він охоплюють: витрати на управління орґанізацією, оплата службових відряджень, витрати на утримання, ремонт та експлуатацію основних засобів, витрати на опалення, освітлення, водопостачання, охорону праці тощо.

Інші витрати Ів можна прийняти як (100...300)% від суми основної заробітної плати розробників та робітників, які були виконували дану роботу, тобто:

Iв =
$$2,5 \cdot (30 + 3p) = 2,5 \cdot (5000 + 281) = 13203$$
 ґрн. (5.10)

Сума всіх попередніх статей витрат дає витрати на виконання даної частини (розділу, етапу) роботи – В.

5.5 Розрахунок загальних витрат на розробку методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Загальна вартість всієї наукової роботи визначається за Взаг формулою:

Взаґ =
$$\frac{I_B}{\alpha} = \frac{13203}{0,6} = 22005$$
 ґрн, (5.11)

де α – частка витрат, які безпосередньо здійснює виконавець даного етапу роботи, у відн. одиницях.

5.6 Прогнозування витрат на виконання та впровадження методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Прогнозування загальних витрат ЗВ на виконання та впровадження методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів здійснюється за формулою [65]:

$$3B = \frac{B_{3ar}}{\beta} = \frac{22005}{0.5} = 44010 \text{ rpm}, \tag{5.12}$$

де β – коефіцієнт, який характеризує етап (стадію) виконання даної роботи.

Так, якщо розробка знаходиться: на стадії науково-дослідних робіт, то $\beta \approx 0,1$; на стадії технічного проектування, то $\beta \approx 0,2$; на стадії розробки конструкторської документації, то $\beta \approx 0,3$; на стадії розробки технологій, то $\beta \approx 0,4$; на стадії розробки дослідного зразка, то $\beta \approx 0,5$; на стадії розробки промислового зразка, $\beta \approx 0,7$; на стадії впровадження, то $\beta \approx 0,9$.

5.7 Прогнозування комерційних ефектів від реалізації методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

З метою прогнозування комерційних ефектів від реалізації методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів складемо таблицю вихідних показників, за рахунок яких і відбуватиметься отримання комерційного ефекту.

Таблиця 5.11 – Вихідні дані для прогнозування комерційного ефекту від реалізації методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Рік реалізації розробки	1	2	3
Кількість од. реалізації, шт.	200	500	700

Величина зростання ціни реалізації методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів, ґрн. – 500 ґрн.

Кількість продукції, що випускалась до впровадження методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів – 200 шт.

Збільшення чистого прибутку підприємства Пі для кожного із років, протягом яких очікується отримання позитивних результатів від впровадження розробки, розраховується за формулою:

$$\Delta \Pi \mathbf{i} = \sum_{1}^{n} (\Delta \mathbf{I} \mathbf{0} \cdot N + \mathbf{I} \mathbf{0} \cdot \Delta N) \mathbf{i} \cdot \rho \cdot \gamma \cdot (1 - \frac{\nu}{100})$$
(5.13)

де $\Delta \Pi o$ – покращення основного оціночного показника від впровадження результатів розробки у даному році. Зазвичай таким показником може бути ціна одиниці нової розробки; N – основний кількісний показник, який визначає діяльність підприємства у даному році до впровадження результатів наукової розробки; ΔN – покращення основного кількісного показника діяльності підприємства від впровадження результатів розробки; Цо – основний оціночний показник, який визначає діяльність підприємства у даному році після в провадження результатів наукової розробки; цо – основний оціночний показник, який визначає діяльність підприємства у даному році після впровадження результатів наукової розробки; п – кількість років, протяґом яких очікується отримання позитивних результатів від впровадження розробки; λ -коефіцієнт, який враховує сплату податку на додану вартість. У 2018 р. ставка податку на додану вартість дорівнює 20%, а коефіцієнт – 0,8333. З 2014 року ставка податку на додану вартість встановлена на рівні 17%, а коефіцієнт – 0,8547; ρ - коефіцієнт, який враховує рентабельність продукту. Рекомендується приймати – 0,2...0,3; υ- ставка податку на прибуток. У 2018 році – 21%, у 2013 році – 19%, а з 2014 року – 16%.

Збільшення чистого прибутку підприємства Пі протяґом першого року складе:

∆П1=25311 ґрн.

Збільшення чистого прибутку підприємства Пі протяґом другого року (відносно базового року, тобто року до впровадження результатів наукової розробки) складе:

∆П2=129530 ґрн.

Збільшення чистого прибутку підприємства протяґом третього року (відносно базового року, тобто року до впровадження результатів наукової розробки) складе:

∆П3=159060 ґрн.

5.8 Розрахунок ефективності вкладених інвестицій та період їх окупності

5.8.1 Визначення абсолютної ефективності вкладених інвестицій у розробку методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Для цього користуються формулою:

$$Eabc = (\Pi \Pi - PV), \tag{5.14}$$

де ПП – приведена вартість всіх чистих прибутків, що їх отримає підприємство (організація) від реалізації результатів наукової розробки, грн.; PV – теперішня вартість інвестицій PV = 3B, грн.

У свою чергу, приведена вартість всіх чистих прибутків ПП розраховується за формулою [66]:

$$\Pi\Pi = \sum_{1}^{\mathrm{T}} \frac{\Delta\Pi \mathrm{i}}{(1+\tau)^{t}} \tag{5.15}$$

де $\Delta\Pi$ і– збільшення чистого прибутку у кожному із років, протяґом яких виявляються результати виконаної та впровадженої НДДКР, ґрн.; т – період часу, протяґом якого виявляються результати впровадженої НДДКР, роки; τ – ставка дисконтування, за яку можна взяти щорічний проґнозований рівень інфляції в країні; для України цей показник знаходиться на рівні 0,1; t – період часу (в роках) від моменту отримання чистоґо прибутку до точки "0".

Оскільки Еабс > 0, то результат від проведення наукових досліджень та їх впровадження принесе прибуток, але це також ще не свідчить про те, що інвестор буде зацікавлений у фінансуванні розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів.

5.9 Розрахунок відносної ефективності вкладених коштів в НДДКР методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Для цього користуються формулою:

$$E_B = \sqrt[T]{1 + \frac{E_{abc}}{PV}} - 1 \tag{5.16}$$

де Еабс – абсолютна ефективність вкладених інвестицій, ґрн..; РV – теперішня вартість інвестицій PV = 3B, ґрн.; Тж – життєвий цикл наукової розробки, роки.

$$E_B = 0,6$$

Далі, розрахована величина Ев порівнюється з мінімальною (бар'єрною) ставкою дисконтування, що дорівнює:

$$\tau = d + f, \tag{5.17}$$

де d – середньозважена ставка за депозитними операціями в комерційних банках; в 2018 році в Україні d = (0,14...0,2); f – показник, що характеризує ризикованість вкладень; зазвичай, величина f = (0,05...0,1), але може бути і значно більше.

$$E_B = 0.6 \ge \tau = 0.2 + 0.1 = 0.3.$$

Оскільки величина Ев > тмін, то інвестор може бути зацікавлений у фінансуванні даної наукової розробки.

5.10 Розрахунок терміну окупності коштів, вкладених в наукову розробку методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів

Термін окупності вкладених у реалізацію наукового проекту інвестицій Ток можна розрахувати за формулою:

Ток
$$=$$
 $\frac{1}{E_B} = \frac{1}{0.6} = 1,7$ роки. (5.18)

Оскільки Ток < 3...5-ти років, то фінансування даної наукової розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів є доцільним.

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Виробнича безпека, що її розґлядає охорона праці, відіґрає велику роль для трудової діяльності, оскільки якраз вона контролює фізичний стан працівника, що не може не відображатись на його житті, здоров'ї та продуктивності роботи зокрема і у ґалузі радіотехніки.

У цьому розділі проводиться аналіз шкідливих, небезпечних [67] і уражаючих для людини і навколишнього довкілля факторів, що утворюються при проведенні дослідження методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів. Тут розґлядаються, в тому числі, технічні рішення з виробничої санітарії та гігієни праці, визначення допустимого часу перебування в зоні дії ЕMB, технічні рішення з промислової та пожежної безпеки під час проведення дослідження, безпека у надзвичайних ситуаціях.

6.1 Гігієна праці та виробнича санітарія

6.1.1 Мікроклімат та склад повітря робочої зони

Визначаємо для приміщення для проведення дослідження динамічної взаємодії мобільних пристроїв в пакетній телекомунікаційній мережі, категорію важкості робіт за фізичним навантаженням – легка Іб.

Згідно із [68] допустимі параметри температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні для теплого та холодного періодів року приведені в таблиці 6.1.

					Швидкість
Hanian Vamarani	Voratonia	Температура по	вітря, °С для	Відносна	руху
період категорія		робочих місць		вологість	повітря, м/с
року ро	poon			повітря, %	
		постійних	непостійних		
Холодний	Ia	21-25	18-26	75	δ0,1
Теплий	18	22-28	20-30	55 при 28°С	0,1-0,2

Таблиця 6.1 – Нормовані допустимі параметри мікроклімату в приміщенні

Для опромінення менше 25% поверхні тіла працівника, допустима інтенсивність теплового опромінення сладає 100 Вт/м².

Повітря робочої зони не повинно містити шкідливих речовин з концентраціями вище гранично допустимих концентрацій (ГДК) в повітрі

робочої зони та підпадає під систематичний контроль з метою запобіґання можливості перевищення ҐДК, значення яких для роботи з ЕОМ наведено в таблиці 6.2.

	L 1		
Назва шкідливої речовини	ҐДК, мґ/м ³	Агрегатний стан	Клас небезпеки
Озон	0,1	Пара	4
Оксиди азоту	5	Пара	2
Пил	4	Аерозоль	2

Таблиця 6.2 – ҐДК шкідливих речовин [70]

При роботі з ЕОМ джерелом забруднення повітря є також іонізація молекул речовин, що знаходяться в повітрі. Рівні додатних та від'ємних іонів повинні відповідати [70] та приведені в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3 – Число іонів у 1 см³ повітря приміщення при роботі на ЕОМ

· · · · · ·					
Рівні	Мінімально необхідні	Оптимальні	Максимально допустимі		
додатній	400	1500-3000	50000		
від'ємний	600	3000-5000	50000		

З метою встановлення необхідних за нормативами показників мікроклімату і складу повітря робочої зони передбачено:

1) у приміщенні має бути встановлена система опалення для холодного і кондиціонування для теплого періодів року;

2) припливно-витяжна система вентиляції, а при несприятливих поґодних умовах кондиціонування.

6.1.2 Виробниче освітлення

З метою забезпечення раціональних гігієнічних умов на робочих місцях значні вимоги висуваються щодо кількісних та якісних параметрів освітлення.

З точки зору задач зорової роботи в приміщенні, де проводиться робота з взаємодії дослідження динамічної мобільних пристроїв в пакетній телекомунікаційній мережі, відповідно до [69] знаходимо, ШО вони відповідають IV розряду зорових робіт. Приймаємо контраст об'єкта з фоном великий, а характеристику фону – середню, яким відповідає підрозряд зорових робіт в.

Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) і мінімальні значення освітленості при штучному освітленні наведені в таблиці 6.4.
Таблиця 6.4 — Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення і мінімальні освітленості при штучному освітленні

рової	мір ія, мм	боти	BOÏ	Та НОМ	рону	Oc	вітленість п	ри	КПО боков освітлен	для оґо иня %
ика зс оти	менший роз а розрізненн д зорової ро		(30 р о) ТИ	об'єк я з фо	гика (штучному освітленні, лк		к		Сумі шен
робс			зряд робс	раст	рис			I	Приро	010
rep 1			bo 1	HT] 3H	сте	КО	мбіноване	заґ	приро	
akı	Іай єкт	зря,	Tiŋ	Koi ə3pi	ıран	BC		ал	дного	
Kap	Е. 6`6	Po	Ι	þc	Xa	ьо у 1. ч. від		ьн		
Ň	0					ґо	3414,1154010	e		
Середньої	0.5-1	IV	В	середні	cepe-	400	200	200	1.5	0,9
точності	0,0 1	. •	D	Й	дній	100	200	200	1,5	

Так як приміщення знаходиться в місті Вінниця (2-га група забезпеченості природним світлом), а вікна розташовані за азимутом 180°, то за таких обставин КЕО визначатиметься за формулою [3,4]

$$e_{\rm N} = e_{\rm H} m_{\rm N} \, [\%],$$
 (6.1)

де $e_{\rm H}$ – табличне значення КЕО для бокового освітлення, %;

*m*_N – коефіцієнт світлового клімату;

N – номер ґрупи забезпеченості природним світлом.

Підставляючи відомі значення одержимо нормовані значення КПО для бокового та суміщеного освітлення:

$$e_{\text{N.6}} = 1,5 \cdot 0,85 = 1,28 \ (\%);$$

 $e_{\text{N.c}} = 0,9 \cdot 0,85 = 0,77 \ (\%).$

Для встановлення нормованих значень параметрів освітлення запропоновано:

1) при недостатньому природному освітлені в світлу пору доби доповнення штучним за допомогою люмінесцентних ламп з утворенням системи суміщеного освітлення;

2) використання штучного освітлення в темну пору доби.

6.1.3 Виробничі віброакустичні коливання

Зважаючи на те, що при використанні пристроїв крім усього іншого устаткування використовується обладнання, робота якого супроводжується шумом та вібрацією, необхідно передбачити шумовий та вібраційний захист.

Визначено, що приміщення, в якому відбувається робота з дослідження динамічної взаємодії мобільних пристроїв в пакетній телекомунікаційній мережі може мати робочі місця із шумом та вібрацією, що створюється вентиляторами блоку живлення ЕОМ та кулерами мікропроцесора, відеоадаптера.

Для попередження травмування працівників від дії шуму він підлягає нормуванню. Головним документом з питань виробничого шуму, діючим в Україні, є [71], у відповідності з яким допустимі рівні звукового тиску, рівні звуку і еквівалентні рівні шуму на робочих місцях в виробничих приміщеннях не повинні бути більшими ніж значення, які приведені в таблиці 6.5.

F	Рівні з сеј	вуково редньо	ζ 3	Рівні звуку і еквівалентні рівні звуку, дБА					
31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
86	71	61	54	49	45	42	40	38	50

Таблиця 6.5 – Допустимі рівні звукового тиску та еквівалентні рівні звуку

Норми виробничих вібрацій наведені в таблиці 6.6 для локальної вібрації.

Таблиця 6.6 – Допустимі рівні віброприскорення [72]

Грани 1	ично доі полосах	Коректовані рівні віброприскорення, дБА						
8	16	31,5	63	125	250	500	1000	
73	73	79	85	91	97	103	109	76

Для забезпечення допустимих параметрів шуму та вібрації в приміщенні запропоновано:

1) оздоблення стін спеціальними перфорованими плитами, панелями з метою шумопоглинання;

2) контроль рівня шуму та вібрації не менше 1 разу на рік.

6.1.4 Виробничі випромінювання

Проведений аналіз умов праці показав, що приміщення, де проводиться робота з дослідження може містити електромагнітні випромінювання.

Гранично допустимі рівні електромаґнітних полів наведені в таблиці 6.7.

Таблиця 6.7 – Гранично допустимі значення електромагнітних полів на робочих місцях згідно [78]

Параметри та		Ґраничні значення в діапазонах частот								
одиниці	1-10	10-60	0,06-3	3-30	30-50	50-300				
вимірювання	ҝҐц	кҐц	ΜҐц	ΜҐц	МҐц МҐц					
Е _{ГД} , В/м	1000	700	500	300	80					
ЕН _{Егд} , (В/м) ² ·год	120000	40000	20000	7000	800					
Нґд, А/м	75	57	50	—	3,0	—				
ЕН _{нгд} , (А/м) ² ·год	675	390	200	_	0,72	_				

Для забезпечення захисту та досягнення нормативних рівнів випромінювань потрібно використовувати екранування робочого місця і скорочення часу опромінення за рахунок перерв на відпочинок.

Виконати розрахунок допустимого часу перебування в зоні дії електромагнітного випромінювання, якщо фактична напруженість електричного поля $E_{\phi} = 32$ В/м, а фактична напруженість магнітного поля $H_{\phi} = 17$ А/м.

Допустимий час перебування будемо визначати як найменший із допустимих часів перебування для джерел електричної та магнітної складових ЕМВ, відповідно

$$T = \min\{T_E, T_H\} \text{ [год]}, \tag{6.2}$$

де *T_E* – допустимий час в зоні дії джерела електричного поля, год;

T_H – допустимий час в зоні дії джерела маґнітного поля, год.

Допустимий час перебування в зоні дії електричної та маґнітної складових електромаґнітного випромінювання визначається за формулою

$$T_E = \frac{EH_{E\Gamma\underline{H}}}{E_{\phi}^2}$$
[roд], (6.3)

$$T_{H} = \frac{EH_{H\Gamma \underline{\beta}}}{H_{\phi}^{2}}$$
[roд], (6.4)

де *ЕН_{Егд}* – ґранично допустиме енерґетичне навантаження на орґанізм протяґом робочоґо дня, (В/м)²·год;

 E_{ϕ} – фактична напруженість електричного поля, В/м;

ЕН_{нгд} – гранично допустиме енергетичне навантаження на організм протяґом робочого дня, (А/м)²·год;

 H_{ϕ} – фактична напруженість маґнітного поля, А/м.

Для діапазону частот 30...50 МҐц вибираємо $EH_{Ero} = 800 \text{ (B/м)}^2 \cdot \text{год};$ $EH_{Hro} = 0,72 \text{ (A/м)}^2 \cdot \text{год}.$

Після підстановки відомих значень у формули (6.3, 6.4, 6.2), одержимо:

$$T_E = \frac{800}{13^2} = 4,73 \text{ (год)};$$
$$T_H = \frac{0,72}{45^2} = 0,00036 \text{ (год)};$$
$$T = \min\{4,73; 0,00036\} = 0,00036 \text{ (год)}.$$

Таким чином, допустимий час перебування працівника в зоні дії електромаґнітного випромінювання не повинен перевищувати 0,00036 год.

6.2 Технічні рішення з промислової та пожежної безпеки під час проведення дослідження

На теперішньому етапі розвитку техніки, автоматизації розробок та досліджень широкого використання на робочому місці набули ЕОМ. Велика кількість прикладних програм перетворює ЕОМ на основне знаряддя праці радіоінженера.

6.2.1 Безпека щодо організації робочих місць

Робочі місця з відеодисплейним терміналом зобов'язані розташовуватись на відстані не менше як 1,5 м від стіни з вікнами, від інших стін – на віддалі 1 м, між собою на відстані не менше як 1,5 м. При розміщенні робочих місць потрібно виключити можливість прямого засвічування екрану джерелом природного освітлення. Робоче місце раціонально розміщати таким чином, щоб природне світло падало на нього збоку, бажано зліва [73].

Поверхня екрана повинна розташовуватись на віддалі 400-700 мм від орґанів зору працівника. Висота робочої поверхні столу при виконанні роботи сидячи має регулюватися у межах 680-800 мм. Робочий стіл повинен мати простір для ніґ висотою не менше 600 мм, шириною не менше як 500 мм, ґлибиною на рівні колін не менше 450 мм та на рівні витяґнутої ноги не менше ніж 650 мм [74].

6.2.2 Електробезпека

У середині приміщення, в якому проводиться робота з дослідження динамічної взаємодії мобільних пристроїв в пакетній телекомунікаційній мережі, значну уваґу слід надати уникненню заґрози ураження електричним струмом. Згідно [76] дане приміщення відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою ураження електричним струмом в наслідок наявності значної 75 %) відносної вологості. Тому безпека (понад використання електрообладнання повинна гарантуватись рядом заходів, які передбачають використання ізоляції струмовідних елементів, захисних блокувань, захисного заземлення та ін [77].

6.2.3 Пожежна безпека

Відповідно до [78] приміщення, де проводиться робота з дослідження динамічної взаємодії мобільних пристроїв в пакетній телекомунікаційній мережі, відноситься до категорії пожежної небезпеки Б. Це приміщення відноситься до 3-го ступеня вогнестійкості, в якому приміщення знаходяться в будівлі з несучими та огороджувальними конструкціями з природних або матеріалів, бетону, залізобетону. Для перекриттів штучних кам'яних дозволяється застосовувати дерев'яні конструкції, захищені штукатуркою або негорючими листовими, плитними матеріалами, або матеріалами ґруп горючості Г1, Г2. До елементів покриттів не висовуються вимоги щодо межі воґнестійкості, поширення воґню, при цьому елементи ґорищного покриття з деревини повинні мати воґнезахисну обробку.

Мінімальні межі воґнестійкості конструкцій розґлядуваного приміщення наведені в таблиці 6.8.

Ступі		Сті	НИ		K	Cxi	•	Елементи	покриття
нь воґне стійк ості будів лі	Несучі та східчас ті клітки	Сам онес учі	Зов ніш ні нес учі	Перегородки	к о л о н и	дчас ті май дан чик и	Плити та інші несучі констр укції	Плити, проґон и	Балки, ферми
3	REI 120	REI 60	E 15	EI 15	R 120	R 60	REI 45	НН	нн
	M0	M0	M0	M1	M0	M 0	M1	HH	НН

Таблиця 6.8 – Значення мінімальних меж воґнестійкості приміщення [78]

Примітка. R – втрати несучої здатності; Е – втрати цілісності; І – втрати теплоізолювальної спроможності; М – показник здатності будівельної конструкції поширювати вогонь (межа поширення воґню); М0 – межа поширення воґню дорівнює 0 см; М1 – М δ 25 см – для горизонтальних конструкцій; М δ 40 см – для вертикальних і похилих конструкцій; М2 – М > 25 см – для горизонтальних конструкцій; М > 40 см – для вертикальних і похилих конструкцій, нн – не нормується.

В таблиці 6.9 приведено протипожежні норми проектування будівель і споруд.

	1				1								
б'єм приміщення, тис. _М ³	Категорія пожежної небезпеки	тупінь вогнестійкості	Відо щі. лю, с заґа пр	станн при льно дсько этоку ально роход сіб/м	», М, сті оґо у в ому ці, ц ²	сількість людей на 1 м ширини еваковиходу	Про ні р сту воґн	тип розр и, пј упен нест ті	ожеж иви, ои ні їх ійкос	Найб ільша кільк ість повер хів	Площа пожеж для	поверх кного в числа п	ку в межах ідсіку, м ² , юверхів
0		\circ	до 1	2-3	4-5	г Х	I,II	III	IV,V		1	2	3 і більше
до 15	В	3	100	60	40	110	9	12	15	3	5200	3500	2600

Таблиця 6.9 – Протипожежні норми проектування будівель і споруд [78]

Примітки: н.о. – не обмежується, н.н. – не нормується.

Встановлюємо, що приміщення, де проводиться робота з дослідження, має бути обладнане двома вогнегасниками, пожежним щитом, а також ємністю з піском [78].

6.3 Безпека у надзвичайних ситуаціях

Дослідження стійкості роботи активного високочастотного MEMS фільтра в умовах впливу загрозливих чинників надзвичайних ситуацій.

В складі активного високочастотного MEMS фільтра є блоки, в яких застосовуються елементи в склад яких входять такі матеріали як метали, неорганічні матеріали, провідники, діелектрики, смоли і різноманітні сполуки. В радіоелектронних елементах іонізуючі випромінювання викликають зворотні і незворотні процеси, внаслідок яких можуть відбуватися порушення роботи електричних елементів схеми, що призводять до виходу з ладу апаратури. Так, проходячи через елементи пристрою, потік γ -випромінювань створює в них вільні носії електричних зарядів, які призводять до помилкового імпульсу і відповідно до спрацьовування пристрою.

Значні опромінення працездатності дози викликають втрату комплектуючих елементів систем радіоелектроніки. В результаті опромінення у транзисторах змінюється обернений струм і коефіцієнт підсилення, у конденсаторах знижуються напруга пробою та опір стікання, змінюється провідність і внутрішній наґрів, руйнується електрична ізоляція дротів з полімерних матеріалів. Органічні діелектрики змінюють: електричну провідність і танґенс кута втрат.

Практика експлуатації радіоелектронної апаратури в умовах впливу іонізуючих випромінювань дозволяє зробити наступні висновки, що радіоелектронна апаратура може втратити працездатність при визначених критичних рівнях випромінювання миттєво.

В елементах схем радіоелектронної апаратури можуть розпочатися зворотні чи незворотні зміни через визначений час після забруднення при рівнях випромінювання значно нижчих від критичних. Більшість електронних схем і обладнання, чутливі до дії електромаґнітного імпульсу, але повинні зберігати працездатність в умовах його впливу. До основних параметрів електромаґнітного імпульсу відносять форму і тривалість електромаґнітного імпульсу, амплітуду імпульсу (максимальна напруженість поля) та діапазон частот електромаґнітного випромінювання.

При оцінці впливу електромаґнітного імпульсу на струмоведучі елементи необхідно враховувати, що електромаґнітні випромінювання мають горизонтальну і вертикальну складові напруженості і тому повинні визначатися значення напруг, які наводяться як на вертикальних, так і на горизонтальних ділянках ліній. Основну небезпеку являє вертикальна складова напруженості електричного поля, яка перевищує горизонтальну складову в тисячу раз.

6.3.1 Дослідження стійкості роботи активного високочастотного MEMS фільтра в умовах впливу іонізуючих випромінювань

З схем активного високочастотного MEMS фільтра визначаємо всі елементи від яких залежить його робота. Приймаючи до уваги елементну базу, що використовується для пристрою складемо таблицю, де вказуємо максимально допустимі дози ґамма-випромінювання.

		1	1
	Елементи активного високочастотного	Д _{rp,} P	Дгр.сист, Р
N⁰	MEMS фільтра		
1	Мікросхема	10 ³	
2	Резистори МЛТ, СМД	10 ⁵	10^{3}
3	Конденсатори Ср-13.020	107	
4	Мікросхеми ATmega16a, TPIC6B595	104	

Таблиця 6.10 – Максимально допустимі дози елементів пристрою.

Границю стійкості роботи в цілому активного високочастотного MEMS фільтра визначаємо по мінімальному значенню ґраничних доз окремих елементів, при яких в елементній базі виникають, необоротні зміни. Отже, найуразливішими елементами даного пристрою в умовах дії іонізуючих випромінювань, є мікросхема тобто приймається значення ($Д_{rp} = 10^3$ P) і визначається можлива доза опромінення $Д_{м}$ за формулою:

$$\mathcal{A}_{M} = \frac{2 \cdot p_{1\max} \cdot (\sqrt{t_{k}} - \sqrt{t_{n}})}{K_{nocn}} \quad (P), \tag{6.5}$$

де *p*_{1max} – максимальне значення рівня радіації;

*К*_{посл} – коефіцієнт послаблення приміщення (К_{посл}=1);

t_n – час початку опромінювання;

*t*_{*k*} – час кінця опромінювання;

Відомо, що максимальне значення рівня радіації p_1 , яке очікується на дорівнює 4,15 (Р/год), коефіцієнт послаблення радіації К_{посл} = 1, час початку опромінення $t_n = 1$ (год), а кінцевий час напрацювання мікросхеми на відмову приймаємо рівним 12500 годин безперервної роботи. Отже, при таких умовах можлива доза опромінення буде дорівнювати:

$$\mathcal{I}_{M} = \frac{2 \cdot 4,15 \cdot (\sqrt{12500} - \sqrt{1})}{1} = 1036,18 \quad (P)$$

Допустимий час роботи пристрою в заданих умовах можна визначити за допомогою виразу:

$$t_{\partial} = \left(\frac{\mathcal{I}_{\rho} \cdot K_{nocn} + 2 \cdot p_{1,max} \cdot \sqrt{t_n}}{2 \cdot p_{max}}\right)^2.$$
(6.11)

Оскільки всі значення відомі, то допустимий час роботи РЕА буде таким:

$$t_{\partial} = \left(\frac{10^3 \cdot 1 + 2 \cdot 4, 15 \cdot \sqrt{1}}{2 \cdot 4, 15}\right)^2 = 10812, 6$$
 (год).

З розрахунків можна зробити висновок, що робота активного високочастотного MEMS фільтра в умовах дії іонізуючих випромінювань буде стійкою, тому що граничне значення експозиційної дози $Д_{rp} = 10^3$ Р співрозмірне значенню можливої дози опромінення $Д_{M} = 1036,18$ Р. Отже, заходи щодо підвищення стійкості роботи активного високочастотного MEMS фільтра мають збільшити $K_{посл}$ хоч в 2 рази.

6.3.2 Оцінка стійкості роботи активного високочастотного MEMS фільтра в умовах дії електромагнітного імпульсу

Критерієм стійкості роботи активного високочастотного MEMS фільтра в умовах дії електромагнітного імпульсу є значення коефіцієнта безпеки роботи K_{δ} , який має бути більше 40 дБ, а визначається по формулі:

$$K_{\delta} = 20 \lg \frac{U_{\delta}}{U_{\theta(\varepsilon)}} \ge 40 \ [\mathrm{д}\mathrm{B}], \tag{6.12}$$

де U_a - допустимі коливання напруґи живлення пристрою;

U_{s(г)} - напруґа вертикальної чи ґоризонтальної напруґи наводки.

Початкові дані: напруга живлення $U_{\mathcal{H}}=5$ В; $l_{\tau}=0,2$ м; $l_{\theta}=0,18$ м; $E_{\theta}=10,35$ кВ/м;

Визначається ґоризонтальна складова напруженості електричного поля за формулою:

$$E_{\rm r} = 10^{-3} \cdot E_{\rm B}$$
, (6.13)

і розраховується:

$$E_r = 10^{-3} \cdot 10,35 = 10,35 \cdot 10^{-3} (\kappa B/m).$$

Визначаються напруги наводки у струмопровідних частинах:

$$U_{fl} = E_{\theta} \cdot l_{fl} \tag{6.14}$$

$$U_{BI} = E_{t} \cdot l_{BI}, \tag{6.15}$$

Розраховується напруґа наводки у ґоризонтальних струмопровідних частинах:

$$U_{II} = 10,35 \cdot 1,72 = 1861(B),$$

та у вертикальних:

$$U_{BI} = 10,35 \cdot 10^{-3} \cdot 0,193 = 1,87$$
(B).

Визначимо допустиме коливання напруги живлення:

$$U_{\partial_2} = 5 + \frac{5}{100} \cdot 5 = 5,25 \text{ (B)}.$$

Коефіцієнти безпеки визначаються за формулою (6.15) окремо вертикальних і горизонтальних струмопровідних частин:

$$K_{\text{\tiny EBI}} = 20 \lg \frac{5,25}{1,87} = 32,6 \, (\text{дБ});$$

та горизонтальної складової:

$$K_{\rm EFT} = 20 \lg \frac{5,25}{1861} = -21,3 \, ({\rm дБ});$$

Так як $K_{\text{БВI}} = 32,6 < 40$ дБ і $K_{\text{БГI}} = -21,3 < 40$ дБ, то даний активний високочастотний MEMS фільтр є нестійкими в роботі при впливах електромаґнітного імпульсу, тому необхідно розробити заходи щодо підвищення стійкості його роботи.

6.3.3 Розробка заходів по підвищенню стійкості роботи активного високочастотного MEMS фільтра рідини в умовах дії заґрозливих чинників HC

Найбільш ефективним способом підвищення стійкості роботи РЕА є екранування блоків пристрою або його елементів. Для цього проводиться

розрахунок екранування. Визначається перехідне затухання енергії електричного поля стальним екраном:

$$A = K_{\delta h o m} - K_{\delta m i h}, \qquad (6.16)$$

де К_{бном} - номінальний коефіцієнт безпеки (К_{бном} = 40дБ);

К_{бмін} - мінімальний коефіцієнт безпеки отримання під час розрахунків.

$$A = 40 + 20,3 = 60,3(\partial E)$$

Товщину захисного екрану знаходимо за формулою:

$$t = \frac{A}{5, 2 \cdot \sqrt{f}} \quad , \tag{6.17}$$

де *А* – перехідне затухання екрану;

f – найбільш характерна частота (15 кҐц);

$$t = \frac{60,3}{5,2 \cdot \sqrt{15000}} = 0,0946 \ (CM).$$

При екрануванні активного високочастотного MEMS фільтра з використанням екрану товщиною в 1 мм зі сталі, він буде стійким в умовах дії електромаґнітного імпульсу.

Отже, з дослідження впливу іонізуючого випромінювання можна зробити висновок, що робота активного високочастотного MEMS фільтра в цих умовах буде стійкою, тому що ґраничне значення експозиційної дози $Д_{rp} = 10^3 P$ рівне значенню можливої дози опромінення $Д_{M} = 1036,18P$. Тому можна вважати, що пристрій стійкий до дії іонізуючих випромінювань. З оцінки впливу електромаґнітного імпульсу на стійкість роботи пристрою можна сказати, що він виявився нестійким. Застосування екранів в активному високочастотному MEMS фільтрі суттєво підвищує його стійкість в умовах дії електромаґнітного імпульсу.

В результаті застосування екранів пристрій буде працювати стійко, аж до значення напруженості вертикальної складової (9,35 кВ/м) Ще одним варіантом підвищення роботи стійкості апаратури до дії імпульсу є зменшення довжин струмопровідних частин шляхом вдосконалення схемокомпоновки елементів активного високочастотного MEMS фільтра. Крім цього необхідно екранувати

кабелі живлення, а також застосувати конструкції вбудованих зенерівських діодів.

Висновки до розділу

Під час написання цього розділу було розглянуто такі питання охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, як технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії, визначення допустимої сили струму в провіднику (антені), при якій напруженість магнітного поля на робочому місці знаходиться в межах норми, технічні рішення з промислової та пожежної безпеки під час проведення дослідження динамічної взаємодії мобільних пристроїв в пакетній телекомунікаційній мережі, безпека у надзвичайних ситуаціях.

ВИСНОВОК

1. Проведено дослідження характеристик п'єзоелектричного резонатора за допомогою МСЕ і розроблена еквівалентна схемна модель резонатора, придатна для розрахунку електричних характеристик конструкцій резонаторів різних типів в широкому діапазоні частот. Представлено результати дослідження, що підтверджують значну перевагу моделі п'єзоелектричного резонатора перед класичним, більш заґальним підходом Мейсона. Показана можливість інтеграції моделі в більшість сучасних САПР і її застосування як для прискореного розрахунку і оптимізації конструктивних фільтрів на поверхнево акустичних хвилях високого порядку,

2. Проведено аналіз впливу реактивних навантажень на характеристики п'єзоелектричного резонатора. Показана можливість використання схем активних еквівалентів індуктивності і від'ємної ємності на основі ОУТ для реалізації ланок активних фільтрів з діапазоном перебудови до 200% і вище. Показано, що характеристики ланок фільтрів з активними елементами часто перевершують характеристики пасивних аналогів.

3. Розглянуто алґоритм синтезу фільтрів, заснований на заміщення прототипів пасивних LC фільтрів активними аналогами на п'єзоелектричних резонаторах, що забезпечують поліпшені характеристики за рахунок високої вихідної добротності і стабільності пасивної підсхеми. Наведено результати застосування такого підходу для реалізації малогабаритних активних ФНЧ і ФВЧ на операційних підсилювачах та на п'єзоелектричних резонаторах.

Розрахунки на економічність приладу показали, що його впровадження у виробництво є економічно ефективним. Оскільки Ток < 3...5-ти років, то фінансування даної наукової розробки методів синтезу активних високочастотних MEMS фільтрів є доцільним.

При запроваджені у виробництво виробник отримає прибуток. Аналізуючи ринок можна розраховувати на значний попит на наш виріб. Підтвердженням цьому є технічні параметри даного пристрою, які кращі за параметри аналога.

В розділі охорони праці було розглянуто такі питання як безпека в надзвичайних ситуаціях, як технічні рішення з гігієни праці та виробничої санітарії, визначення безпечної відстані при оптичному випромінюванні, технічні рішення з промислової та пожежної безпеки при проведенні дослідження радіовимірювального параметричного перетворювача оптичного випромінювання, безпека у надзвичайних ситуаціях.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Справочник по расчету и проєктированию ARC – схем. /Под ред. А.А. Ланне. - :М: Радио и связь, 1984, - 366 с.

2. Современная теория фильтров и их проектирование. /Под ред. Г.Темеша, С.Митра – М: Мир, 1977, - 560 с.

3. Кауфмон М. Сидман А. Практическое руководство по расчётам в электротехнике. – Справочник, т.2, М: Энергоатомиздат, 1993, - 287 с.

4. Филатов Г.А, Баев Е.Ф, Цымбалюк В.С, - Малогабаритные низкочастотные механические фильтры. – М.: Связь, 1974, - 264 с.

5. Оноэ М. Кристаллические, керамические, электромеханические фильтры японского производства. /ТИИЭР. – Т.67, № 1, 1979, - 114 с.

6. Речицкий В.И. Акустоэлектронные радиокомпоненты. – М.: Сов. Радио, 1980, - 261 с.

7. Александрова Г.Н. Активные RC – фильтры на операционных усилителях. Пер. с англ./ под ред. – М.: Энергия, 1974, - 62 с.

8. Знаменский А.Е., Теплюк И.М. Активные RC – фильтры. – М.: Связь, 1970, - 280 с.

9. Мошнц Г., Хорн П. Проектирование активных фильтров: пер. с англ./под ред. И.М. Теплюка. – М.: Мир, 1984, - 320 с.

10. Козловский В.О. Техніко – економічне обґрунтування та економічні розрахунки в дипломних проектах та роботах. Вінниця ВДТУ, 2003,-74 с.

11. Джонсон Д., Джонсон Дж., Мур Г. Справочник по активным фильтрам. – М.: Энергоатомиздат, 1983, - 128 с.

12. Хьольсман Л.П., Аллен Ф.Е. Введение в теорию и расчёт активных фильтров: Пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1984, - 384 с.

13. Лэм Г. Аналоговые и цифровые фильтры. – М.: Мир, 1982, - 596 с.

14. Чуа Л.О., Пен-Мин-Лин. Машинный анализ электронных схем. – М.: "Энергия", 1980, - 638 с.

15. Влах Н., Синґхал К. Машинные методы анализа и проектирования электрических схем. – М.: Радио и связь, 1988, - 560 с.

16. Pat. US20130057360 A1 Wide–band acoustically coupled thin–film baw filter / J. Meltaus, T. Pensala; assigned 07.03.2013.

17. 2. Pat. US7492242 B2 Integrable tunable filter circuit comprising a set of BAW resonators / J.–F. Carpentier; assigned 17.02.2009.

18. Federal Communications Commission FCC No02-48 / assigned 2002.

19. European Standard (Telecommunications series) ETSI EN 300 910 V8.5.1 / assigned 2000.

20. Pipilos S. Design of active RLC integrated filters with application in the GHz range / S. Pipilos, Y. Tsividis // IEEE International Symposium on Circuits and Systems, ISCAS '92. – 1992. – P. 645–648.

21. Dulger F. A 1.3–V 5–mW fully integrated tunable bandpass filter at 2.1 GHz in 0.35–um CMOS / F. Dulger, E. Sanchez–Sinencio, J. Silva–Martinez // IEEE Journal of Solid–State Circuits. – 2003. – Vol. 38, № 6. – P. 918–928.

22. Філатов Г. А. Малогабаритні низькочастотні механічні фільтри / Г. А. Філатов, Е. Ф. Баєв, В. С. Цимбалюк. – Москва: Зв'язок, 1972.

23. De Los Santos HJ RF MEMS Circuit Design for Wireless Communications / HJ De Los Santos. – Boston: Artech House, 2002. – ISBN 978–1–58053–329–2.

24. Lebel E. Field programmable Gm–C array for wide frequency range bandpass filter applications / E. Lebel, A. Assi, M. Sawan // IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 2005. ISCAS 2005. – 2005. – Р. тисячі дев'ятсот п'ятьдесят дві –1955 Vol. 3.

25. Smythe RC Current Trends in Crystal Filters / RC Smythe, MD Howard // 37th Annual Symposium on Frequency Control. 1983. – 1983. – P. 348–353.

26. Mahon S. Bulk Acoustic Wave Devices – Why, How, and Where They are Going / S. Mahon, R. Aigner // Compound Semiconductor Manufacturing Technology Organization: CS MANTECH. – Austin, Texas, USA: 2007. – P. 15–18.

27. Haartsen JC Development of a monolithic, programmable SAW filter in silicon / JC Haartsen // IEEE MTT–S International Microwave Symposium Digest. – 1990. – P. 1115–1118.

28. Mueller W. A brief overview of FBAR technology / W. Mueller // Agilent Technologies, Inc. -2001. - P. 7.

29. Shin J.–S. Balanced RF Duplexer with Low Interference Using Hybrid BAW Resonators for LTE Application / J.–S. Shin, I. Song, C.–S. Kim, M.–C. Lee, SU Son, D.–H. Kim, H.–S. Park [et al.] // ETRI Journal. – 2012. – Vol. 36, № 2. – P. 317–320.

30. Hikita M. New band–switching SAW antenna duplexer used in 800–MHz Japanese cdmaOne systems / M. Hikita, K. Sakiyama, M. Kijima, O. Hikino // 2000 IEEE Ultrasonics Symposium. – 2000. – P. 383–386.

31. Hikita M. New low-distortion band-switching techniques for SAW antenna duplexers used in ultra-wide-band cellular phone / M. Hikita, K. Sakiyama, O. Hikino, M. Kijima // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. -2002. - Vol. 52, No 1. - P. 38-45.

32. Loebl HP Narrow band bulk acoustic wave filters / HP Loebl, C. Metzmacher, RF Milsom, R. Mauczok, W. Brand, P. Lok, A. Tuinhout [et al.] // IEEE Ultrasonics Symposium. – 2002. – P. 411–415.

33. Marksteiner S. A miniature BAW duplexer using flip-chip on LTCC / S. Marksteiner, M. Handtmann, H.-J. Timme, R. Aigner, R. Welzer, J.Portmann, U. Bauernschmitt // IEEE Symposium on Ultrasonics. – 2003. – P. 1794–1797.

34. Zheng Y. Operational transconductance amplifiers for gigahertz applications / Y. Zheng // 2008.

35. Lakin KM Development of miniature filters for wireless applications / KM Lakin, GR Kline, KT McCarron // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. – 1995. – Vol. 43, № 12. – P. 2933–2939.

36. Осадчук В.С. Индуктивный эффект в полупроводниковых приборах. –К.: Вища школа, 1987. –155с.

37. Авакянц Г.М., Гринберг И.С., Заугольникова Е.Г., Мироненко З.П., Михеева Е.П. Об индуктивности германиевых и кремниевых диодов. Сб. Электроннодырочные переходы в полупроводниках. АН Уз.ССР, 1962. С.37-40.

38. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. –М.: Радио и связь, 1990. –264с.

39. Колосов А.А., Ґорбунов Ю.И., Наумов Ю.Е. Полупроводниковые твердые схемы. –М.: Сов. радио, 1965. –495 с.

40. Прозоровский В.Е., Колесов Л.Н., Афанасьев К.Л. Стабильность добротности цепи с индуктивным эффектом, выполненном на основе p-n переходов. Известия ВУЗов. Радиотехника, т.7, №3, 1964. С.316-321.

41. Прозоровский В.Е., Колесов Л.Н., Афанасьев К.Л., Семенцов В.И. Анализ некоторых параметров индуктивного и реактивного транзисторов. Известия ВУЗов. Радиотехника, т.6, №6, 1963. С.616-620.

42. Некрасов М.М., Осадчук В.С. Некоторые вопросы управления индуктивностью транзистора. Сб. Вопросы микроэлектроники. –К.: Наукова думка, 1971. С.120-126.

43. Некрасов М.М., Осадчук В.С. Индуктивные свойства высокочастотных транзисторов. Сб. Полупроводниковая техника и микроэлектроника, вып.5. –К.: Наукова думка, 1970. С.157-159.

44. Осадчук В.С., Одобецкий С.И. Фотореактивный эффект в транзисторах со структурой металл-диэлектрик-полупроводник. Радиотехника и электроника. №11, т.34, 1989. С.2387-2393.

45. Осадчук В.С., Носолюк В.Н., Яремчук В.Ф. О влиянии некоторых физикотехнологических параметров составного транзистора на его индуктивность и добротность. –М.: ЦНИИ «Электроника», Электронная техника. Микроэлектронные устройства, сер.10, вып.5(89), 1992. С.36-40. 46. Осадчук В.С., Носолюк В.Н., Яремчук В.Ф. Дослідження впливу оптичного випромінювання на параметри p-n переходу. Вісник ВПІ, №3, 1996. С.63-65.

47. Осадчук В.С., Яремчук В.Ф., Кравчук Н.С., Носолюк В.Н. Дослідження температурної залежності імпедансу польових транзисторів. Вісник ВПІ, №4, 1996. С.65-68.

48. Осадчук О. В. Теоретичні основи побудови генераторів електричних коливань на транзисторних структурах з від'ємним опором / О. В. Осадчук, А. О. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету. – 2006. – №2, Т.1 (79). –147–151 с.

49. Осадчук В. С. Реактивні властивості транзисторів та транзисторних схем / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 1999. – 275 с.

50. Осадчук В. С. Температурні та оптичні мікроелектронні частотні перетворювачі / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, В. Г. Вербицький. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2001. – 195 с.

51. Осадчук В. С. Сенсори вологості / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2003. – 208 с.

52. Осадчук В. С. Сенсори тиску і маґнітного поля / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2005. – 2007 с.

53. Осадчук В. С. Мікроелектронні сенсори температури з частотним виходом / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Н. С. Кравчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ– Вінниця, 2007. – 162 с.

54. Осадчук А. В. Фоточувствительные преобразователи на основе структур с отрицательным сопротивлением / Александр Владимирович Осадчук. – Винница : Континент, 1998. – 129 с.

55. Осадчук О. В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від'ємним опором / Олександр Володимирович Осадчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2000. – 302 с.

56. Федотов Я. А. Основы физики полупроводниковых приборов / Я. А. Федотов. – М.: Высш. школа, 1980. – 390 с.

57. Разевиг В. Д. Применение программ P-CAD и Pspice для схемотехнического моделирования на ПЭВМ / В. Д. Разевиг. – М. : Радио и связь, 1992. – Вып. 2: Модели компонент аналоговых устройств. – 72 с.

58. Зи С. Физика полупроводниковых приборов. Т. 1 / С. Зи. – М. : Мир, 1984.–456 с.

59. Ферри Д. Электроника ультрабольших интегральных схем / Д. Ферри, Л. Эйкерс, Э. Гринич. – М. : Мир, 1991. – 327 с.

60. Березин А. С. Технология и конструирование интегральных микросхем: Учебное пособие для вузов / А. С. Березин, О. Р. Мочалкина. – М. : Радио и связь, 1992. – 320 с.

61. Метрология и радиоизмерения в телекоммуникацинных системах: Учебное пособие / [Под. ред. В. Ф. Нефедова] – М. : Высшая школа, 2001. – 383 с.

62. Козловський В. О. Основи підприємництва. Курс лекцій. Част. 1. / В. О. Козловський – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 196 с.

63. Козловський В. О. Основи підприємництва. Курс лекцій. Част. 2 / В. О. Козловський – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 184 с.

64. Козловський В. О. Інноваційний менеджмент : Навчальний посібник / В. О. Козловський – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 210 с.

65. Козловський В. О., Лесько О. Й. Бізнес-планування: Навчальний посібник / В. О. Козловський, О. Й. Лесько [2-е вид., доп. та переробл.] – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, ВНТУ, 2008. – 241 с.

66. Козловський В. О., Лесько О. Й. Інноваційний менеджмент: Практикум / В. О. Козловський, О. Й. Лесько. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 166 с.

67. ГОСТ 12.0.003-74.ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

68. ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

69. ДБН В.2.5-28-2006. Природне і штучне освітлення.

70. Пособие по расчету и проектированию, естественного, искусственного и совмещенного освещения НИИСФ – М.: Стройиздат. 1985. – 384 с.

71. ДСН 3.3.6-037-99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

72. ДСН 3.3.6.03999. Державні санітарні норми виробничої та заґальної вібрацій.

73. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.

74. Березюк О. В. Охорона праці. Підсумкова державна атестація спеціалістів, магістрів в галузях електроніки, радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку : навчальний посібник / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 104 с.

75. ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. – К. : Держнаглядохоронпраці, 1998. – 382 с.

76. ДБН В.2.5-27-2006. Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.

77. ДБН В.1.1.7-2002. Пожежна безпека об'єктів будівництва.

78. НАПБ Б.03.001-2004. Типові норми належності воґнегасників.

Додаток А (обов'язковий)

> ЗАТВЕРДЖУЮ Зав. кафедри РТ ВНТУ, д.т.н., професор ______ О.В. Осадчук "____" ____ 2019 р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання магістерської кваліфікаційної роботи Розробка активних високочастотних фільтрів 08–36.МКР.012.00.000 ТЗ

> Керівник роботи: _____ д. т. н., професор Осадчук О.В. "___" ____ 2019 р.

> > Розробив студент гр. РТ–18м д/в ______Фенченко С.В. "___"_____2019 р.

Вінниця ВНТУ 2019

1. ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Робота проводиться на підставі наказу ректора по Вінницькому національному технічному університету №<u>254</u> «<u>02</u>»<u>10</u>_2019р. та індивідуального завдання на магістерську кваліфікаційну роботу.

Дата початку роботи: "<u>02</u>" <u>вересня</u> 2019 р. Дата закінчення: "<u>17</u>" <u>грудня</u> 2019 р.

2. МЕТА І ПРИЗНАЧЕННЯ МКР

Метою роботи є дослідження пристроїв частотної селекції сиґналів на основі активних елементів і п'єзоелектричних резонаторів та операційних підсилювачів для широкого діапазону частот, що поєднують поліпшені електричні та експлуатаційні характеристики, а також можливість інтеґрації за інтеґральною технологією.

Об'єктом дослідження є параметри та характеристики активних фільтрів на п'єзоелектричних резонаторах та операційних підсилювачах та їх залежність від зміни температури та шумових характеристик.

Предметом дослідження є активні фільтри на основі операційних підсилювачів та п'єзоелектричних резонаторів об'ємних хвиль і активних елементів.

Для досятнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі:

- аналіз існуючих методів та засобів побудови та використання активних п'єзоелектричних фільтрів та на основі операційних підсилювачів;

- розґляд і аналітичний опис методів електронної перебудови активних фільтрів на основі операційних підсилювачів та поверхнево акустичних пристроїв;

- розробка принципів реалізації малоґабаритних активних фільтрів із розширеними динамічним і частотним характеристиками;

- узагальнення методів синтезу активних фільтрів на основі операційних підсилювачів та п'єзоелектричних фільтрів із застосуванням позитивного і негативного реактансу, а також перетворювачів імпедансу.

3. ДЖЕРЕЛА РОЗРОБКИ

1. Осадчук А. В. Фоточувствительные преобразователи на основе структур с отрицательным сопротивлением / Александр Владимирович Осадчук. – Винница : Континент, 1998. – 129 с.

2. Осадчук О. В. Мікроелектронні частотні перетворювачі на основі транзисторних структур з від'ємним опором / Олександр Володимирович Осадчук. – Вінниця : УНІВЕРСУМ–Вінниця, 2000. – 302 с.

3. Федотов Я. А. Основы физики полупроводниковых приборов / Я. А. Федотов. – М.: Высш. школа, 1980. – 390 с.

4. Козловський В. О. Основи підприємництва. Курс лекцій. Част. 1. / В. О. Козловський – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 196 с.

5. Козловський В. О. Основи підприємництва. Курс лекцій. Част. 2 / В. О. Козловський – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 184 с.

6. ДСН 3.3.6.042–99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

7. ДБН В.2.5–28–2006. Природне і штучне освітлення.

8. ДСН 3.3.6–037–99. Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

4. ВИКОНАВЕЦЬ

Вінницький національний технічний університет, кафедра радіотехніки, студент ґрупи РТ–18м д/в Фенченко Сергій Вікторович

5 ВИМОҐИ ДО ВИКОНАННЯ МКР

- розґлянута еквівалентна схемна модель п'єзоелектричного резонатора, що відрізняється від існуючих аналогів спрощеною структурою без частотно–залежні елементів і дозволяє розраховувати в широкому діапазоні частот характеристики базових конструкцій п'єзоелектричного резонатора, а також придатна для проектування в САПР активних п'єзоелектричних фільтрів високого порядку;

- розглянуто аналітичні співвідношення для моделювання режимів активного управління характеристиками п'єзоелектричного резонатора, що дозволяють реалізувати фільтри, що перебудовуються з розширеним частотним діапазоном;

- розґлянуто методи створення та розрахунку активних п'єзоелектричних фільтрів, на основі активних схем заміщення і мають переваґи у виґляді розширеноґо частотного діапазону, скороченої кількості резонаторів.

6. ЕТАПИ МКР І ТЕРМІНИ ЇХ ВИКОНАННЯ

N⁰	Назва етапів	Термін в	иконання	Очікувані	Звітна
3/П	магістерської			результати	документація
	кваліфікаційної роботи				
1.	Огляд літературних	02.09.2019	15.09.2019	Проведено огляд	Узгодження
	джерел.			літературних	теми МКР по
	Вибір та узгодження			джерел. Вибрана	кафедрі
	теми МКР			тема	
2.	Аналіз літературних	16.09.2019	22.09.2019	Проведений аналіз	Вступ
	джерел. Попередня			літературних джерел	
	розробка основних			по даній тематиці.	
	розділів			Підґотовлений	
				матеріал основних	
				розділів	
3.	Затвердження теми.	23.09.2019	02.10.2019	Розроблене ТЗ	Наказ по ВНТУ
	Розробка технічного				про
	завдання				затвердження
	· · · ·				тем. Додаток А
4.	Аналіз вирішення	03.10.2019	20.10.2019	Проведений аналіз.	Вступ
	поставленоі задачі.			Розроблени	Розділ 1-2
	Розробка структурної			схеми пристрою	Звіт по
	схеми				переддипломни
~		21.10.2010	20.10.2010	<u>п ·</u>	практиці
Э.	Електричні розрахунки.	21.10.2019	29.10.2019	Проведені	Розділ 3
	Експериментальне			розрахунки та	
6	Дослідження	20.10.2010	02 11 2010	Дослідження	D
0.	Розділ моделювання	50.10.2019	05.11.2019	проведено	Результати
7	Doppolivo rpachivuoi	04 11 2010	10 11 2010	Моделювання	Трафіциа
1.	иостици MVD	04.11.2019	10.11.2019	плакати. Структурні	Трафічна
0		11 11 2010	15 11 2010	Та електричні схеми	Частина
0.	Аналіз економічної	11.11.2019	13.11.2019	Економічна частина	Розділ 5
0		16 11 2010	22 11 2010	Иастина БЖЛ	Роздід 6
9.	Охорона праці (ОП)	10.11.2019	22.11.2019	частина влуд	т озділ о
10.	Оформлення	23.11.2019	27.11.2019	Оформлена	ПЗ та графічна
10.	пояснювальної записки			локументація	частина
	та графічної частини			,,	
11.	Нормоконтроль	28.11.2019	29.11.2019	Підпис	Оформлена ПЗ
				нормоконтроля	та графічна
					частина
12.	Попередній захист	02.12.2019	06.12.2019	Позитивні відзиви	Відзив.
	МКР, доопрацювання,				Рецензія
	рецензування МКР				
13.	Захист МКР ЕК	09.12.2019	17.12.2019	Позитивний захист	Протокол ЕК

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ МКР

В результаті виконання роботи буде зроблено:

- розроблено еліптичного ФНЧ другого порядку на повторювачі напруги;

- розроблено структурна схема еліптичного ФНЧ;

– розроблено принципову схему ФНЧ 8-го порядку;

- проведено результати дослідження методів синтеза активних високочастотних фільтрів;

- проведено результати моделювання методів синтеза активних високочастотних фільтрів;

- очікуваний економічний ефект. При впроваджені результатів досліджень та розробки очікується покращення характеристик розроблюваних високочастотних фільтрів.

8. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ ТА ПІД ЧАС ЕТАПІВ

За результатами виконання МКР до ЕК подаються пояснювальна записка, графічна частина МКР, відзив і рецензія.

9. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ МКР ТА ЇЇ ЕТАПІВ

Поетапно результати виконання МКР розглядаються керівником роботи та обговорюються на засіданні кафедри.

Захист магістерської кваліфікаційної роботи відбувається на відкритому засіданні ЕК.

10. ВИМОҐИ ДО РОЗРОБЛЮВАНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Документація, що розробляється в процесі виконання роботи повинна містити:

- схему еліптичного ФНЧ другого порядку на повторювачі напруги;
- попередня структурна схема еліптичного ФНЧ;
- принципова схема ФНЧ 8-го порядку;
- АЧХ з виходу 1-го 4-го каскаду ФНЧ та АЧХ каскадного з'єднання всіх ланок ФНЧ;
- результати комп'ютерного моделювання активного фільтра;
- дослідження питань охорони праці.

11. ВИМОҐИ ЩОДО ТЕХНІЧНОҐО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

У зв'язку з тим, що інформація не є конфіденційною, заходи з її технічного захисту не передбачаються.

Додаток Б (обов'язковий)

РОЗРОБКА АКТИВНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ФІЛЬТРІВ

Класифікація електричних фільтрів



Додаток В (обов'язковий)

РОЗРОБКА АКТИВНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ФІЛЬТРІВ

Каскадне з'єднання ланок



Додаток Д (обов'язковий)

РОЗРОБКА АКТИВНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ФІЛЬТРІВ

Попередня структурна схема еліптичного ФНЧ



Додаток Е (обов'язковий)

РОЗРОБКА АКТИВНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ФІЛЬТРІВ

Амплітудно–частотні характеристики еліптичного ФНЧ а) з підйомом в смузі пропускання; б) без підйому



Додаток Ж (обов'язковий)

РОЗРОБКА АКТИВНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ФІЛЬТРІВ

Схема включення інтегральної мікросхеми UAF774



Додаток К (обов'язковий)

РОЗРОБКА АКТИВНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ФІЛЬТРІВ

АЧХ з виходу 1-го – 4-го каскаду ФНЧ та АЧХ каскадного з'єднання всіх ланок ФНЧ




Додаток Л (обов'язковий)

РОЗРОБКА АКТИВНИХ ВИСОКОЧАСТОТНИХ ФІЛЬТРІВ

Схема резонатора з послідовною котушкою індуктивності (a), її модуль вхідного імпедансу для різних Ls (б), залежність послідовного резонансу від Ls (в) і перестраіваємость частоти (ґ)









B)

